
苏州固锴电子股份有限公司

SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO.,LTD



江苏省苏州市通安开发区通锡路 31 号

首次公开发行股票招股说明书



保荐人（主承销商）：爱建证券有限责任公司

上海市复兴东路 673 号

苏州固得电子股份有限公司招股说明书

发行股票类型:	人民币普通股 (A 股)	发行股数:	3,800 万股
每股面值:	人民币 1.00 元	每股发行价格:	6.39 元
发行日期:	2006 年 10 月 20 日	拟上市证券交易所:	深圳证券交易所
发行后总股本:	13,800 万股		
本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:	本公司股东苏州通博电子器材有限公司、香港润福贸易有限公司、香港宝德电子有限公司承诺:自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。股东上海汇银(集团)有限公司、苏州爱普电器有限公司承诺:自股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。		
保荐人(主承销商):	爱建证券有限责任公司		
招股说明书签署日期:	2006 年 8 月 31 日		

发行人声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

本招股说明书的所有内容,均构成招股说明书不可撤销的组成部分,与招股说明书具有同等法律效力。

重大事项提示

本公司提醒投资者注意下列重大事项：

一、本次发行前公司总股本 10,000 万股，本次拟发行 3,800 万股，发行后总股本为 13,800 万股，上述股份全部为流通股。本公司股东苏州通博电子器材有限公司、香港润福贸易有限公司、香港宝德电子有限公司承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。股东上海汇银（集团）有限公司、苏州爱普电器有限公司承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

二、本公司 2003 年、2004 年、2005 年及 2006 年上半年的净利润分别为 44,543,923.96 元、30,724,847.25 元、31,029,034.28 元和 19,360,817.46 元，毛利率分别为 22.95%、18.68%、18.55% 和 19.67%。报告期内净利润和毛利率下降主要是受 2004 年 1—10 月出口退税率下降、二极管产品平均销售价格下降及原材料价格上涨等因素的影响。公司正通过压缩生产成本、提高二极管芯片自给率及提升产品档次等手段，确保净利润及毛利率水平的稳定和回升。

三、由于历史原因，目前除本公司外，其他使用“固得”商号的同行业公司包括香港固得、台湾固得及济南固得。其中香港固得是本公司的关联方及经销商，但该公司无产品生产、无注册商标，本公司的经营不依赖该公司；台湾固得曾于 1999 年 7 月至 2001 年 10 月期间参股本公司，该公司及其子公司济南固得目前不是本公司的关联方，与本公司无业务往来。

尽管上述各方拥有的商号、商标是根据不同的法律制度及经不同行政区划的企业登记机关核准获得的，目前不存在与使用权相关的法律纠纷，但未来仍不能完全排除由于商号相同及商标类似而导致知识产权纠纷和市场风险的可能。

四、公司对主要境外客户依赖程度较高，2005 年公司对 VGS 的 OEM 收入为 11,216.61 万元，占当年主营业务收入的 29.8%。公司与 VGS 的 OEM 协议将于 2006 年 10 月 30 日到期，如 VGS 不与本公司续订协议，将会对公司的业务经营产生重大影响。

五、本公司专门从事二极管（不包括光电二极管）的生产制造，主营业务比较集中，半导体行业的周期性波动可能引致本公司的经营风险。

六、本公司出口销售收入占主营业务收入的 90% 以上，同时部分原材料以及生产设备需要进口，境外采购占采购总额的 60% 以上。结算货币主要是美元、日元和港币。外汇汇率波动会在一定程度上影响本公司赢利水平。

七、根据《财政部、国家税务总局关于调整出口货物退税率的通知》（财税 [2003] 222 号），2004 年度 1-10 月本公司产品出口退税率将从 17% 调低到 13%，导致净利润减少了 452.7

万元；根据财政部、国家税务总局《关于提高部分信息技术(IT)产品出口退税率的通知》(财税[2004]200号)，自2004年11月1日起，公司适用的出口退税率由13%恢复为17%。公司未来适用的出口退税率仍存在变动的可能，因此本公司存在因出口退税率变化而导致收益下降的风险。

八、本次股票发行后，苏州通博电子器材有限公司将持有本公司41.57%的股份，处于相对控股地位。控股股东可能利用其控股地位，通过行使表决权和日常经营管理权对公司的重大人事、经营决策等产生影响，从而在一定程度上影响本公司的生产经营。

九、根据公司于2006年6月30日召开的2005年年度股东大会决议，公司对截止2005年12月31日可供投资者分配利润中的11,374,679.14元进行分配。本次利润分配已于2006年8月30日前实施完毕。完成上述分配之后的未分配利润余额65,000,000元及自2006年1月1日以后产生的利润将由本次公开发行后的新老股东共享。

十、2004年9月以前，CCI系公司的主要OEM客户。2005年3月26日，公司与CCI及其母公司VGS正式签署了《补充协议》，约定自2004年9月1日起由VGS接管CCI在亚洲的一切经营活动，CCI的所有权利义务由VGS承继。

目 录

第一章 释 义.....	7
第二章 概览.....	9
第三章 本次发行概况.....	13
第四章 风险因素.....	16
第五章 发行人基本情况.....	26
第一节 基本情况.....	26
第二节 发行人改制重组情况.....	26
第三节 股权结构及组织结构.....	37
第四节 发起人股东及实际控制人的基本情况.....	39
第五节 发行人股本情况.....	42
第六节 员工及其社会保障情况.....	43
第七节 发行人主要股东及董事、监事、高管作出的重要承诺.....	44
第六章 业务和技术.....	45
第一节 所处行业的基本情况.....	45
第二节 本公司面临的主要竞争状况.....	52
第三节 本公司的主营业务.....	55
第四节 本公司的主要资产.....	66
第五节 本公司的生产技术.....	73
第六节 本公司的质量控制.....	75
第七节 本公司所获的各项认证及荣誉.....	78
第七章 同业竞争和关联交易.....	79
第一节 同业竞争.....	79
第二节 关联方、关联关系及关联交易.....	80
第八章 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员.....	91
第九章 公司治理结构.....	98
第十章 财务会计信息.....	102

第一节	审计意见.....	102
第二节	简要财务报表.....	102
第三节	财务报表编制基础、主要会计政策和会计估计.....	105
第四节	最近一期末主要资产.....	110
第五节	最近一期末主要债项.....	111
第六节	股东权益.....	112
第七节	现金流量基本情况.....	112
第八节	期后事项、或有事项及其他重大事项.....	113
第九节	财务指标.....	113
第十节	公司设立时的资产评估情况.....	116
第十一节	验资情况.....	117
第十一章	管理层讨论与分析.....	118
第十二章	业务发展目标.....	131
第十三章	募集资金运用.....	138
第十四章	股利分配政策.....	147
第十五章	其他重要事项.....	149
第十六章	董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明.....	151
第十七章	备查文件.....	158

第一章 释义

在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下意义：

发行人/固得电子/公司/ 本公司/股份公司：	指	苏州固得电子股份有限公司
固得有限：	指	苏州固得电子有限公司
苏州通博：	指	苏州通博电子器材有限公司
香港润福：	指	香港润福贸易有限公司
香港宝德：	指	香港宝德电子有限公司
无锡镁高：	指	无锡镁高电子有限公司
台湾六铨：	指	台湾六铨科技股份有限公司
香港固得：	指	固得（香港）电子有限公司
固铨科技：	指	固铨科技（芜湖）有限公司
香港明申：	指	香港明申公司
江苏固得：	指	江苏固得电子有限公司
股东大会：	指	苏州固得电子股份有限公司股东大会
董事会：	指	苏州固得电子股份有限公司董事会
公司章程：	指	苏州固得电子股份有限公司章程
保荐人（主承销商）：	指	爱建证券有限责任公司
律师事务所：	指	北京市中伦金通律师事务所
会计师事务所：	指	德勤华永会计师事务所有限公司
元：	指	人民币元
VISHAY, VSH:	指	威旭半导体
VGS, VGSLLC:	指	威旭通用半导体公司
VSA:	指	威旭半导体奥地利有限公司
CCI:	指	世纪元器件公司
SHD:	指	日本新电元工业株式会社
NIEC:	指	日本映达电子有限公司

WSTS:	指	世界半导体贸易统计协会
CCID:	指	中国电子信息产业发展研究所
CSIA:	指	中国半导体行业协会
OEM:	指	贴牌加工业务
晶圆:	指	硅晶片
晶粒/芯片:	指	即二极管芯片
钝化:	指	使半导体 PN 结电学性能不受外界影响的一种措施和方法
OJ:	指	硅橡胶钝化工艺
GPP:	指	玻璃钝化工艺
DO/TO 系列封装:	指	国际通用的分立电子元器件封装代码
SMD:	指	贴片式封装, 包括 SMA,SMB,SMC 等具体封装形式
LLP:	指	Leadless Package, 无引脚封装
QFN:	指	方形扁平封装
MB:	指	Mini Bridge, 微型桥堆
SKY:	指	肖特基芯片或肖特基二极管
TVS:	指	Transient Voltage Suppressor, 瞬变电压抑制二极管
抛负载二极管:	指	Load Dump Diode, 汽车整流二极管的一种

第二章 概览

声 明

本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、发行人基本情况

（一）概况

名 称：苏州固得电子股份有限公司

英文名称：SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD.

公司住所：江苏省苏州市通安开发区通锡路 31 号

法定代表人：吴念博

注册资本：10,000 万元

设立时间：2002 年 10 月 22 日

（二）设立情况

发行人的前身是苏州固得电子有限公司。2002 年 7 月 24 日，经中华人民共和国对外经济贸易合作部外经贸资二函[2002]765 号文件批准，固得有限原股东苏州通博电子器材有限公司、香港润福贸易有限公司、香港宝德电子有限公司、苏州爱普电器有限公司和上海汇银(集团)有限公司作为发起人，以 2001 年 12 月 31 日经审计的净资产为依据，将苏州固得电子有限公司整体变更为苏州固得电子股份有限公司，公司股本 7,000 万股，注册资本为 7,000 万元。

2003 年 8 月 26 日，经中华人民共和国商务部商资二批[2003]494 号文件批准，公司以未分配利润转增资本，增资后公司股本为 10,000 万股，注册资本为 10,000 万元。

（三）股东持股情况

股东名称	持股数（万股）	占总股本比例
苏州通博电子器材有限公司	5,736	57.36%
香港润福贸易有限公司	3,384	33.84%
香港宝德电子有限公司	480	4.80%
上海汇银（集团）有限公司	200	2.00%
苏州爱普电器有限公司	200	2.00%
合 计	10,000	100%

（四）经营范围

发行人的经营范围是：设计、制造和销售各类半导体芯片、各类二极管、三极管；生产加工汽车整流器、汽车电器部件、大电流硅整流桥堆及高压硅堆等相关产品；电镀加工电子元件以及半导体器件相关技术的开发、转让和服务。

二、控股股东及实际控制人的简要情况

公司的控股股东为苏州通博电子器材有限公司。苏州通博的注册资本 4,617 万元人民币，出资者为吴念博等 37 名自然人，主要业务为：生产销售半导体器件、电子仪器、汽车电器、电脑附件及软件开发；五金加工；批发零售医疗设备等。

公司的实际控制人为吴念博，同时任本公司董事长兼总经理。

苏州通博及吴念博先生的基本情况参见第五章第四节相关内容。

三、主要财务数据及主要财务指标

以下数据摘自本招股说明书第十章“财务会计信息”相关部分。

资产负债表主要数据

单位：元

项 目	2006-6-30	2005-12-31	2004-12-31	2003-12-31
资产总额	304,100,627.25	292,765,631.30	260,301,239.84	263,235,825.53
负债总额	97,748,065.40	94,399,207.77	83,985,395.06	112,644,828.00
股东权益	206,352,561.85	198,366,423.53	176,315,844.78	150,590,997.53

利润表主要数据

单位：元

项 目	2006年1-6月	2005年	2004年	2003年
主营业务收入	204,058,686.84	377,707,638.43	374,502,073.89	328,830,995.02
主营业务利润	40,132,260.38	70,074,032.70	69,959,660.14	75,473,796.47
利润总额	21,617,781.86	34,236,697.08	33,687,802.93	49,336,046.16
净利润	19,360,817.46	31,029,034.28	30,724,847.25	44,543,923.96

现金流量表主要数据

单位：元

项 目	2006年1-6月	2005年	2004年	2003年
经营活动产生的现金流量净额	12,271,623.30	54,311,913.80	6,996,411.69	58,556,769.61
投资活动产生的现金流量净额	(10,716,198.87)	(24,679,179.20)	(22,638,454.95)	(36,783,525.68)
筹资活动产生的现金流量净额	(6,632,261.69)	(10,265,016.56)	(11,320,911.62)	8,382,894.76
现金及现金等价物净增加额	(5,076,837.26)	19,367,718.04	(26,962,954.88)	30,314,104.42

主要财务指标

主要财务指标	2006-6-30	2005-12-31	2004-12-31	2003-12-31
流动比率	1.97	1.93	1.90	1.61
速动比率	1.13	1.23	1.06	1.15
资产负债率	32.14%	32.24%	32.26%	42.79%
应收帐款周转率	2.80	5.04	5.42	5.08
存货周转率	2.23	4.53	5.05	5.72
无形资产*占净资产的比例	0.44%	0.02%	0.02%	0.03%
每股净资产（元）	2.06	1.98	1.76	1.51
每股收益（扣除非经常性损益后的净利润全面摊薄）（元）	0.17	0.288	0.286	0.426
净资产收益率（扣除非经常性损益后的净利润全面摊薄）	8.37%	14.54%	16.24%	28.31%
每股经营活动产生的现金流量	0.12	0.54	0.07	0.59

注：无形资产指扣除土地使用权后的无形资产净值。

四、本次发行情况

公司本次发行 3,800 万股人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元。发行对象为符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。发行方式为网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。

本次发行前后公司股本结构如下表所示：

项目	股东名称	发行前		发行后		锁定限制及期限
		持股数 (万股)	比例	持股数 (万股)	比例	
有限 售条 件的 股份	苏州通博电子器材有限公司	5,736.00	57.36%	5,736.00	41.57%	自上市之日起锁 定 36 个月
	香港润福贸易有限公司	3,384.00	33.84%	3,384.00	24.52%	
	香港宝德电子有限公司	480.00	4.80%	480.00	3.47%	
	上海汇银（集团）有限公司	200.00	2.00%	200.00	1.45%	自上市之日起锁 定 12 个月
	苏州爱普电器有限公司	200.00	2.00%	200.00	1.45%	
本次发行的股份		—	—	3,800.00	27.54%	—
合 计		10,000.00	100%	13,800.00	100%	—

五、募集资金用途

本次发行实收募集资金拟用于投资以下项目：

1、玻璃钝化（GPP）超级整流二极管（含汽车整流二极管）生产线技术改造项目（江苏省经济贸易委员会苏经贸（2003）1184 号文）；

2、肖特基（Schottky）二极管生产线技术改造项目（江苏省经济贸易委员会苏经贸（2003）1185 号文）。

上述两个项目合计总投资为4951万美元，按项目批准时的汇率折合人民币约41,097.04万元。目前，公司已利用自有资金对玻璃钝化超级整流二极管生产线技术改造项目中的4英寸GPP晶粒生产线项目进行了投资，截至2006年6月30日该生产线已经累计投入资金14,670,701.24元，结转固定资产14,615,384.86元。本次发行募集资金到位后，将全部继续用于上述项目的投资，资金不足部分由公司自筹解决。

第三章 本次发行概况

一、本次发行的基本情况

股票种类:	人民币普通股 (A 股)
每股面值:	1.00 元
发行股数:	3,800 万股, 占发行后总股本的 27.54%
发行价格:	6.39 元
发行市盈率:	22.03 倍 (每股收益按照 2005 年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算) 30.43 倍 (每股收益按照 2005 年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)
发行前每股净资产:	2.06 元/股 (以 2006 年 6 月 30 日净资产值计算)
发行方式:	网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式
发行对象:	符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者 (国家法律、法规禁止购买者除外)
承销方式:	由保荐人 (主承销商) 组织的承销团以余额包销方式承销
募集资金总额:	24,282 万元
发行费用概算	
承销、保荐费用:	承销费按筹资额的 3% 计算, 保荐费用 600 万元。
审计费用:	120 万元
评估费用:	10 万元
验资费用:	10 万元
律师费用:	80 万元
审核费:	20 万元
发行手续费:	按 3.5% 的费率计算

二、本次发行的相关当事人

1、发行人：苏州固得电子股份有限公司

住 所:	江苏省苏州市通安开发区通锡路 31 号
法定代表人:	吴念博
电 话:	(0512) 65304462-2050
传 真:	(0512) 65302585
联 系 人:	高玉标

2、保荐人 (主承销商): 爱建证券有限责任公司

住 所:	上海市复兴东路 673 号 3 楼
法定代表人:	徐宜阳
电 话:	(021) 63341333
传 真:	(021) 63340100
保荐代表人:	林好常、刘勇
项目主办人:	刘昊拓
项目经办人:	刘平

3、分销商：国海证券有限责任公司

住 所:	广西南宁市滨湖路 46 号
法定代表人:	张雅锋
电 话:	(0755) 83716979
传 真:	(0755) 83711505
联 系 人:	邓荟娟

4、分销商：国盛证券有限责任公司

住 所:	江西省南昌市永叔路 15 号
法定代表人:	管荣升
电 话:	(021) 64866307
传 真:	(021) 64385553
联 系 人:	张勇

5、发行人律师事务所：北京市中伦金通律师事务所

住 所:	北京市朝阳区建国路 118 号招商中心 01 楼 12 层
法定代表人:	张学兵
电 话:	(021) 50372668
传 真:	(021) 50372678
经办律师:	乔文骏、朱旭东

6、会计师事务所：德勤华永会计师事务所有限公司

住 所:	上海市延安东路 222 号 30 楼
法定代表人:	谢英峰
电 话:	(021) 61418888
传 真:	(021) 63350177
经办注册会计师:	杨海蛟、茅志鸿

7、资产评估机构：江苏仁合资产评估有限公司

住 所:	苏州市竹辉路 301 号
法定代表人:	张雨歌
电 话:	(0512) 65194850
传 真:	(0512) 65194850

经办注册评估师：	王凯、沈光俊
----------	--------

8、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住 所：	深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼
电 话：	0755-25938000
传 真：	0755-25988122

9、保荐人（主承销商）收款银行：中国工商银行上海市分行营业部

户 名：	爱建证券有限责任公司
账 号：	1001 2029 1902 5739 602

发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他权益关系。

四、与本次发行上市相关的重要日期

- 1、招股意向书刊登日期：2006 年 10 月 20 日
- 2、询价推介日期：2006 年 10 月 23 日~10 月 25 日
- 3、定价公告刊登日期：2006 年 10 月 27 日
- 4、申购日期：2006 年 10 月 30 日
- 5、股票上市日期：尽快安排在深圳证券交易所上市

第四章 风险因素

投资于本公司的股票会涉及一系列风险。在购买本公司股票前，敬请投资者将下列风险因素相关资料连同本招股说明书中其他资料一并考虑。根据重要性原则或可能影响投资决策程度的大小排序，本公司存在的风险如下：

一、净利润和毛利率下降的风险

本公司 2003 年、2004 年、2005 年及 2006 年上半年的净利润分别为 44,543,923.96 元、30,724,847.25 元、31,029,034.28 元和 19,360,817.46 元，毛利率分别为 22.95%、18.68%、18.55% 和 19.67%。报告期内净利润和毛利率下降的原因主要是 2004 年 1—10 月出口退税率下降、二极管产品平均销售价格下降及原材料价格上涨等因素的影响。

分立器件行业是充分竞争行业，成熟产品的供给上升造成平均售价不断下降是本行业的一大特点；同时，根据公司的销售策略，对主要客户的产品销售价格也保持稳定的优惠幅度。这对于企业销售收入和利润的增长都会构成较大的挑战。

占公司产品成本比重最大的原材料为芯片及引线，根据公司采购部门的统计，2003—2005 年引线的年平均采购价格上涨幅度均在 20% 以上，芯片采购价格也有一定幅度的上升，其他原材料价格相对稳定。关于原材料价格变动趋势的进一步分析请参见第六章第三节相关内容。

针对产品平均售价下降导致毛利率下降的风险，公司主要通过调整产品结构，加大中高端产品的开发力度，提高制造工艺，增加附加值高、价格弹性小的品种，促进产品线向高端产品转移。目前以 LLP 产品为代表的高端封装产品已投产，本次募集资金投资的 GPP 项目和 SKY 项目达产后，公司产品的技术含量将进一步提高。上述产品将显著提升公司的盈利规模并稳定毛利率水平。

针对原材料价格上涨导致毛利率下降的风险，公司已采取以下措施：

1、在生产工艺方面，逐步改善现有传统封装产品中的原材料耗用结构，在不影响产品性能的前提下，降低原材料耗用率；

2、在生产管理方面，进一步挖掘成本控制的潜力，降低单位产品固定成本；

3、提高晶圆、芯片产量和自给率，除部分高端产品所需原料外，逐步降低芯片外购比例和采购成本；

4、充分利用自身市场地位，与部分原材料供应商及下游客户达成价格锁定和成本——售价联动协议，转移部分成本压力；

5、在控制风险的前提下，适度参与金属铜的期货交易（参见本章“期货交易风险”相关内容）。

二、商号和商标可能引致的知识产权纠纷和市场风险

由于历史原因，目前除本公司外，其他使用“固得”商号的同行业公司包括香港固得、台湾固得及济南固得。尽管上述各方拥有的商号、商标是根据不同的法律制度及经不同行政区划的企业登记主管机关核准获得的，目前不存在与使用权相关的法律纠纷，但未来仍不能完全排除由于商号相同及商标类似而导致知识产权纠纷和市场风险的可能。

香港固得是公司在香港地区的重要经销商，该公司无产品生产、无注册商标，本公司董事黄浩荣持有该公司 90% 的股权。香港固得的其他基本情况参见第五章第四节相关内容；


台湾固得的注册地在中国台湾地区，自 1999 年 7 月至 2001 年 12 月期间是本公司股东之一。2001 年台湾固得因发生财务困难与香港润福签订了债务重组协定并退出固得有限，作为重组协议的一部分台湾固得承诺停止使用“固得”商标并且不给予其他企业使用“固得”商号（台湾固得与本公司的关系及相关承诺的具体内容参见第五章第二节之二“发行人历史沿革”）。

目前，台湾固得与本公司拥有的商标类似，但本公司的商标是经国家知识产权局独立注册，并在世界知识产权组织（WIPO）和日本进行了商标专用权登记（参见第六章第四节相关内容），在马德里协定成员国范围内具有独占性。台湾

固得的商标在台湾地区注册，只在台湾地区适用；

济南固得注册资本 258 万美元，出资比例为济南泉港科技发展有限公司 63%、台湾固得 37%。济南固得的英文名称为“JINAN GUDE ELECTRONIC DEVICE CO., LTD”，与本公司英文商号“GOOD-ARK”完全不同；本公司与济南固得的商标权分别独立注册，济南固得的商标只有“JGD”文字，并无图案，与本公司商标差异比较大。

本公司、台湾固得及济南固得的商标对比如下：

	核定使用商品	商标	注册地	使用区域
苏州固得	二极管、半导体器件和半导体类的商品和服务		中国、世界知识产权组织、日本	中国、《商标国际注册马德里协定》缔约国和《马德里议定书》加入国
台湾固得	电晶体、二极体、积体电路、发光二极体、半导体元件、半导体、矽晶体、积体电路、半导体晶片		中国台湾	中国台湾地区
济南固得	晶体管（电子）	JGD	中国	中国

根据 CSIA 及 CCID 的统计，本公司的销售收入在 2005 年度国内半导体行业中排名分立器件生产企业第 5 位、集成电路与分立器件制造企业第 10 位（参见第六章第二节相关内容），上述统计资料中未发现台湾固得或济南固得的相关排名信息。台湾固得、济南固得与本公司的生产销售规模差距较大、销售市场不同，目前不存在商标权使用方面的法律纠纷。

为加强客户对本公司商号及商标的认知，防范商号和商标风险，本公司采取以下措施：

1、加强对本公司商标合法权益的保护，建立市场监控和预警措施，高度关注客户的反馈，对市场有关公司产品、商号的信息及时整理分析；

公司将合法使用“固得”系列商标，避免与其他企业形成纠纷。同时进一步

加强对知识产权的法律保护工作，公司的法务部门成立了专门的跟踪小组对上述信息给予高度的关注，积极应对可能存在的由于商标、商号引致的知识产权风险和市场风险。如果存在其他企业侵害公司的商标权，本公司将协商解决，必要时采用法律手段。

2、加大对公司形象和产品的宣传，提升公司在客户中的知名度；同时，加强对专业采购客户的推介，确定公司的专业销售者地位，从而使购买者及潜在用户能清楚区别本公司与其他具有类似商号公司。

三、对主要境外客户依赖程度较高的风险

本公司对境外主要 OEM 客户的销售额占主营业务收入的比例较高，2005 年公司对 VGS 的 OEM 销售额为 11,216.61 万元，占主营业务收入的 29.8%，对 VSA 的 OEM 销售额为 5,664.69 万元，占主营业务收入的 15%，对二者合计的销售额占主营业务收入的 44.8%。本公司与 VGS 公司之间的 OEM 协议的首期有效期限为 5 年，至 2006 年 10 月 30 日到期。如到期后 VGS 不再续订协议，将会对公司的经营产生重大影响。

公司 OEM 业务的背景参见第六章第三节相关内容。

本公司与 VGS 及 VSA 等 OEM 客户通过长期的业务合作建立了稳固的伙伴关系，维持稳定的 OEM 合作关系符合双方的利益。

1、VGS 确定本公司作为 OEM 合作对象之前，直接并通过中介机构对本公司进行了为期两年的认证，对本公司的生产能力、质量管理水平、工艺技术、配套设备进行了严格评估，并且从 2000 年开始按照 VGS 的标准对本公司相关人员进行培训。上述认证、评估和培训是获得 VGS 公司 OEM 合同的必备程序，所以 VGS 更换 OEM 伙伴的成本较高。

2、本公司在 VGS 及其母公司威旭半导体的全球战略布局中具有不可替代的地位。威旭半导体是全球最大的分立器件和二极管厂商之一，本公司为 VGS 生产的 OEM 产品的最终用户主要为欧美电子设备和汽车厂商，VGS 的子公司 CCI 已将其汽车整流器二极管生产设备全部转移到本公司，自身已没有相关生产能力，而 VGS 全球其他 OEM 伙伴生产的产品并不相同、替代性不强。

3、2004年，本公司与VGS就OEM合同签订了续约意向书，基本内容如下：

“VGS（通过CCI公司）确认苏州固得电子股份有限公司为其长期业务合作的策略性伙伴，此基于双方共同利益及双方合作经验。

长期以来CCI公司一直委托苏州固得电子股份有限公司为其从事产品加工。合作经历良好。原代工协议将于2006年到期。我们有意将此协议先延展两年。”

我们认为VGS的上述意向表明了其与本公司继续进行后续合作的愿望。目前，公司与VGS正就有关合同的细节进行磋商。

4、在保持现有业务的基础上，公司进一步加深了与威旭半导体的业务合作。2004年本公司与威旭半导体奥地利公司（VSA）签署了OEM合作协议，为VSA进行LLP产品封装。上述合约参见第十五章相关内容。

5、除巩固与VGS及VSA业务合作之外，公司亦在逐步拓展与其他国际先进企业的合作关系，并扩大自有品牌销售在主营业务收入中所占比例，以分散客户订单过分集中的风险。进一步分析参见第六章及第十一章相关内容。

四、主营业务集中及行业周期风险

本公司专门从事二极管（不包括光电二极管）的生产制造，主营业务比较集中。二极管属于半导体分立器件，半导体行业的周期性波动有可能引致本公司的经营风险。

半导体行业经过半个多世纪的发展，已经出现了周期性放缓、波动幅度下降的趋势。根据CCID的统计，全球半导体市场继2000年达到创纪录的第6次高峰之后，2001年开始急速下降，2003年由于SARS及美伊战争的影响未实现预期反弹，但2004年即恢复了高速增长，同比增幅继2000年之后再次超过20%，市场规模首次突破2000亿美元大关，分立器件市场的增幅也首次超过20%。

目前，汽车电子行业、照明行业已经超过计算机通信及消费电子等行业成为对分立器件需求增长最快的行业，上述行业对分立器件需求比重的上升有助于降低本公司受半导体行业周期的影响。

五、汇率变动风险

公司出口销售收入占主营业务收入的 90% 以上，同时部分原材料以及生产设备需要进口，境外采购占采购总额的 60% 以上。公司结算货币主要是美元、日元和港币，原材料进口与产品出口报价、结算均采用同种货币，能够在一定程度内对冲部分汇率风险，但汇率变动的不确定性和相关采购、销售合同的限制仍然可能会对发行人造成重大影响，产生汇兑损失，影响本公司赢利水平。

公司通过以下几个方面的措施来降低汇率变化对公司的不利影响：

- 1、提高原料的国产化率，降低公司的采购风险；
- 2、进一步开拓国内市场，提高国内销售额在收入结构中所占比例；
- 3、根据销售合同的结算货币结构，来调整采购结算货币币种，以降低公司的外汇收支差额；
- 4、办理远期结售汇和远期信用证业务，将可能存在的汇率风险转移到国际金融市场；
- 5、加强对外汇市场和国家关税政策的研究与预测，跟踪国际汇率市场变化动态，根据汇率的走势和汇率政策的变动可能性及时调整购销战略；
- 6、积极开拓欧洲市场，并合理划分市场区域和确定结算币种，通过结算币种的多样化分散汇市非系统风险，从而降低公司的总体汇率风险。

六、税收政策变化可能引致的风险

本公司出口比例较高，受增值税出口退税率变化影响较大。

根据《财政部、国家税务总局关于调整出口货物退税率的通知》（财税[2003]222号），2004年度1-10月本公司产品出口退税率从17%调低到13%，由此导致本公司2004年度的主营业务成本增加约503万元，毛利率下降约1.5%，净利润减少了452.7万元。

自2004年11月1日起，根据《财政部、国家税务总局关于提高部分信息技术(IT)产品出口退税率的通知》（财税[2004]200号），公司适用的出口退税率由13%恢复为17%。

未来出口退税率仍存在变动的可能，因此本公司仍存在因出口退税率变化而

导致收益下降的风险。

本公司是注册在国家级高新技术产业开发区内、被认定为高新技术企业的外商投资企业，属产品出口型企业，根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法实施细则》和《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[1994]1号）的相关规定，现适用 10%的企业所得税税率。

我国加入 WTO 后，内外资企业的所得税待遇将逐步趋同，相关税收政策的重大变化可能会对公司的盈利带来一定的影响。本公司认为，由于上述法律、法规及政策调整的涉及面广、影响较大、程序复杂，相关变化将较为平稳并有渐进的过渡期，公司近几年仍能继续享受目前的所得税优惠。

七、大股东的控制风险

本次股票发行后，苏州通博电子器材有限公司将持有本公司 41.57%的股份，处于相对控股地位。控股股东可能利用其控股地位，通过行使表决权和日常经营管理权对公司的重大人事、经营决策等产生影响，从而在一定程度上影响本公司的生产经营。

八、原材料境外采购比例较高的风险

2005 年本公司原材料采购金额约 2.18 亿元，其中境外采购额 1.35 亿元，约占采购总额的 62%，主要是从境外采购芯片的支出（约占境外采购总额的 79%），其他原材料存在少量进口（参见第六章第三节相关内容）。

境外采购涉及到国际贸易的各个环节，在质量控制、运输保障、交易安全、法律适用等方面均可能存在一定风险，因此若境外供应出现障碍，或公司与境外供应商之间发生争议，将对公司的正常经营产生一定的影响。

对于境外厂商生产能力变化等因素可能对原材料采购造成的影响，公司认为，半导体原材料供应已经是一个相当成熟的产业，境外厂商的技术水平、原材料供应、产能和市场比较稳定，不会出现大起大落的局面；

对于外国政府对半导体产品和技术的出口管制等因素可能对原材料采购造

成的影响，公司认为，二极管芯片作为一种普及性高、应用广泛的民用产品，与重点应用在军事、高科技等领域的半导体器件不同，外国政府不会基于技术保密等原因对其出口给予过多的限制，遭受出口管制的可能性极小。

为了降低境外采购的风险，公司已采取以下措施并建立了应急备用采购方案：

1、与主要原材料供应商建立长期稳定的合作关系，密切关注供应商的发展动态，在发生市场波动或供应紧张的前兆时能尽早采取应对措施；

2、实施分散采购策略。公司目前主要原材料供应商都在两家以上，且大多数分散在不同的国家或地区，从而避免对单一原材料供应商的依赖程度过高；

3、针对芯片采购占公司采购成本较高的实际情况，公司将通过募集资金投资项目的实施进一步扩大自制芯片产能、提升芯片品质；

4、逐步实施国内采购的替代策略。目前硅单晶片、铜引线等已基本实现了国内采购。而随着国内原材料厂商竞争优势的日益明显，国外公司开始加速在国内设厂，这些都将使公司的国内采购策略的实施更趋现实。

九、募集资金投向风险

公司此次募股资金将主要用于玻璃钝化超级整流二极管和肖特基二极管的生产，目的是为了增加中高档产品在公司产品结构中的比例。本次募股资金所投资项目都是基于公司对现有产品市场空间进行充分调研的基础上提出的，且均为国家产业政策鼓励发展的项目，市场需求很大。公司未来几年中销售和盈利的增长，以及公司核心竞争力的提升，很大程度上取决于能否按计划完成以上两个募股资金项目的建设。虽然公司已聘请专业机构对上述项目进行了工艺技术、设备选型、投资收益、市场容量等方面的可行性论证，但在项目的组织管理、设备供货衔接、安装调试、通线试产、量产达标以及市场开发等方面都还存在一定风险，如有不当，则会直接影响项目的投资回报及公司的预期收益。

十、应收帐款坏帐的风险

本公司截至 2003 年 12 月 31 日、2004 年 12 月 31 日、2005 年 12 月 31 日和 2006 年 6 月 30 日的应收帐款净额分别为 6,454.96 万元、7,356.56 万元、7,645.45 万元和 6,919.15 万元，占流动资产的比例分别为 35.84%、46.59%、42.25% 和 36.17%，应收帐款比重较大。随着公司经营规模的扩大，应收款项规模仍有进一步增加的可能，存在着一定的坏帐损失风险。

公司与主要业务伙伴的合作时间长并形成了可信赖的合作关系，所以应收账款周转速度快且账龄短，2003 至 2005 年末及 2006 年 6 月 30 日一年以内的应收帐款占报告期应收帐款总额比例分别为 97.5%、98.05%、98.1% 和 91.3%，2003 至 2005 年度的应收帐款周转率分别为 5.08、5.42 和 5.04，应收账款管理效果良好，尚未发生金额较大的坏账。今后本公司将在扩大销售规模的同时加强对客户财务状况和账款的预测、监控，有效防范和控制应收账款风险。进一步分析参见第十一章相关内容。

十一、技术更新风险

虽然二极管的市场应用技术已非常成熟，行业发展态势平稳，但是新技术、新工艺、新产品依然在不断涌现，技术更新主要体现在芯片技术的不断优化、封装技术的进步和器件材料的升级。目前，二极管封装技术的发展趋势是小型化、大功率、无引脚、模块式、超高速、低压降、高反压；二极管材料技术的发展趋势是，随着砷化镓（GaAs）材料的发展和相关工艺成本的降低，砷化镓器件在高温性能、器件速度方面的优势将得到充分发挥，逐步改变目前只能应用于航天等极高端领域的限制。如果本公司不能及时掌握相关技术，公司产品将不能及时适应市场的变化，从而对本公司的生产经营产生影响。

十二、期货交易风险

公司于 2005 年 7 月 22 日与创元期货经纪有限公司签订《期货经纪合同》，进行期铜交易。截至 2006 年 6 月 30 日，公司共投入期货保证金 480 万元，期货持仓合约按结算价计算的浮动亏损额为 835,650.00 元。

公司参与金属铜的期货交易主要基于以下考虑：

(1) 铜引线是公司产品的主要原材料之一，铜引线采购价格与金属铜价格高度相关；(2) 公司与部分铜引线供应商的合同采购价格以金属铜期货价格为主要参考价格；(3) 近年来，铜材料的价格波动幅度较大，给公司带来较大的成本压力。

参与期铜交易除可能导致衍生工具交易风险外，还可能导致生产实际所需用铜量与期货持仓量不匹配的风险。为此，公司在试行铜期货交易的过程中，将严格限制交易规模，逐步完善与该交易相关的组织结构、决策授权、流程管理、风险管理及报告制度等内部控制制度。

对期货交易业务的进一步说明参见“第十二章 管理层讨论与分析”相关内容。

第五章 发行人基本情况

第一节 基本情况

名称：苏州固得电子股份有限公司
英文名称：SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD
法定代表人：吴念博
成立日期：2002年10月22日
住所：江苏省苏州市通安开发区通锡路31号
邮政编码：215153
电话：（0512）65304462
传真：（0512）65302585
互联网网址：<http://www.goodark.com>
电子信箱：info@goodark.com

第二节 发行人改制重组情况

一、设立方式及发起人

本公司是经中华人民共和国对外经济贸易合作部外经贸资二函[2002]765号文批准，由苏州固得电子有限公司整体变更设立的股份有限公司，发起人为苏州通博电子器材有限公司、香港润福贸易有限公司、香港宝德电子有限公司、上海汇银（集团）有限公司和苏州爱普电器有限公司。公司以截至2001年12月31日经审计的净资产为基准按1:1的比例折合7000万股，于2002年10月22日在中华人民共和国国家工商行政管理总局注册登记，注册资本人民币7,000万元，注册号：企股国字第000940号。2004年12月22号，注册登记机关变更为江苏

省工商行政管理局，注册号变更为：企股苏总字第 000377 号。

二、发行人历史沿革

（一）股份公司设立前的股权变化

1、苏州固得电子有限公司成立于 1990 年 11 月 12 日，是经江苏省人民政府和国家工商行政管理局批准，由苏州市无线电元件十二厂与香港明申公司、中国五金矿产进出口总公司企荣苏州贸易有限公司共同出资成立的中外合资企业。有限公司成立时出资结构如下：

股东名称	出资额	出资比例
苏州市无线电元件十二厂	19 万美元	33%
香港明申公司	29 万美元	50%
中国五金矿产进出口总公司企荣苏州贸易有限公司	10 万美元	17%
合 计	58 万美元	100%

苏州会计师事务所对股东首期投入的资本进行了审核，并出具了苏公证资字

(91) 第 159 号《验资报告》。

上述出资中，无线电十二厂以人民币及美元现汇出资，香港明申以设备出资，企荣公司以美元现汇出资。固得有限成立时的主要资产包括生产设备及货币资金等，经营范围为生产销售各类半导体芯片、二极管、三极管及各式整流桥堆等系列产品以及电子元件电镀加工。

2、1993 年 12 月，中国五金矿产进出口总公司企荣苏州贸易有限公司将其对固得有限的出资全部转让给苏州市无线电元件十二厂；同时固得有限以未分配利润转增资本 7 万美元，注册资本增加为 65 万美元。本次转让及增资后出资结构如下：

股东名称	出资额	出资比例
苏州市无线电元件十二厂	32.5 万美元	50%
香港明申公司	32.5 万美元	50%
合 计	65 万美元	100%

苏州会计师事务所对公司合营方转让出资及增加的资本金进行了验证，并出具了 (93) 苏会外资字第 284 号《验资报告》。

3、1997 年 10 月，固得有限以未分配利润转增资本 95 万美元，注册资本增加为 160 万美元。本次增资后出资结构如下：

股东名称	出资额	出资比例
苏州市无线电元件十二厂	80 万美元	50%
香港明申公司	80 万美元	50%
合 计	160 万美元	100%

苏州会计师事务所对本次注册资本、投入资本变更情况的真实性、合法性进行了审验，并出具了（97）苏会审新字第 65 号《验资报告》。

4、1998 年 5 月，固得有限以未分配利润转增资本 70 万美元，注册资本增加为 230 万美元。本次增资后出资结构如下：

股东名称	出资额	出资比例
苏州市无线电元件十二厂	115 万美元	50%
香港明申公司	115 万美元	50%
合 计	230 万美元	100%

苏州会计师事务所对本次注册资本、投入资本变更情况的真实性、合法性进行了审验，并出具了（98）苏会审新字第 45 号《验资报告》。

5、1998 年 10 月，香港宝德电子有限公司以现金 12.105 万美元对固得有限增资，增资后固得有限注册资本为 242.105 万美元。本次增资后出资结构如下：

股东名称	出资额	出资比例
苏州市无线电元件十二厂	115 万美元	47.5%
香港明申公司	115 万美元	47.5%
香港宝德电子有限公司	12.105 万美元	5%
合 计	242.105 万美元	100%

江苏天平会计师事务所对本次注册资本、投入资本变更情况的真实性、合法性进行了审验，并出具了天平会验字（99）第 006 号《验资报告》。

6、1999 年 7 月，香港明申公司将其对固得有限 42.75% 的出资转让给台湾固得电子股份有限公司，固得有限注册资本不变。本次转让后出资结构如下：

股东名称	出资额	出资比例
苏州市无线电元件十二厂	115 万美元	47.5%
台湾固得电子股份有限公司	103.5 万美元	42.75%
香港宝德电子有限公司	12.105 万美元	5%
香港明申公司	11.5 万美元	4.75%
合 计	242.105 万美元	100%

江苏天平会计师事务所对本次注册资本、投入资本变更情况的真实性和合法性进行了审验，并出具了天平会验字（99）第 048 号《验资报告》

7、2000年9月，固得有限以未分配利润转增资本100万美元，注册资本增加为342.105万美元，同时苏州市无线电元件十二厂变更为苏州通博电子器材有限公司。本次增资及变更后出资结构如下：

股东名称	出资额	出资比例
苏州通博电子器材有限公司	162.5 万美元	47.5%
台湾固得电子股份有限公司	146.25 万美元	42.75%
香港宝德电子有限公司	17.105 万美元	5%
香港明申公司	16.25 万美元	4.75%
合 计	342.105 万美元	100%

苏州天平会计师事务所有限公司对本次注册资本、投入资本变更情况的真实性、合法性进行了审验，并出具了天平会验字（2000）第032号《验资报告》。

8、2001年2月，香港明申公司将其对固得有限1.75%的出资转让给苏州通博电子器材有限公司，台湾固得电子股份有限公司将其对固得有限7.5%的出资转让给苏州通博电子器材有限公司，固得有限的注册资本不变。本次转让后出资结构如下：

股东名称	出资额	出资比例
苏州通博电子器材有限公司	194.145 万美元	56.75%
台湾固得电子股份有限公司	120.592 万美元	35.25%
香港宝德电子有限公司	17.105 万美元	5%
香港明申公司	10.263 万美元	3%
合 计	342.105 万美元	100%

苏州天平会计师事务所有限公司对本次注册资本、投入资本变更情况的真实性、合法性进行了审验，并出具了天平会验字（2001）第014号《验资报告》。

9、2001年6月，固得有限以未分配利润转增资本157.895万美元，注册资本增加为500万美元。本次增资后出资结构如下：

股东名称	出资额	出资比例
苏州通博电子器材有限公司	283.75 万美元	56.75%
台湾固得电子股份有限公司	176.25 万美元	35.25%
香港宝德电子有限公司	25 万美元	5%
香港明申公司	15 万美元	3%
合 计	500 万美元	100%

苏州天平会计师事务所有限公司对本次注册资本、投入资本变更情况的真实性、合法性进行了审验，并出具了天平会验字（2001）第090号《验资报告》。

10、2001年12月，香港明申公司将其对固得有限3%的出资全部转让给苏

州通博电子器材有限公司；苏州通博电子器材有限公司将其对固得有限 2% 和 0.39% 的出资分别转让给上海汇银（集团）有限公司和苏州爱普电器有限公司；台湾固得电子股份有限公司将其对固得有限 33.84% 和 1.41% 的出资分别转让给香港润福贸易有限公司和苏州爱普电器有限公司；香港宝德电子有限公司将其对固得有限 0.2% 的出资转让给苏州爱普电器有限公司；固得有限的注册资本不变。

本次转让后出资结构如下：

股东名称	出资额	出资比例
苏州通博电子器材有限公司	286.8 万美元	57.36%
香港润福贸易有限公司	169.2 万美元	33.84%
香港宝德电子有限公司	24 万美元	4.8%
上海汇银（集团）有限公司	10 万美元	2%
苏州爱普电器有限公司	10 万美元	2%
合 计	500 万美元	100%

苏州天平会计师事务所有限公司对本次注册资本、投入资本变更情况的真实性、合法性进行了审验，并出具了天平会验字（2002）第 092 号《验资报告》。

（二）股份公司的设立

2002 年 4 月 27 日，固得有限全体股东签订了《苏州固得电子股份有限公司（筹）发起人协议书》，一致同意以截至 2001 年 12 月 31 日经审计的净资产为基准，将苏州固得电子有限公司整体变更为股份有限公司。

2002 年 4 月，江苏仁合资产评估有限公司对苏州固得电子有限公司进行股份制改制所涉及的资产和负债进行了全面评估，并出具了苏仁评报字（2002）第 30 号《资产评估报告书》。本次评估结果未进行调账。

2002 年 7 月 24 日，经中华人民共和国对外经济贸易合作部外经贸资二函（2002）765 号文批准，苏州固得电子有限公司整体变更为股份有限公司，并于 2002 年 10 月 22 日在中华人民共和国国家工商行政管理总局注册登记，设立时注册资本为人民币 7,000 万元，注册号为：企股国字第 000940 号。

德勤华永会计师事务所有限公司对股份公司股东投入的股本总额进行了审验，并出具了德师报（验）字（02）第 040 号《验资报告》。

股份公司成立时拥有的主要资产包括专用生产设备、房屋及建筑物、通用设备、运输设备等固定资产，以及土地使用权等无形资产；实际从事的业务未发生变更。

（三）股份公司设立后的股权变化

2003年8月26日，经中华人民共和国商务部商资二批[2003]494号文件批准，苏州固得电子股份有限公司全体发起人股东以截至2002年12月31日的累计未分配利润人民币3,000万元用于转增公司股本，公司注册资本增加为人民币10,000万元。

2003年8月，德勤华永会计师事务所有限公司对股份公司截至2003年8月15日止新增注册资本实收情况进行了审验，并出具了德师报（验）字（03）第039号《验资报告》。

发行人设立以来的股权变化情况如下：

发起人名称	整体变更时		增资后	
	持股数 (万股)	占总股本比例	持股数 (万股)	占总股本比例
苏州通博电子器材有限公司	4,015.20	57.36%	5,736.00	57.36%
香港润福贸易有限公司	2,368.80	33.84%	3,384.00	33.84%
香港宝德电子有限公司	336.00	4.80%	480.00	4.80%
上海汇银（集团）有限公司	140.00	2.00%	200.00	2.00%
苏州爱普电器有限公司	140.00	2.00%	200.00	2.00%
合 计	7,000.00	100%	10,000.00	100%

2004年12月22号，企业注册号变更为：企股苏总字第000377号，登记机关为江苏省工商行政管理局。

（四）本公司与台湾固得的关系

1、台湾固得的基本情况

台湾固得的全称是“台湾固得电子股份有限公司”，注册地在中国台湾地区，总股本2,800,000股，每股面值为10元新台币（总注册资本约合人民币700万元），主要股东陈王碧缘持股43%、陈鉴章持股40%、凤葆恒持股2%。

台湾固得的主营业务是电子零件加工制造买卖等，自2003年以来基本已经停止了生产经营。截止到2003年12月31日，台湾固得的总资产为139,160,574元新台币（约合人民币34,790,143.5元），2003年度的净利润1,741元新台币（约合人民币435.25元）。

台湾固得的对外投资情况是：对固铨科技（芜湖）有限公司出资40万美元，占出资总额100%；对固镓电子（芜湖）有限公司出资130万美元，占出资总额100%；对济南固得电子器件有限公司出资95.202万美元，占出资总额37%（济

南泉港科技发展有限公司出资比例为 63%)。

2、1999 年 7 月至 2001 年 12 月，台湾固得是固得有限的股东之一，但从未控制过固得有限，出资情况参见本节相关内容。在此期间台湾固得与固得有限只有投资与被投资关系，并无其他业务合作，陈王碧缘、陈鉴章担任公司董事职务，但并不参与公司的具体经营管理；台湾固得退出前后，固得有限均能独立生产经营，完全不依赖于台湾固得。

3、台湾固得退出固得有限

2001 年，台湾固得发生财务困难，负债总额一亿六千万元新台币，根据台湾台北地方法院的“支付命令”和“民事裁定”，台湾固得需要向债权人偿还超过玖仟万元新台币（约合人民币 2,400 余万元）的债务。

2001 年 12 月 27 日，香港润福与台湾固得达成债务重组协定并签订《股权转让协议》，香港润福代替台湾固得偿还金额为 7,000 万新台币(约合人民币 1,750 万元) 债务，同时以 169.2 万美元（约合人民币 1,404.36 万元）的价格受让台湾固得对固得有限 33.84%的出资，该转让价格低于台湾固得当时拥有固得有限按净资产相应比例计算的权益（约合 2,445.99 万元人民币）。考虑到香港润福承担了台湾固得部分债务，实际转让价格约合 3,154.36 万元人民币，台湾固得向香港润福转让对固得有限的出资实际溢价 28.96%。

本次出资转让完成后，香港润福委托陈王碧缘、陈鉴章继续担任董事职务，但对董事会不构成控制；2003 年 10 月 28 日，公司 2003 年度第一次临时股东大会同意陈鉴章、陈王碧缘辞去公司董事职务，香港润福提名乐琪担任董事。

4、台湾固得退出固得有限时所作的承诺

鉴于台湾固得与固得有限的商号相同、商标类似，台湾固得在与香港润福签订《股权转让协议》前，于 2001 年 12 月 1 日出具了承诺函，承诺内容包括：

(1) 除固得有限和济南固得外，未给予其它任何企业使用“固得”商号，也不会给予新的企业使用该商号；

(2) 停止所有“固得”商标指定使用商品的生产活动，上述商标也随之停止使用，并且今后不再使用上述商标；

(3) 未在其他任何国家和地区使用“固得”商标及办理商标专用权注册登记，亦未授权或者许可济南固得、固铨科技使用上述商标；

(4) 对固得有限使用“固得”商标在台湾和其它地区进行的经营、销售行为不予干涉、限制或任何妨碍。

5、保荐人（主承销商）及律师对上述事项进行了核查确认

保荐人（主承销商）爱建证券认为，目前台湾固得与发行人不构成关联关系，也不形成同业竞争；台湾固得（或其实际控制人）不存在通过香港润福、苏州爱普、上海汇银（或他们的实际控制人）对发行人间接持股的情况；台湾固得及其实际控制人与发行人现有董事、监事或高级管理人员不存在关联关系。

中伦金通律师事务所认为，发行人与固铨科技商号不具有相同和相似性，与台湾固得、济南固得商号相同情况是由于历史原因形成的，且各自的商号分别根据不同的法律制度或者经不同行政区划的企业登记主管机关核准，其商号使用权取得途径不存在法律冲突。

（五）本公司与江苏固得的关系

1、江苏固得清算前与固得有限的业务往来

江苏固得电子有限公司是香港明申公司投资创办的外商独资企业，1990年11月12日在国家工商行政管理局登记注册，注册地江苏省吴县通安镇，最初成立时注册资本120万美元，后追加投资注册资本增至216万美元，实收资本195.15万美元。

江苏固得自1991年正式开始生产至1997年下半年终止经营期间，主要从事对固得有限产品的精加工和销售。由于市场环境的变化以及固得有限欲建立自身完整的产销体系等原因，江苏固得的生产经营能力受到很大制约，资产质量逐年下滑，直至无法维系其正常的生产经营。1997年6月20日江苏固得董事会形成决议，决定提前解散、终止经营，并成立了清算委员会。

2、江苏固得的债务清算

鉴于固得有限是江苏固得最主要也是唯一申报的债权人，江苏固得清算委员会于1998年5月20日出具了《江苏固得电子有限公司清算方案》，确定将江苏

固得账面资产全部划转给固得有限，同时由固得有限承担江苏固得的全部债务。固得有限接受了江苏固得的全部资产和负债，并对江苏固得其他债权债务作出了处理。上述清算安排保证了固得有限合理债权利益的全部实现，也保护了其他未申报债权人的利益。

1998年9月江苏固得清算委员会向吴县工商行政管理局提交注销申请，当年11月18日江苏固得经苏州工商行政管理局核准注销登记。

3、关于苏州固得从江苏固得获得部分土地使用权的情况

江苏固得清算前拥有位于苏州市相城区通安镇面积 22,240 平方米的土地使用权，原值人民币 3,012,853.00 元，土地使用证载明年限为 1994 年 4 月 19 日至 2044 年 4 月 18 日。1998 年 6 月，根据江苏固得清算方案，固得有限经法定程序以承债方式取得上述土地使用权及附属房屋建筑物产权。

根据 2001 年 9 月 10 日相地转合(2001)第 5 号《国有土地使用权转让合同》，上述土地由江苏固得正式划转至固得有限，国有土地使用证编号为相国用(2001)字第 13107 号。该土地使用证已于 2002 年 12 月 16 日变更至股份公司名下，土地使用证编号为相国用(2002)字第 00310 号。

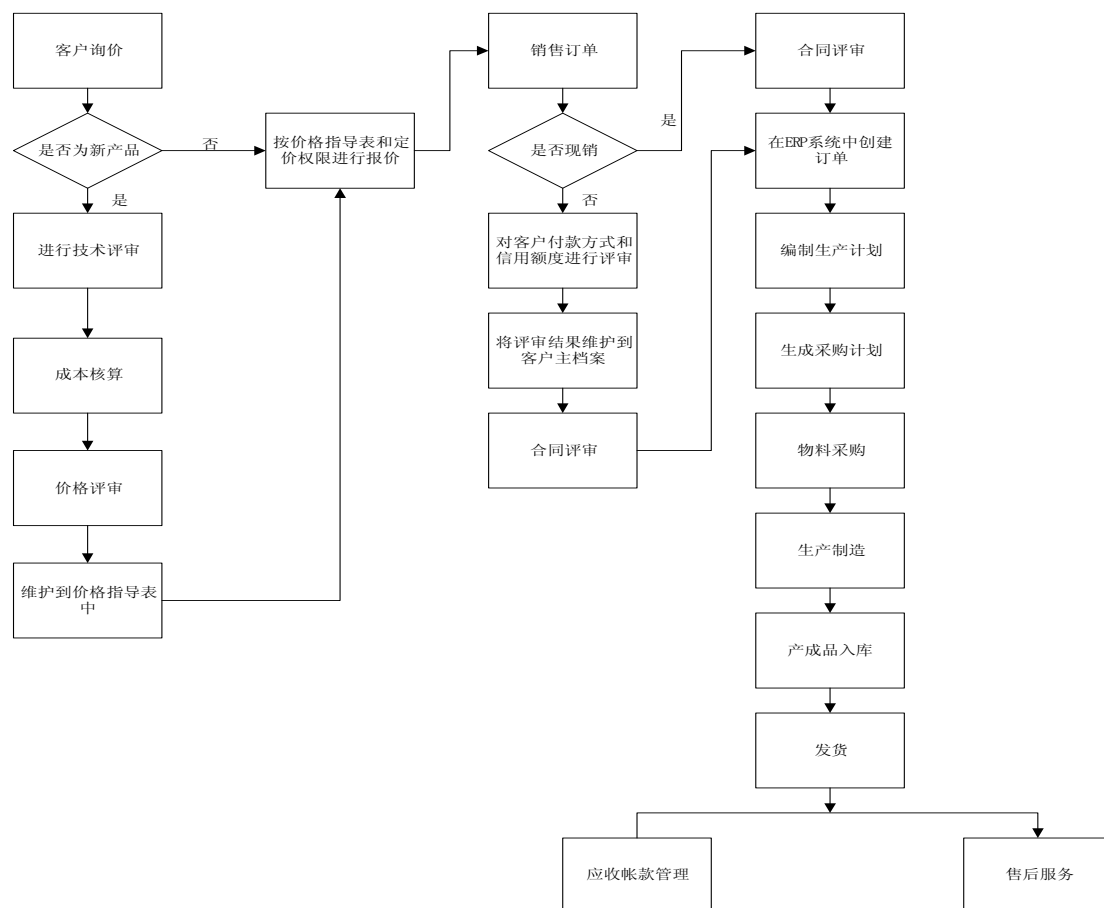
2006 年，公司将已取得使用权的相邻地块并入上述土地并取得了新的土地使用证，编号为苏新国用(2006)第 002993 号，面积扩大为 28,098.1 平方米。

三、发起人的主要资产和实际从事的主营业务

本公司改制设立前及成立之后主要发起人的资产及业务情况参见本章“股东基本情况”相关内容。

四、公司的业务流程

本公司系有限责任公司整体变更设立，设立前后公司业务流程没有发生变化。发行人主要业务流程图如下：



五、公司成立后在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变

本公司成立后与各发起人的关联关系未发生变化，公司与下列发起人股东存在生产经营方面的关联交易：

1、本公司向控股股东——苏州通博租赁位于苏州市侍其巷 25 号的办公楼及食堂，同时向其租赁部分辅助生产设备；

2、香港宝德是本公司在香港地区的经销商。

具体的关联交易情况参见第七章“同业竞争与关联交易”相关内容。

六、发行人生产经营的独立性和完整性

（一）业务、资产、人员、机构、财务与股东分开情况

1、业务独立情况

发行人主要从事设计、制造和销售部分二极管芯片及各类二极管。在业务上与股东之间不存在竞争关系，拥有独立的产、供、销系统，独立开展业务。

2、资产完整情况

发行人自成立之日起，即拥有独立完整的采购、生产和销售系统及配套设施。与此相关的有形资产和商标等无形资产也全部由本公司独立拥有。

3、人员独立情况

发行人董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，不存在高级管理人员在控股股东单位及其他股东单位兼职的情况，公司的人事及工资管理与股东单位严格分离；公司与每个员工签订了劳动合同，制定了《劳动人事管理办法》、《工资管理办法》等各项管理制度，劳动、人事及工资管理完全独立。

4、机构独立情况

发行人经过多年的运作，已逐步建立了适应公司发展需要的、功能比较完整的组织管理机构。公司各职能部门各司其责、密切合作，形成了一个有机的整体，与各股东之间不存在交叉重叠现象。发行人的组织机构完全独立于各股东单位，另发行人拥有独立、完整的经营和办公场所，其生产经营管理机构与控股股东完全分离。

5、财务独立情况

发行人拥有独立的财会部门，建立了独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和对分公司的财务管理制度；拥有独立的银行账户并依法独立纳税；公司健全了内部审计制度，设有专门的内部审计人员。

（二）业务经营能力的独立性和完整性

发行人拥有完整的经营性资产及独立的研发、经营系统；发行人与股东单位有各自独立的资产，拥有独立的产、供、销系统，在经营管理机构、人员、财务上也是独立的。因此，发行人具有独立面向市场自主经营的能力。

发行人建立了各项管理制度，不存在股东单位或政府部门有以任何形式干预或代替发行人股东大会、董事会进行决策的情形，因而可以认定发行人的机构独

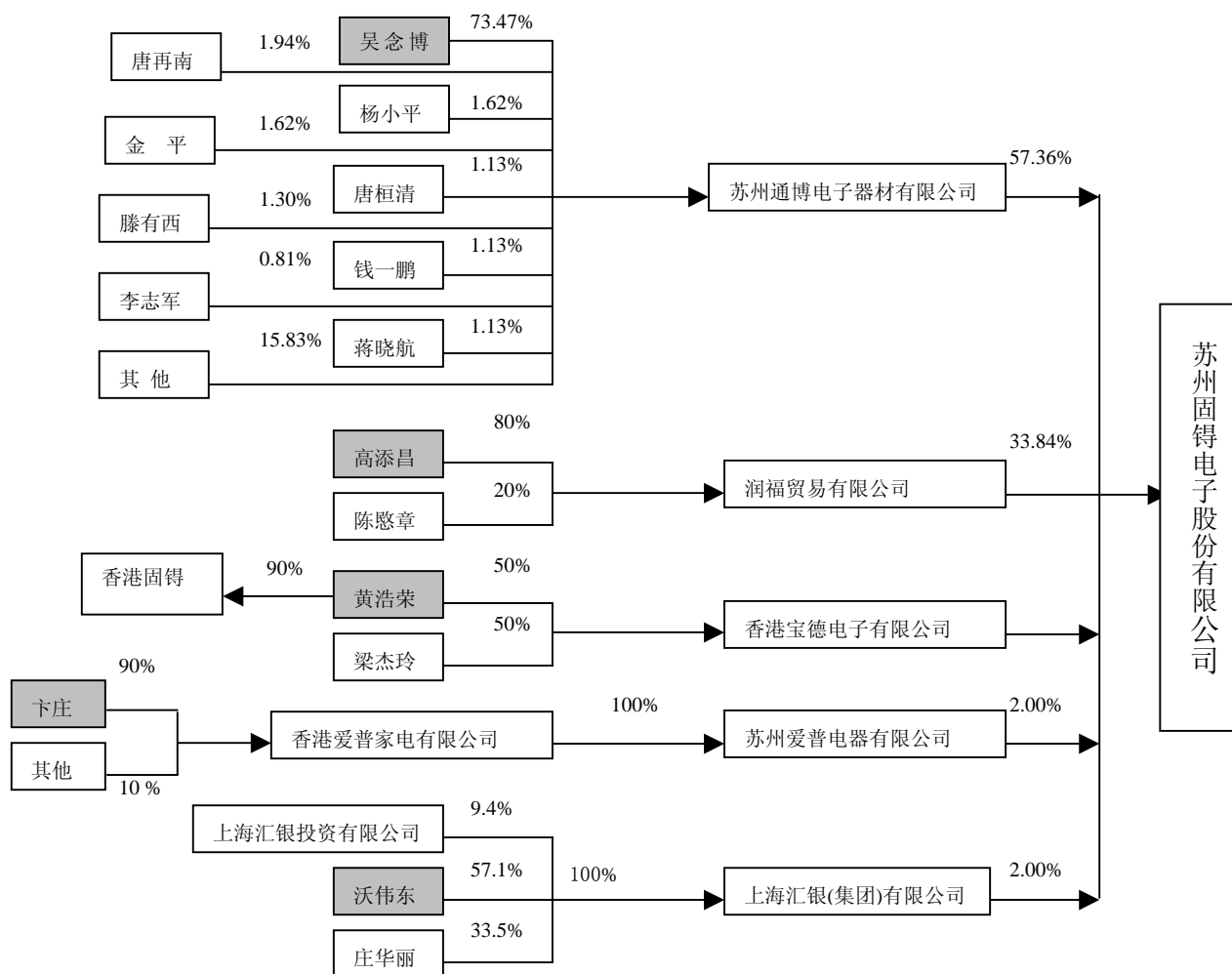
立。

(三) 供应、生产和销售系统的完整性情况

公司具有完整的供应、生产和销售系统：公司产品的原材料全部由公司采购处独立对外采购；公司拥有独立的生产系统及辅助生产设施，独立进行生产活动；公司的产品由公司国际贸易部独立对外销售。同时，公司与外方股东在销售、采购、原料供应等方面没有任何业务依赖关系。

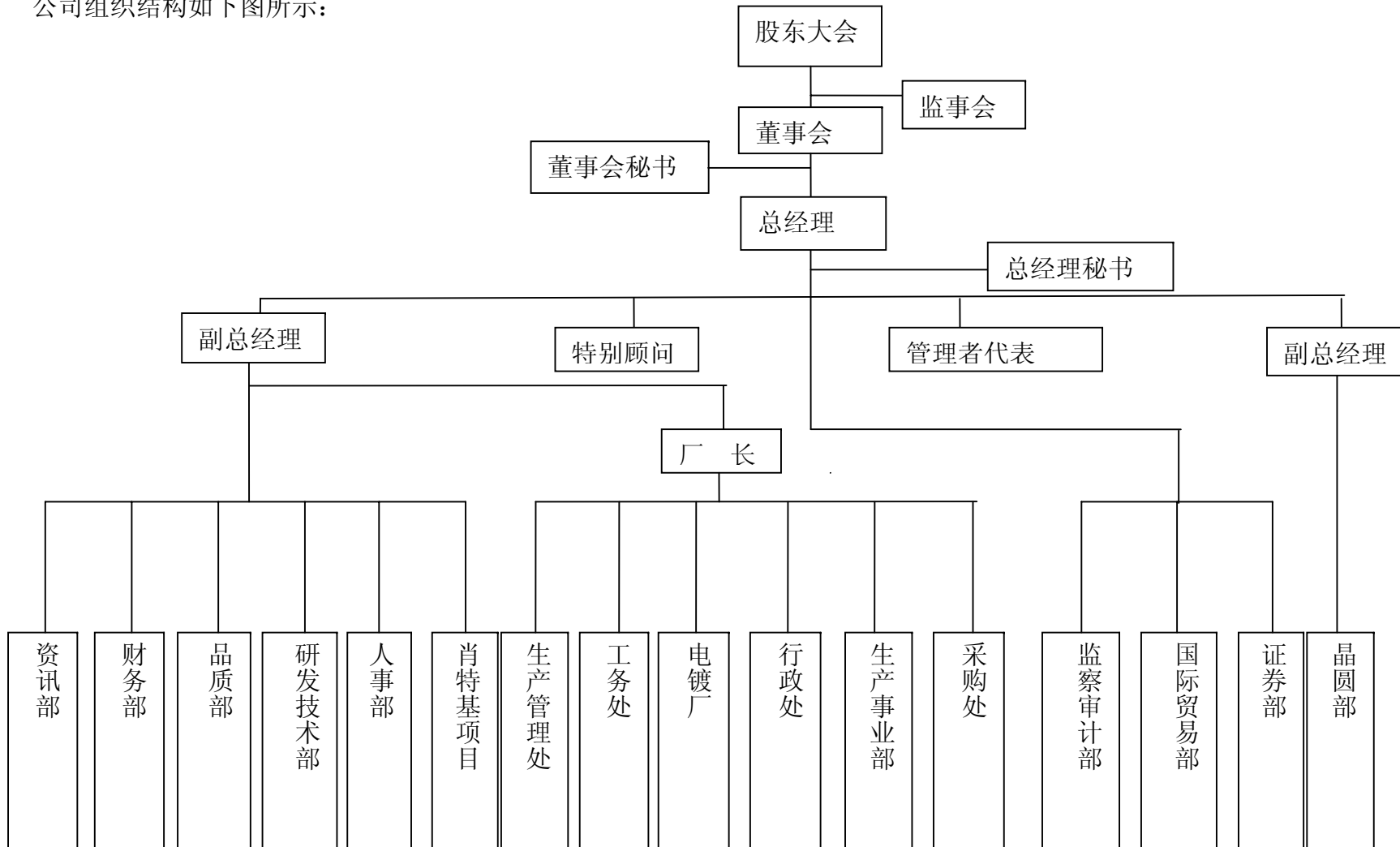
第三节 股权结构及组织结构

公司无控股、参股子公司。公司的股权结构如下图所示：



说明：阴影处为实际控制人

公司组织结构如下图所示：



第四节 发起人股东及实际控制人的基本情况

一、实际控制人——吴念博

吴念博，中国籍，1956 年出生，硕士研究生。历任苏州市无线电元件十二厂车间主任、厂长。1990 年参与筹建苏州固得电子有限公司，任副总经理，总经理。目前任本公司董事长兼总经理，同时兼任苏州通博电子器材有限公司董事、苏州固得纯净水有限公司董事长；其他社会职务包括：苏州市政协常委、苏州市工商联常务执委、苏州市仲裁委员会特聘专家组成员、加拿大纽芬兰和拉布拉多省荣誉大使。

吴念博目前对苏州通博出资 3,392 万元，占注册资本比例的 73.47%。

二、控股股东—苏州通博电子器材有限公司

苏州通博目前持有公司 57.36% 的股份，其所持有的本公司股票不存在被质押或其他有争议的情况。

住 所:	苏州市侍其巷 25 号
法人代表:	石晓萍
注册资本:	4,617 万元人民币
企业类型:	有限责任公司
股权构成:	吴念博持有 73.47% 的股份 其余 36 名自然人持有 26.53% 的股份
经营范围:	生产销售半导体器件、电子仪器、汽车电器、电脑附件及软件开发；五金加工；批发零售医疗设备等。
成立日期:	1999 年 12 月 30 日
基本财务状况 (未经审计)	截至 2006 年 6 月 30 日，总资产：16,294.45 万元，净资产：15,591.33 万元，2005 年度净利润：1,263.73 万元

苏州通博的前身为苏州市无线电元件十二厂，成立于 1981 年 3 月 23 日，原系江苏省新苏师范学校下属的校办企业。2000 年 1 月 7 日，经苏州市国有（集体）资产管理局以苏集资产字[2000]1 号《关于苏州市无线电元件十二厂改制过程中集体资产处置的批复》确认，苏州市无线电元件十二厂改制为自然人持股的有限责任公司，企业名称变更为苏州通博电子器材有限公司。

根据苏政办函[2004]68号《江苏省人民政府办公厅关于确认原苏州无线电元件十二厂改制情况的函》，苏州无线电元件十二厂的改制“符合有关法律、法规的规定，转让双方均按当时法律、法规要求办理了必要手续”。

发行人独立董事对苏州市无线电元件十二厂的产权转让价格发表了意见，认为本次产权转让价格公允；

保荐人（主承销商）及律师对苏州市无线电元件十二厂的产权转让进行了核查，确认转让程序完备、合法，转让价格公允。

三、香港润福贸易有限公司

香港润福目前持有公司 33.84% 的股份。

该发起人股东成立于 2001 年 7 月 6 日，注册资本 10,000 港币，住所为中国香港九龙旺角弥敦道 582-592 号信和中心 804 室，出资者为高添昌（出资比例 80%）及陈珉章（出资比例 20%）。

该发起人的主要资产是股权投资，其主要收入来源为股权投资收益。经中国司法部委托公证人香港李国康律师出具的《证明书》证实：该发起人已经依据香港商业登记条例在香港商业登记署办理了商业登记，登记号码为：32277841-000-07-02-8。

四、香港宝德电子有限公司

香港宝德目前持有公司 4.8% 的股份。

该发起人股东成立于 1995 年 5 月 11 日，住所为中国香港九龙土瓜湾道 94 号美华工业中心 12 字楼 A1 室，出资者为梁杰玲、黄浩荣，双方出资比例各 50%，实际控制人为黄浩荣，为该公司法定代表人。

该发起人的主要资产是股权投资，其主要收入来源和经营业务为股权投资收益和电子产品买卖。其中，股权投资收益主要来自对本公司的股权投资，电子产品买卖主要来自经销本公司产品和其他非二极管类电子产品的买卖经营。经中国司法部委托公证人香港李国康律师出具的《证明书》证实：该发起人已经依据香

港商业登记条例在香港商业登记署办理了商业登记，登记号码为：19077165-05-01-9。

五、上海汇银(集团)有限公司

上海汇银目前持有公司 2% 的股份。

该发起人股东成立于 2001 年 7 月 27 日，注册资本人民币 17,000 万元，住所为上海市万航渡路 686 号，沃伟东持有该公司 57.10% 的股份，为实际控制人并担任法人代表。

该公司的经营范围包括：实业投资，投资管理，资产重组，国内贸易（除专项规定），房地产开发（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。

截至 2005 年 12 月 31 日，该公司总资产 28,728.57 万元，净资产 17,128.11 万元；2005 年度净利润 33.47 万元。

六、苏州爱普电器有限公司

苏州爱普目前持有公司 2% 的股份。

该发起人股东成立于 1994 年 8 月 23 日，注册资本 2000 万美元，住所为江苏省苏州市苏州新区金山路 90 号，香港爱普家电有限公司持有该公司 100% 的股份，卞庄为实际控制人并担任法人代表。

该公司的经营范围为生产销售小型家用电器及电子遥控产品

截至 2005 年 12 月 31 日，该公司总资产 8 亿元，净资产 5.8 亿万元，2005 年度净利润 1.2 亿元。

第五节 发行人股本情况

一、本次发行前后的公司股本结构如下：

项目	股东名称	发行前		发行后		锁定限制 及期限
		持股数 (万股)	比例	持股数 (万股)	比例	
有限 售条 件的 股份	苏州通博电子器材有限公司	5,736.00	57.36%	5,736.00	41.57%	自上市之日起锁 定 36 个月
	香港润福贸易有限公司	3,384.00	33.84%	3,384.00	24.52%	
	香港宝德电子有限公司	480.00	4.80%	480.00	3.47%	
	上海汇银（集团）有限公司	200.00	2.00%	200.00	1.45%	自上市之日起锁 定 12 个月
	苏州爱普电器有限公司	200.00	2.00%	200.00	1.45%	
		本次发行的股份	—	—	3,800.00	27.54%
	合 计	10,000.00	100%	13,800.00	100%	—

本次发行前各股东间不存在关联关系。

二、外方股东投资合法性

1998 年 10 月香港宝德及 2001 年 12 月香港润福对固得有限投资时都已分别取得江苏省人民政府核发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》及国家工商行政管理局和江苏省苏州工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。

2002 年 8 月固得有限整体变更为股份有限公司时取得了对外贸易经济合作部核发的《台港澳侨投资企业批准证书》及国家工商行政管理总局核发的《企业法人营业执照》。

2003 年 8 月本公司以未分配利润增资时取得了商务部核发的《台港澳侨投资企业批准证书》及国家工商行政管理总局核发的《企业法人营业执照》。

香港润福和香港宝德在对本公司投资及以后的增资过程中均已通过商务部（或对外贸易经济合作部）及国家工商行政管理总局的批准，符合我国法律相关规定。

三、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺。

本公司股东苏州通博电子器材有限公司、香港润福贸易有限公司、香港宝德电子有限公司承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

股东上海汇银（集团）有限公司、苏州爱普电器有限公司承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

第六节 员工及其社会保障情况

一、员工规模及结构

截至 2005 年 12 月 31 日，本公司在册职工 882 人，职工构成情况如下：

专业结构	构 成 (人)					
	行政人员	市场人员	研发人员	生产人员	财务人员	其他
	35	32	27	555	15	218
教育程度	本科以上	大专	中专	其他		
	38	88	114	642		
专业职称情况	高级	中级	初级			
	8	28	41			
员工年龄分布	41 岁以上	30-40 岁	30 岁以下			
	83	357	442			

二、执行社会保障制度、住房制度和医疗制度的情况

本公司实行劳动合同制，员工根据与公司签订的劳动合同承担义务和享受权利。外聘员工订立《劳务协议》和《短期劳动合同》。

本公司根据国务院《社会保险费征缴暂行条例》和江苏省人民政府《江苏省

社会保险费征缴暂行条例》，以及按国家和江苏省其他有关规定，公司为员工办理了基本养老保险、失业保险及工伤保险，并执行住房补贴等福利政策；医疗保险参与苏州市社保部门的统筹保险，按规定比例承担医药费。

第七节 发行人主要股东及董事、监事、高管作出的重要承诺

本公司全部发起人股东均出具了规避同业竞争的承诺函，承诺在今后的业务中上述股东及股东的全资和控股公司及股东具有实际控制权的公司不会以任何形式从事与本公司相同或相似的业务。参见第七章相关内容。

第六章 业务和技术

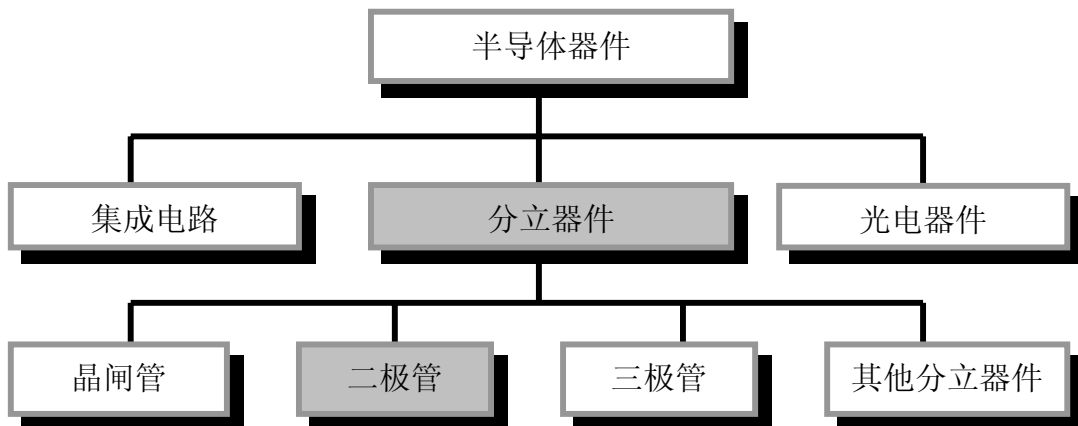
本公司的经营范围是：设计、制造和销售各类半导体芯片、各类二极管、三极管；生产加工汽车整流器、汽车电器部件、大电流硅整流桥堆及高压硅堆等相关产品；电镀加工电子元件以及半导体器件相关技术的开发、转让和服务。

本公司的主要产品为各类半导体二极管（不包括光电二极管），具备全面的二极管晶圆、芯片设计制造及二极管封装、测试能力。

自设立以来，本公司的主营业务一直未发生变化。

第一节 所处行业的基本情况

本公司所处行业为半导体元器件制造业，子行业为分立器件制造业。分立器件及二极管在半导体元器件整体结构中所处的位置如下图所示：



半导体元器件行业是国家支柱产业之一，基本遵循市场化的发展模式。

目前我国半导体行业的宏观管理部门是国家经济贸易委员会和信息产业部，主要负责产业政策、发展规划的制订及项目审批。中国半导体行业协会（CSIA）是本行业的自律机构，下设集成电路、集成电路设计、半导体分立器件、半导体

支撑业及半导体封装等专业分会，本公司是半导体分立器件分会会员单位。

一、行业及产品概览

半导体二极管是一种基础性元器件，被广泛应用于消费电子、计算机及周边设备、通讯、汽车电子、工业及自动控制、安全保护、照明、医疗等各类产品及设备。

二极管产品的分类方法多样，按照封装材料可大致分为玻璃封装、塑料封装、金属封装等；按照安装工艺可大致分为轴向型（Axial Lead）、插入式（THT，Through Hole Technology）及表面安装（SMT，Surface Mount Technology）等；根据产品功能及用途，半导体二极管可大致做如下分类：

名称	分类或功能
整流二极管	将交流电转换成单一方向的脉动直流电，包括一般整流二极管、高速整流二极管、高效整流二极管、超高速整流二极管、肖特基整流二极管、汽车整流器及整流桥堆等。
稳压二极管	提供固定偏压和过压保护，包括齐纳稳压管和瞬态电压抑制稳压管等。
开关二极管	在电路中起开关作用
特殊用途二极管	包括双向触发二极管、限幅二极管、检波二极管、雪崩二极管、变容二极管等

二极管的应用范围及代表性产品如下表所示：

应用类型	产品名称	所需二极管
计算机类	手提电脑、掌上电脑、显示屏、DVD、硬盘等	玻封稳压管,开关管,表面安装塑封二极管,桥堆系列
通讯电信类	手机、cable modem、网卡等	低能耗的肖特基系列二极管,HER、SF系列二极管及微型桥堆系列
消费电子类	电冰箱、数码相机、机顶盒、电吹风、微波炉、吸尘器、电度表	普通塑封管,玻封开关管,桥堆系列,高反压二极管系列
汽车电子类	汽车整流器、汽车音响、汽车空调、ABS 控制器、气囊和车内巡航控制以及导航系统	金属壳功率管,桥堆系列
工业自动化系统	光机电一体化、工业电子整流器、变频器、机器人等	各种类型二极管
照明电路	调光灯、节能灯	照明电路专用二极管
电源电器类	UPS（不间断电源）、计算机电源、充电器等	桥式整流器系列,玻封二极管,FR,HER系列二极管

二、行业经营模式及竞争格局

1、全球二极管行业综述

全球二极管行业的主要厂商基本均为分立器件或半导体器件行业巨头，除二极管产品外，也从事其他分立器件或集成电路的设计、生产，具备非常全面的整合能力；从地域分布来看，主要集中在日本、美国和欧洲。

日本的分立器件产品销售额占全球的 50% 以上，全球前 20 大分立器件厂商中日本厂商占 10 家，包括东芝（TOSHIBA）、瑞萨（RENESAS）、罗姆（Rohm）、松下（Matsushita）、NEC、三肯（Sanken）、富士电气（Fuji Electric）、三洋（Sanyo）、新电元（Shindengen Electric）以及富士通（Fujitsu）等。虽然近年来受到来自韩国及中国台湾地区厂商越来越大的挑战，但日本仍是目前全球分立器件市场最重要的组成部分。

美国厂商在全球分立器件市场具有举足轻重的地位，代表厂商包括威旭（Vishay）、飞兆半导体（Fairchild Semiconductors）、国际整流器公司（International Rectifier）以及安森美（On Semiconductors）等。

欧洲也是分立器件产业发达的地区，主要厂商包括飞利浦半导体（Philips Semiconductors）、意法半导体（ST Microelectronics）和英飞凌（Infineon Technologies）等。

亚太地区是近年来半导体市场发展最为迅速地区，韩国、中国台湾、新加坡、马来西亚等国家和地区电子信息制造业的高速发展为本地半导体市场提供了广阔的需求空间，目前全球半导体市场的增长主要是由亚太地区支撑，但分立器件企业的规模相对还比较小，进入世界前 20 大分立器件厂商的企业仅有韩国电子（KEC）一家。

2、国内二极管及分立器件行业的特点

国内半导体分立器件行业的增长潜力十分巨大，2005 年市场规模达到 643.8 亿元，在全球市场中所占份额超过 40%，已经成为全球最大的分立器件市场。预计未来 5 年国内分立器件市场规模还将以 20% 左右的速度增长，到 2010 年时将超过 1500 亿元。

国内二极管及分立器件制造业的迅速崛起主要基于两个原因，一是国内需求

的不断增长，二是国外厂商制造能力的转移。

全球主要的二极管及分立器件厂商出于贴近市场和节约成本的双重考虑，均在中國大陸积极寻找合作伙伴，通过并购、合资、OEM等方式将生产能力转移，目前主要的国际厂商均在国内设立了生产基地。跨国公司扩大在华生产规模带动了国内的产业升级，对于提高国内分立器件行业整体技术水平起到了积极作用，是国内企业的一次发展契机。

目前国内从事二极管生产的厂商约有 130 家，主要分布在长江三角洲、珠江三角洲、环渤海地区和广东、四川的部分地区。2003—2005 年国内二极管（不含光电二极管）市场产品结构如下表所示：

产品小类	2005		2004		2003	
	销售量 (亿支)	同比增长 (%)	销售量 (亿支)	同比增长 (%)	销售量 (亿支)	同比增长 (%)
开关二极管	300.62	10.7	271.56	39.9	194.11	28
肖特基二极管	266.19	12.5	236.61	45.1	163.07	25.9
整流二极管	185.68	9.4	169.73	37.5	123.44	22.2
稳压二极管	116.8	8.2	107.95	27.4	84.73	21.2
变容二极管	71.77	7.3	66.89	29.6	51.61	24.4
触发二极管	29.99	6.5	28.16	25.6	22.42	22.5
硅堆	4.9	5.2	4.66	22.5	3.8	18.8
其它	15.95	3.9	15.35	10.0	13.96	8.9
整体合计	991.9	10.1	900.91	37.1	657.12	24.5

数据来源：CCID 2005，2004，2003

国内分立器件产业虽然目前已经得到相当程度的发展，但无论在企业规模还是技术水平上，均是独资/合资企业占据主体。根据 CCID 的统计数据，从目前市场占有率来看，外资品牌产品占据了国内市场的绝大部分销售份额，2005 年只有两家国内企业能够进入中国分立器件市场销售额前 20 强。

核心技术缺失是制约国内二极管企业健康发展的主要瓶颈。在国内二极管行业竞争加剧的背景下，国内厂商将不可避免地出现分化：部分厂商正逐步把生产和研发向中高端产品转移，而缺乏技术升级能力的厂商将被迫继续集中在低端和普通产品领域进行竞争，并可能陷于经营危机。

三、影响行业发展的因素

1、有利因素——下游行业的市场需求潜力巨大

从需求比重上来看，二极管和分立器件产品主要供应消费电子、通信和 PC 这三个行业。近年来消费电子产品的需求增长尤其突出，2004 年消费电子市场首次超过企业设备市场成为全球半导体最大的市场需求领域，并与无线产品共同推动了全球半导体行业 2004 年以来的复苏。

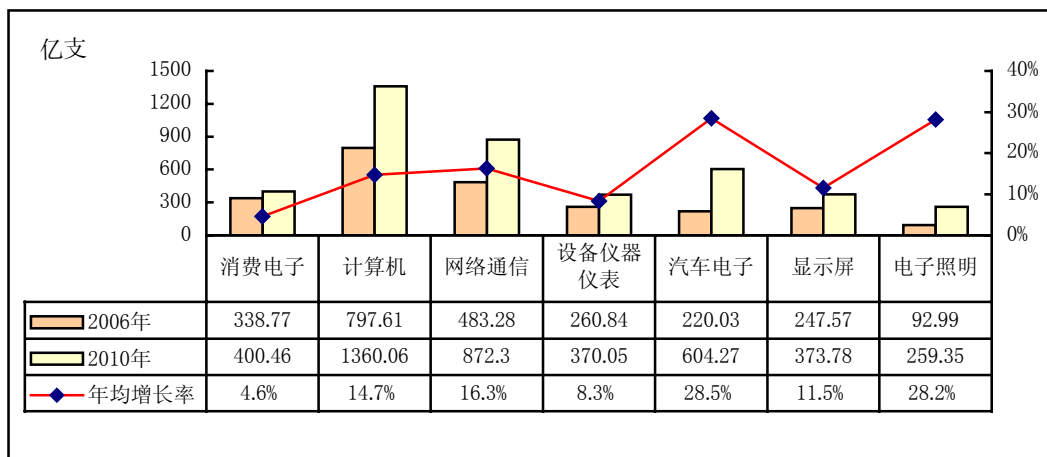
从需求增长速度来看，根据 CCID 的预测，汽车电子及照明设备将是未来 5 年对包括二极管在内的分立器件需求增长最快的两个领域。

目前中国汽车产业已经步入高速增长期，国内从事汽车电子电器生产的企业已经达到 1000 多家，国外汽车电子供应商也在国内建立了大量合资生产企业，占国内汽车电子企业总数的 70%。近年我国新建的汽车零部件合资企业中，几乎 90% 以上是与跨国公司合资的汽车电子企业。而电子产品占轿车生产总成本的比例正在逐步提高，目前已由 16% 增至 25% 以上。CCID 预计未来 5 年汽车电子领域对分立器件的需求增长将高达年均 28.5%，到 2010 年时期市场需求量将达到 604.27 亿支。

照明设备对分立器件产品需求量的增长将达到年均 28.2%，仅次于汽车电子设备对分立器件需求的增长速度，其中节能灯产品和电子镇流器是需求量最大的产品。

除了上述新兴市场领域外，其它应用领域将保持稳定增长的势头，CCID 预计各领域的年均复合增长率将分别为：消费电子 4.6%，计算机与外设 14.7%，显示屏 11.5%，设备与仪器仪表 8.3%。

2006—2010 年中国分立器件应用结构预测情况如下：



数据来源：赛迪顾问 2006，02

由于下游行业的庞大需求，二极管行业将保持稳定的高速增长趋势。2005年国内二极管销售额为77.3亿元人民币，占分立器件市场总值的12%。根据CCID的预测，2006—2010年国内二极管需求的复合增长率为14.1%，销售额到2010年将达到149.53亿元。

2、不利因素

影响本行业发展的不利因素主要包括行业周期的影响、中低端产品价格下滑及原材料价格的波动导致的毛利率下降。参见第四章“风险因素”相关内容。

3、进出口政策可能导致的影响

根据“环球资源”（globalsources.com）发布的数据，目前中国企业在全球中低端二极管和二极管模组市场的份额已经达到80~90%，2004年合计出口150亿件二极管和二极管模组，预计接下来两年中出口年均增长率将继续保持在20%，并在2006年突破210亿件。

尽管国内二极管行业的出口销售增长迅速，但与国际厂商的定位并不冲突，事实上相当一部分生产能力是由国外厂商转移而来，不会对相应产品进口国的国内产业造成冲击，同时我国二极管行业开放程度较高，竞争充分，所以产品出口一般不会导致与进口国的贸易摩擦。

四、行业技术特性及发展趋势

在半导体元器件市场中，尽管产品集成化的发展趋势引人瞩目，但半导体分立器件的应用仍不可替代，特别是大功率、大电流、高反压及低噪声分立器件，由于其不易集成或集成成本高，具有非常广阔的发展空间；即便是集成技术难度较低的小信号晶体管，由于分立器件明显的价格优势，也仍具有相当稳定的市场空间。

现阶段分立器件和半导体二极管行业的技术发展趋势呈现以下两大特点：

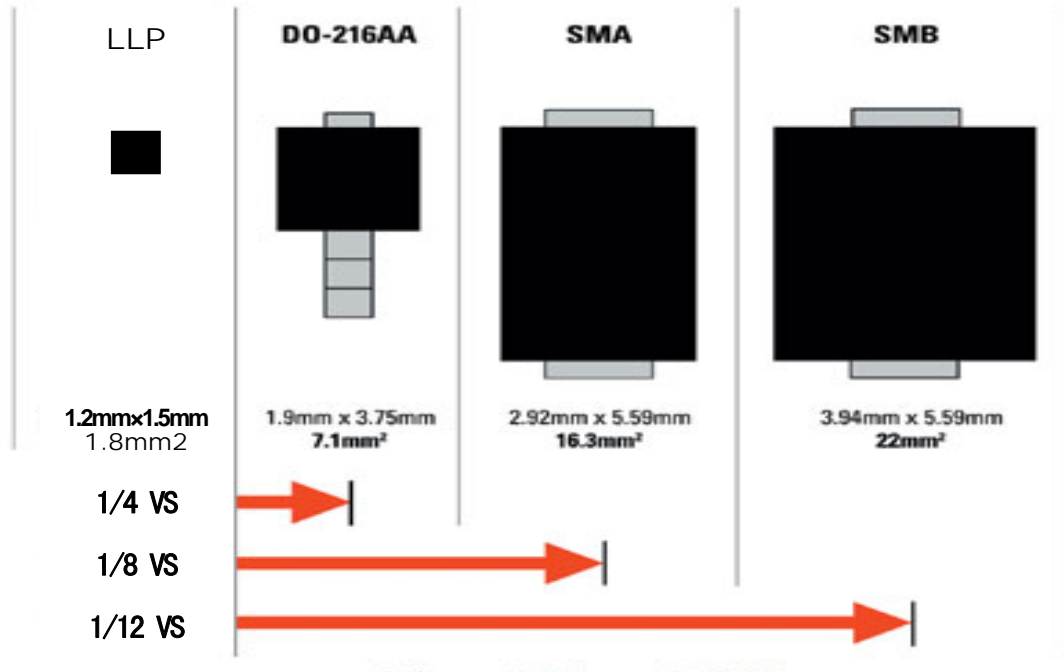
1、集成电路制造技术不断融入前道制造工艺中

目前，集成电路领域的 CAD 设计、离子注入、溅射、MOCVD、多层金属化、亚微米光刻等先进工艺技术已经开始逐步应用到分立器件的前道芯片生产当中，如过去一直不能工业化生产的肖特基二极管，由于净化、外延、离子注入、多层金属化等新工艺技术的应用，目前其大规模生产条件下的成品率已经可以达到 98% 以上。

2、表面贴装技术逐步成为封装工艺主流

随着科技进步和产品需求的不断提高，半导体二极管的封装正向着体积越来越小，重量越来越轻，功能越来越强的方向高速发展，而 SMT（表面贴装技术）取代 THT（通孔直插式安装技术）则是这一发展中的重大技术突破；新一代表面安装器件正朝向芯片级（Chip Scale）封装方向发展，空间特性和性能参数均得到进一步的改善，代表产品如 LPP（无引线包装）器件：这类产品在封装体积大大缩小的同时，频率响应等参数也得到改善，同时与下游厂商的自动安装生产设备保持兼容。典型应用产品包括各种便携设备，如手机、PDA、笔记本电脑、便携式音/视播放器等，也可以用于硬盘驱动器等对空间和性能要求较高的设备。

LLP 与其他产品封装形式的外观尺寸直观对比如下：



第二节 本公司面临的主要竞争状况

一、行业地位

根据 CCID 的统计，2005 年本公司在国内分立器件生产企业（含所有分立器件制造及封装测试企业）中销售收入排名第 5。

2005 年国内销售收入前 10 大分立器件生产企业如下表所示：

	企业名称	产量（亿支）	销售收入(万元)
1	江苏长电科技股份有限公司	113.84	147476*
2	乐山无线电股份有限公司	199.08	144347
3	深圳赛意法微电子有限公司	11.41	89514
4	吉林华微电子股份有限公司	14.09	61290*
5	苏州固得电子股份有限公司	47.26	37771
6	无锡华润华晶微电子股份有限公司	36.75	37609
7	天津中环半导体有限公司	7.72	34409
8	深圳深爱半导体有限公司	6.37	30936
9	佛山市蓝箭电子有限公司	39.31	22340
10	扬州晶来半导体（集团）有限公司	5.49	21399

数据来源：CCID，以*号标示的数据根据公开披露信息进行了修正

本公司的主要竞争对手分为两类：一类为专业封装测试企业，其特点是封装

能力突出，但自身不具备晶圆生产能力；另一类为分立器件综合生产企业，其特点是产品范围宽，包括晶体管等其他分立器件，但二极管的专业生产能力不突出。本公司的综合竞争优势在于：专注于二极管产品的生产销售，具备前道工序的整合能力，同时拥有较为全面的封装测试能力、先进的质量控制体系和成本优势。

本公司将继续扩大晶圆及芯片的生产能力并提高技术水平，进一步完善封装测试能力，稳定保持本公司在国内半导体分立器件行业前 10 名、二极管分行业首屈一指的地位。

二、主要竞争对手的简要情况

下述公司主要竞争对手的相关信息来源于 CCID 行业资料及公开披露信息。

1、江苏长电科技股份有限公司

长电科技的主要分立器件产品包括开关二极管、肖特基二极管、齐纳二极管、可控硅、稳压电路、普通三极管、达林顿三极管、开关三极管、高压三极管、功率管与功率开关管、场效应管。该公司除分立器件封装业务外还从事集成电路封装业务，近年产销情况（包括集成电路封装业务）详见下表：

	2001 年	2002 年	2003 年	2004 年	2005 年
产量(亿支)	28.69	49.08	74.83	89.63	113.84
销售收入(亿元)	8.17	5.10	8.94*	11.85*	14.75*

数据来源：赛迪顾问 2006，02，其中以*号标示的数据根据公开披露信息进行了修正。

2、乐山菲尼克斯有限公司

由安森美、摩托罗拉及乐山无线电有限公司共同投资，主要产品为小信号和射频表面安装器件产品的装配和测试，近年产销情况详见下表：

	2001 年	2002 年	2003 年	2004 年	2005 年
产量(亿支)	94.73	162.74	174.67	185.59	199.08
销售收入(亿元)	6.76	10.03	11.73	13.36	14.43

数据来源：赛迪顾问 2006，02

3、深圳赛意法微电子有限公司 (STS)

由意法半导体与深圳赛格高技术投资公司共同投资，主要从事集成电路和半导体分立器件的封装、测试业务，主要产品有功率 MOS 器件、电压调节器、E

2 PROM、ASIC 及标准线性电路等，近年产销情况详见下表：

	2001	2002	2003	2004	2005 年
产量(亿支)	4.22	5.85	6.51	8.85	11.41
销售收入(亿元)	3.03	3.66	3.76	4.34	8.95

数据来源：赛迪顾问 2006，02

4、吉林华微电子股份有限公司

国内主要的功率半导体产品生产企业之一，产品包括普通二、三极管、节能灯用大功率晶体管、达林顿管、固体放电管、可控硅系列产品、机箱电源、肖特基等，芯片生产能力约 100 万片/年，封装/测试能力约 15 亿只/年，近年产销情况详见下表：

	2001 年	2002 年	2003 年	2004 年	2005 年
产量(亿支)	3.84	4.55	7.64	6.59	14.09
销售收入(亿元)	2.6	3.33	3.72*	4.32*	6.13*

数据来源：赛迪顾问 2006，02，其中以*号标示的数据根据公开披露信息进行了修正。

5、无锡华润华晶微电子股份有限公司

该公司主要制造半导体分立器件和双极电路产品，3 英寸晶圆生产能力约 1 万片/月，4 英寸晶圆生产能力约 0.5 万片/月，并拥有年产 2 亿支中小功率管、3000 万支大功率以及 6000 万支可控硅的后封装线。主要产品包括家用视听设备用晶体管、音响功率晶体管、节能灯电子镇流器用晶体管、高频放大晶体管、开关管、达林顿管、变容二极管、可控硅、超高频微波低噪声晶体管等。近年产销情况详见下表：

	2001 年	2002 年	2003 年	2004 年	2005 年
产量(亿支)	24.61	31.15	39.87	55.7	36.75
销售收入(亿元)	2.83	2.58	2.73	3.42	3.76

数据来源：赛迪顾问 2006，02

6、天津中环半导体有限公司

该公司主要生产高压硅堆、硅整流二极管、硅桥式整流器等三大类产品，近年产销情况详见下表：

	2001 年	2002 年	2003 年	2004 年	2005 年
产量(亿支)	2.82	4.30	6.01	7.33	7.72
销售收入(亿元)	1.31	1.89	2.63	3.03	3.44

数据来源：赛迪顾问 2006，02

7、深圳深爱半导体有限公司

该公司是具有前、后工序生产线的功率半导体器件生产企业，生产双极型功率晶体管、达林顿管、可控硅、肖特基管等 20 多个品种的产品，月产 4 英寸晶圆片约 2 万片，年封装能力约为 2 亿支。该公司以绿色照明用晶体管及各种电源用晶体管为主导产品，主要包括节能灯用晶体管、双极功率晶体管、肖特基二极管、可控硅，近年产销情况详见下表：

	2001 年	2002 年	2003 年	2004 年	2005 年
产量(亿支)	7.59	9.31	15.47	19.5	6.37
销售收入(亿元)	1.37	1.38	1.87	2.45	3.09

数据来源：赛迪顾问 2006.02

第三节 本公司的主营业务

一、本公司的主要产品及用途















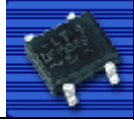






本公司的主要产品包括：3 英寸、4 英寸晶圆及芯片，玻璃钝化整流二极管等 14 类整流二极管，齐纳稳压管等 2 类稳压二极管，各种高速开关二极管和硅双向触发二极管。

本公司生产的二极管安排按功能分类如下：

产品类别	产品名称	用途	
整流二极管	一般整流二极管	玻璃钝化整流二极管	低频交流电源整流
		通用塑封整流二极管	同上
		高反压整流二极管	高压低频交流电源整流
		电子节能灯专用整流二极管	专用于电子节能灯
	高速整流二极管	玻璃钝化快速恢复整流二极管	较高频率的交流电源整流
		快速恢复整流二极管	同上
	高效整流二极管	玻璃钝化高效整流二极管	高频交流电源整流
		高效整流二极管	同上
	超高速整流二极管	玻璃钝化超快速整流二极管	超高频交流电源整流
		超快速恢复整流二极管	同上
	肖特基整流二极管	小功率肖特基整流二极管	甚高频交流电源整流
		大功率肖特基整流二极管	甚高频大功率电源整流
	汽车整流器	汽车整流器	
	桥堆	桥式整流器	电源整流(全/半桥)
稳压二极管	齐纳稳压管	直流电源稳压用	
	瞬态电压抑制稳压管	防止外来瞬间冲击的可恢复性保护器	

开关二极管	高速开关二极管	高速开关电路
硅双向触发二极管	硅双向触发二极管	双向可控硅触发元件

根据产品的安装工艺、外形及封装形式，本公司产品大致可作如下分类：

类别		型号及外观							
轴向式	塑封	R-1		R-6		DO-41		DO-201	
	玻封	DO-34		DO-35					
	金属封装	DO-5							
穿孔式	ITO-220AB		TO-220AB		2S 3S 5S				
	DF		Mini-Bridge		KBPC		KBPC-W		
贴片式	DFS		DO-214AA		DO-214AB		DO-214AC		
	MELF		Mini MELF		LLP				

关于本公司产品的详细分类请参考本公司网站（www.goodark.com）及《产品目录》。

二、主要产品的生产流程

二极管的生产可以分成上、中、下游三道主要工序：

单晶、外延片制造 → 芯片制造 → 封装、测试

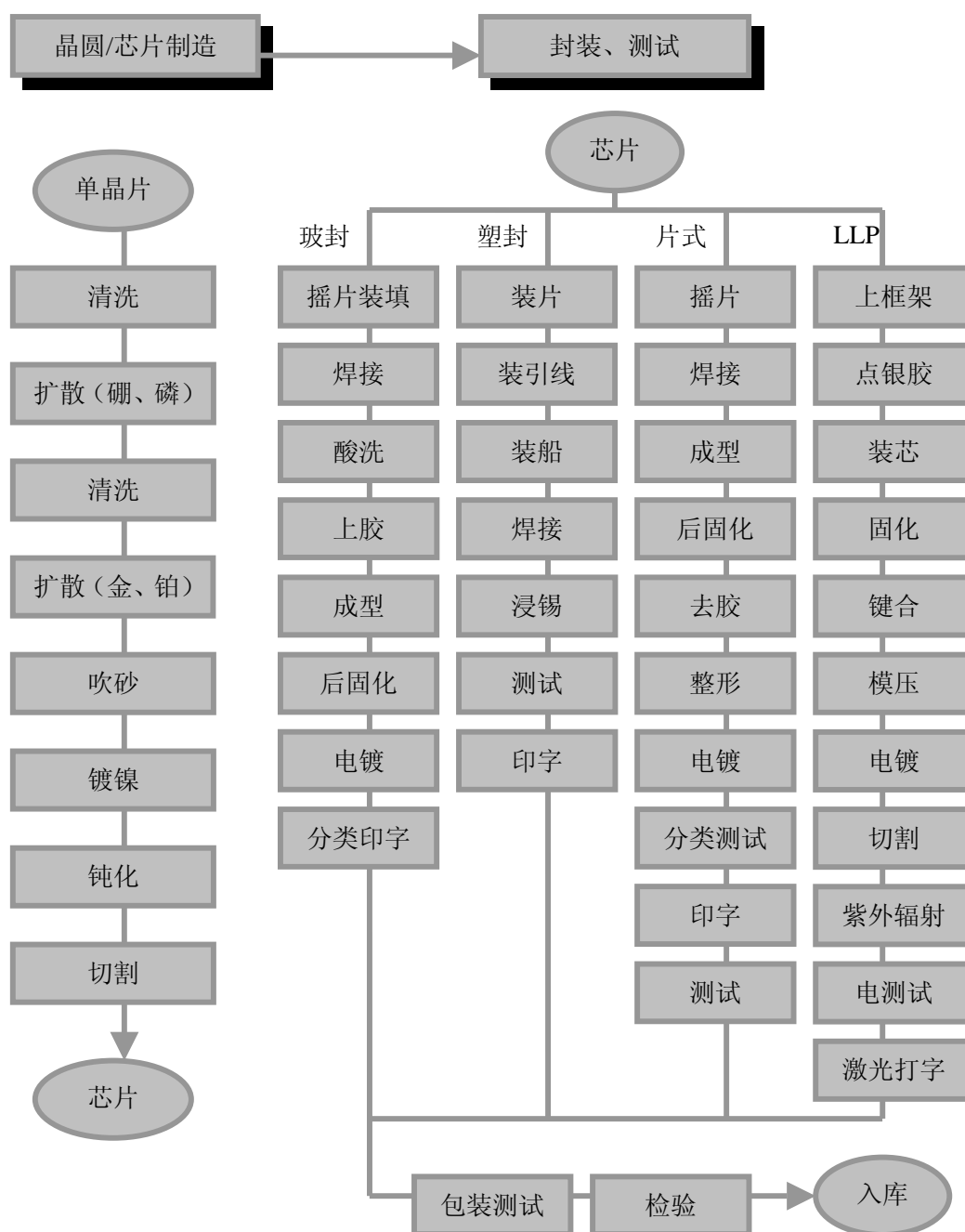
本公司的工艺流程是从外购单晶或外延片开始，到最后二极管封装测试完成，以产成品出货。

单晶、外延片制造工序的任务是提供生产二极管的原材料——单晶或外延片；中游是晶粒或芯片制造，任务是将单晶或外延片加工成分立器件的核心部件

——芯片，芯片的特性决定了最终成品元器件的特性，其技术含量在各工序中最高；下游是封装、测试，制造成品。

二极管产品的封装、测试工艺流程根据产品的封装及安装工艺分类存在较大的区别，大致可按照玻封（玻璃封装）、塑封（塑料封装）、片式（表面贴装）及LLP（无引脚封装）产品分成四种形式。

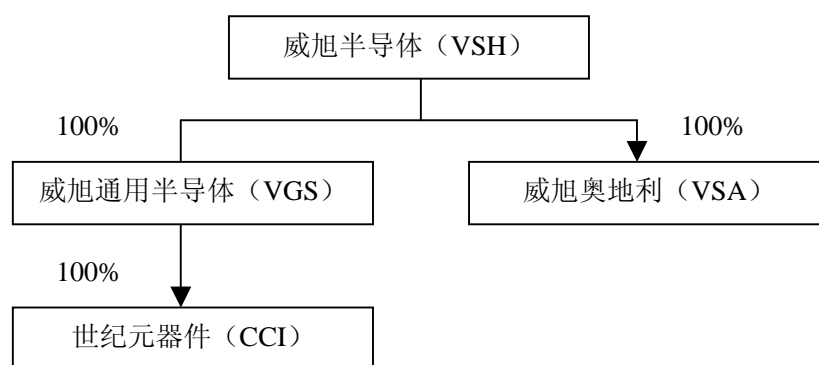
简要生产工艺流程如下图所示：



三、OEM 业务相关背景

OEM 业务是公司收入和利润的重要来源。目前公司 OEM 客户包括威旭通用半导体公司 (Vishay General Semiconductor, LLC, VGS)、威旭半导体奥地利有限公司 (Vishay Semiconductor (Austria) Ges.mbH, VSA)、日本新电元工业株式会社 (Shindengen Electric MFG.CO.,LTD, , SHD) 及日本映达电子有限公司 (Nihon Inter Electronics Corporation, NIEC) 及, 上述 OEM 客户均为全球主要的半导体分立器件厂商, 其中 VGS 及 VSA 均为威旭半导体 (Vishay Intertechnology, Inc, VSH) 的全资子公司, 威旭半导体是是全球最大的分立器件生产厂商之一, 是纽约证券交易所上市公司。

VSH、VGS、VSA 及 CCI 的股权关系如下:



来源: VSH, 2005 年年报

本公司自 2001 年 10 月 30 日开始与 VGS 的全资子公司——世纪元器件有限公司 (Centery Componets, Inc, CCI) 开展 OEM 业务合作。2005 年 3 月 26 日, 公司与 CCI 和 VGS 正式签署了补充协议, 自 2004 年 9 月 1 日起, 由 VGS 正式接管 CCI 在亚洲的一切经营活动, 所有 CCI 的权利义务由 VGS 承继。

四、生产情况

1、生产模式

本公司目前共有生产线 14 条, 其中 OEM 产品生产线 4 条, 晶圆生产线 1 条, 自有品牌产品及其他生产线 9 条。

OEM 业务中，对 VGS（原为 CCI）销售的产品系协议使用 CCI 的设备进行生产，设备使用情况及清单参见本章第四节相关内容。

2、主要产品的生产能力——封装能力

近三年本公司主要产品按封装分类的生产能力及实际产销量如下：

单位：千只

		塑封	玻封	桥堆	片式	LLP
2005	产能	3,272,000	1,573,000	158,000	192,000	106,000
	产量	2,581,407	827,746	69,104 ^{*1}	126,397	76,214
	销量	2,608,217	816,112	71,587 ^{*2}	125,083	82,452
2004	产能	3,199,000	1,426,000	158,000	144,000	106,000
	产量	2,530,402	1,205,802	139,151	118,024	840
	销量	2,404,342	1,160,951	136,280	115,945	4,583 ^{*3}
2003	产能	3,405,000	1,339,000	158,000	138,000	—
	产量	2,100,452	790,279	121,472	75,105	—
	销量	2,154,031	807,839	122,784	87,737	—

注*1, *2: 2005 年，部分下游客户为应对成本上升的压力，降低了桥堆产品的采购量，转为采购塑封轴向二极管进行替代，造成桥堆产品产、销量下降幅度较大，相关内容参见“第十一章 管理层讨论与分析”；

注*3: 2004 年销售的 LLP 产品中包含 2003 年试生产阶段形成的部分库存产品。

公司近三年来产能未完全利用的主要原因是：

- (1) LLP 等新建生产线在建成后需要进行试生产；
- (2) 公司质量控制（QC）制度要求生产线出现质量缺陷或隐患时必须立即进行相应处理，从而影响实际产量；
- (3) 公司产能统计方法与实际生产状态之间存在差异

公司的产能统计是以公司主要设备的最大生产能力和由熟练工人操作来测算，即以设备的最大工作量负荷、设备间的最优配置、全年 365 天、每日 24 小时并全部由熟练工操作的生产状态计算而得。该种产能统计方法没有考虑正常的设备检修时间、生产品种调节时设备闲置时间、上马新项目时设备的调试时间、非熟练工人对设备的熟悉时间等对产能的实际影响。

目前公司的实际生产状态是：实行三班工作制，每日设备实际运营时间为 21 小时；除星期六、日工人轮休而正常安排生产外，“五一、十一、春节”等长假期间公司实行停产休息，全年实际生产天数为 248 天左右；公司对设备定期安排停产检修和大修，全年大约在 7 天左右；

此外，工人的生产熟练程度、设备折旧等因素也对设备满负荷产能的实现有

一定的影响

考虑上述差异因素后，公司目前的产量基本接近设备正常状态下的实际生产能力。

3、晶圆及芯片生产能力

目前本公司 3 英寸晶圆的生产能力为 108 万片/年，4 英寸晶圆的生产能力为 36 万片/年，其中 3 英寸晶圆主要用于硅橡胶钝化（OJ）芯片的生产，4 英寸晶圆主要用于玻璃钝化（GPP）芯片的生产，近三年来本公司二极管芯片的实际产量如下表：

（单位：百万只）

	2005	2004	2003
OJ	1467	960	621
GPP	51	0	0
合计	1518	960	621

本公司自产的晶圆及芯片尚不能满足二极管生产的全部需求，仍有相当比例的芯片需要由 OEM 客户提供及对外采购，近三年公司自制及外购二极管晶粒的比例如下：

	2005 年	2004 年	2003 年
芯片自给率	36.23%	21.10%	16.20%
OEM 客户供应比率	30.69%	28.92%	30.79%
其他境外采购比率	23.90%	36.27%	35.66%
境内采购比率	9.18%	13.70%	17.35%

随着公司晶圆及芯片产能的扩大，芯片自给率将逐步提高。预计在本次募集资金使用项目达产后，本公司生产二极管所需芯片的 70% 将实现自产。

五、销售情况

1、销售模式

公司销售收入中 OEM 业务所占比例较大，具体比例如下：

	2005 年	2004 年	2003 年
销售收入（万元）	37770.76	37450.21	32883.10
OEM 业务收入（万元）	19558.15	18554.46	14864.77
占公司收入比例（%）	51.78	49.54	45.20
自有品牌收入（万元）	18212.61	18895.75	18018.33

占公司收入比例 (%)	48.22	50.46	54.80
折算汇率 (USD/RMB)	8.1902	8.277	8.277

公司主营业务收入绝大部分来自于出口销售收入，具体比例如下：

	2005 年	2004 年	2003 年
境外销售收入 (万美元)	4,300.08	4,290.34	3,685.34
占公司收入比例 (%)	93.25	94.82	92.77
境内销售收入 (万元)	2,552.10	1,939.99	2,379.24
占公司收入比例 (%)	6.75	5.18	7.23

(1) 公司除 OEM 产品外的出口销售以经销商模式为主

由于行业的特殊性，传统上电子设备制造商习惯于通过经销商采购元器件以获得进一步的技术支持、降低采购成本及得到第三方品质保证。因此，公司自有品牌的出口销售以经销商模式为主。

出口销售收入的确认程序是：公司销售业务部根据销售合同或定单及公司产品的生产情况发出销货指令，并据此向成品仓库发出出货指令单并开具外销发票；仓库发货后运往海关报关出口；公司财务部在报关后根据外销发票、出货指令单和出口报关单确认销售收入的实现。出口销售收入确认标准和依据符合《企业会计制度》规定。

(2) 国内销售以直销方式为主

目前，公司国内销售占总销售收入的比例较低，但随着国内下游需求行业的迅速崛起，公司正在采取积极措施大力拓展国内市场。国内销售产品全部为自有品牌，以直销方式为主，未来可能适度提高经销商销售比例。

国内销售机构的设置包括总部下设的国内销售业务部及北京、广州、东莞三个办事处。

2、主要产品的销售情况

报告期内主要产品销售情况如下表所示：

		塑封	玻封	桥堆	片式	LLP	其他
2005	销售收入 (万元)	25,493.04	3,953.37	2,780.62	2,070.68	2,722.12	750.93
	占总销售收入比例	67.49%	10.47%	7.36%*	5.48%	7.21%	1.99%
2004	销售收入 (万元)	25,083.94	4,364.01	4,861.27	1,961.90	85.04	1,094.04
	占总销售收入比例	66.98%	11.65%	12.98%	5.24%	0.23%	2.92%

2003	销售收入(万元)	23,405.93	3,397.28	4,335.61	1,319.51	—	424.77
	占总销售收入比例	71.18%	10.33%	13.18%	4.01%	—	1.29%

*注：2005年，部分下游客户为应对成本上升的压力，降低了桥堆产品的采购量，转为采购塑封轴向二极管进行替代，造成桥堆销售收入下降幅度较大，相关内容参见“第十一章 管理层讨论与分析”。

3、报告期内主要产品平均销售价格的变动情况如下表所示：

单位：元/千只

	塑封	片式*	玻封	桥堆	LLP
2005	95	229	48	1,340	353
2004	99	266	38	1,597	—
2003	103	287	42	601	—

*注：仅包括普通塑封片式二极管，未包括玻封片式及片式桥堆产品。

上述产品中，塑封和片式二极管属于主流产品，平均价格呈下降趋势；玻封产品中由于 miniMELF 产品及 1W 轴向玻封二极管所占比重的提高，平均价格有所上升；由于肖特基桥堆及大功率桥堆于 2004 年开始投产，所以自 2004 年起桥堆产品平均销售价格有较大幅度上升；LLP 产品是新开发的产品，销售价格及毛利率均较高，是公司近期主要的利润增长点。

关于毛利率变动的进一步分析参见第十一章“管理层讨论与分析”相关内容。

4、对前五名客户的销售情况

近三年公司向前五名客户合计的销售数据如下表所示，其中 VGS/CCI 及 VSA 系受同一控制人（威旭半导体）控制的公司，故合并计算销售额，香港固得是本公司在香港地区的经销商，也是本公司的关联方（参见第七章相关内容）。

	客户名称	销售额(万元)	占销售收入的比例
2005年	前5名客户合计	24,061.23	63.70%
	其中：VGS及VSA	16,920.30	44.80%
	香港固得	1,795.44	4.75%
2004年	前5名客户合计	24,566.41	65.60%
	其中：VGS/CCI及VSA	18,487.19	49.36%
	香港固得	2,661.47	7.11%
2003年	前5名客户合计	24,059.14	73.17%
	其中：CCI*	14,863.27	45.20%
	香港固得	3,055.20	9.29%

*注：2003年度 VSA 不是公司的前 5 名客户

六、主要产品的原材料和能源及其供应情况

本公司生产所需的主要原材料有硅单晶片、芯片、铜引线、铅锡银焊片、环氧树脂、白胶、玻管、油墨及各种内外包装材料。除芯片可部分自行生产外，其余原材料均需对外采购。

本公司消耗的能源和介质有电、氮气、水等。氮气供应通过自制氮气和外购液氮两种方式解决。水、电由本地市政公共管网供应。

1、主要原材料和能源占成本的比重

原材料或能源名称	占入库成本的比重
芯片	45.93%
引线	13.95%
环氧树脂	3.02%
其他原材料	7.51%
电	2.20%
氮气	0.31%
其他能源	0.68%

2、主要原材料和能源的价格变动趋势

主要原材料的市场平均价格

原材料或能源名称	2005	2004	2003
晶粒（1A）（单位：元/千只）	32.75	17.54	14.12
晶粒（3A，不含 SKY）（单位：元/千只）	74.26	51.37	45.93
晶粒（3A，SKY）（单位：元/千只）	154.93	167.56	207.93
引线（1A）（单位：元/千只）	4.47	3.55	2.88
引线（3A）（单位：元/千只）	15.10	11.66	10.15
环氧树脂（单位：元/公斤）	23.83	24.07	25.34
研磨片及晶片（3寸）（单位：元/片）	11.98	8.70	8.63
研磨片及晶片（4寸）（单位：元/片）	17.37	15.29	—
电（单位：元/度）	0.64	0.58	0.52
氮气（单位：元/立方）	0.65	0.65	0.65

影响本公司原材料价格的主要基础商品包括铜及单晶硅，其中铜是制造引线及引线框的主要原材料，单晶硅是制造晶圆及芯片的主要原材料。近年来由于国际市场上金属铜及单晶硅价格均有较大幅度的上涨，导致本公司 2003—2005 年引线的年平均采购价格上涨幅度均在 20% 以上，晶粒的平均采购价格也有一定幅度的上升，其他原材料价格相对稳定。

3、主要原材料供应商

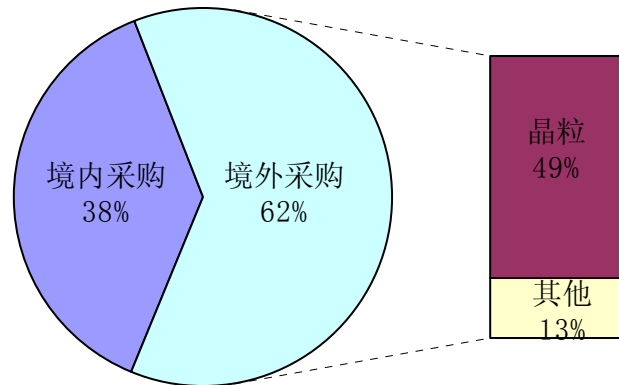
公司近三年前五大原材料供应商如下表所示：

	供应商名称	采购内容	采购金额	比例	
2005	1	VGS	晶粒	69,760,260.55	26.15%
	2	SHD	晶粒	21,577,667.08	8.09%
	3	苏州超樊电子有限公司	引线	21,283,394.65	7.98%
	4	VSA	晶粒	17,848,530.18	6.69%
	5	无锡市博源电子器件有限公司	引线	10,730,795.21	4.02%
	前 5 名供应商合计			141,200,647.66	52.94%
	年度采购总金额			266,723,407.69	
2004	1	VGS	晶粒	115,195,535.82	42.22%
	2	苏州超樊电子	引线	14,176,766.93	5.20%
	3	香港住工	树脂	10,946,911.87	4.01%
	4	VSA	晶粒	8,716,379.27	3.19%
	5	苏州万事达电子	引线	8,421,443.63	3.09%
	前 5 名供应商合计			157,457,037.52	57.71%
	年度采购总金额			272,818,292.33	
2003	1	CCI	晶粒	97,148,876.00	38.79%
	2	香港住工	树脂	11,307,394.00	4.52%
	3	苏州超樊电子	引线	10,383,425.00	4.15%
	4	圣桑股份	晶粒	10,079,990.00	4.02%
	5	无锡镁高	引线	6,902,061.51	2.76%
	前 5 名供应商合计			135,821,746.51	54.23%
	年度采购总金额			250,438,846.94	

在上述原材料供应商中，本公司董事长兼总经理吴念博先生曾任无锡镁高的董事长兼总经理。吴念博先生不享有无锡镁高的权益，并已于 2004 年 6 月辞去了在无锡镁高担任的所有职务。

4、采购模式

本公司有 100 多家原材料供应商，主要来自国内和美国、欧洲、日本、香港和亚洲其他地区。公司报告期内境外采购占原材料采购总金额的比例较高，其中 2005 年原材料采购构成情况如下图所示：



由于公司 OEM 客户对产品所需晶粒的技术指标达要求较高，相关业务所需的晶粒主要由 OEM 客户提供，因此境外采购原材料以二极管晶粒为主。本公司募集资金项目达产后，部分自产芯片将可用于 OEM 产品的生产以替代进口。

公司与主要原材料供应商均建立了长期稳定的合作关系，并实施分散采购策略，以避免对单一原材料供应商的依赖程度过高；同时，对于引线、焊片及环氧树脂等部分原材料已大部分实现了国内采购。

七、环保情况

二极管行业的生产污染较轻。本公司主要环境污染物为：酸洗、电镀工艺产生的工业废水、酸洗站和扩散线产生的工艺废气以及一些固体废弃物和厂界噪声等。

工业废水的污染因子主要有：铜离子、氟化物、 COD_{Cr} 、氨氮、总磷、总氮及悬浮物等。目前，我公司有污水处理站两座，总厂和电镀分厂各有一座，总厂污水处理站的设计处理能力为 400 吨/天，分厂污水处理站的设计能力为 15 吨/小时。

工艺废气主要含有酸雾、氟化氢和氮氧化物等，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准的要求，可通过排气筒向高空排放。

固体废弃物主要有：污水处理站在处理污水时产生的污泥，成型中产生的废环氧树脂，金工车间的金属屑，废弃化学品及容器，以及生产中产生的报废品及废弃擦布、手套和口罩等纤维制品。固体废弃物由公司分类收集后送有资质的固废处理站进行处理。

厂界噪声主要是空压机和排风设备等，经治理后可达到 GB12348-90《工业

企业厂界噪声标准》的 H 类标准。

公司在环保设施方面进行了大量投资，配备专职环境管理人员对主要污染物全部进行日常监控。特别是在污水处理方面，施行实时监控，及时了解排放水的水质情况。

本公司已通过了 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 环境管理体系认证，通过了 GB/T 28001-2001 职业健康安全管理体系认证，并被 SONY 授予绿色合作伙伴证书（Certificate of Green Partner, SOEM8797）。

第四节 本公司的主要资产

一、主要固定资产情况

截至 2006 年 6 月 30 日，发行人拥有所有权的固定资产原值 14,829.90 万元，包括专用生产设备、房屋及建筑物、通用设备、运输设备等，其中主要生产线 14 条，厂房建筑面积 30,400 平方米，主要生产线、关键设备可满足继续生产的需要。

单位：万元

类别	原值	累计折旧	减值准备	净值	成新率
房屋建筑物	1,663.79	395.44	33.00	1,235.35	74.25%
机器设备	6,220.24	2,293.23	85.34	3,841.67	61.76%
电子设备、器具及家具	6,560.71	3,378.88	15.00	3,166.83	48.27%
运输设备	385.16	232.04	-	153.12	39.76%
合计	14,829.90	6,299.59	133.34	8,396.97	56.63%

1、主要生产设备

截至 2005 年 12 月 31 日，公司在芯片制造和二极管封装测试生产流程中使用的关键生产设备和辅助设备情况如下：

(1) 与芯片制造相关的关键生产设备

设备名称	数量（台）	设备原值（元）	尚可使用年限（年）
显影机	1	240,000.00	3
STPOS/LTO 系统	1	2,470,000.00	3
曝光机	1	220,000.00	3
特气气体系统	1	470,000.00	3
GPP 冷冻水系统	1	660,000.00	3
扩散炉	1	57,000.00	3
SPUTTERING SYSTEM	1	940,000.00	3

甩干机	4	680,000	3
高温扩散炉控制机	1	170,000.00	3
显微镜	1	82,766.00	3
涂布机	1	60,000.00	3
蒸发台	1	1,180,000.00	3
硅片清洗机	1	260,000.00	3
湿法去胶机	2	520,000.00	3
湿法刻蚀机	2	520,000.00	3
扩散炉温度控制器	5	300,875.00	2
双电测四探针测试仪	2	42,200.00	2
尘埃粒子计数器	1	12,500.00	1
P-N 导电类型鉴别仪	1	55,000.00	1
X 射线测试仪	1	662,176.00	1
纯水设备	1	7,000,000.00	0
废水处理系统	1(套)	352,800.00	2
晶粒分类机	5	1,117,405.00	2
晶片切割机	2	819,422.00	2
扩散镀镍设备	1	133,000.00	0
扩散组合槽	1	40,000.00	0
水处理设备	1(套)	8,500,000.00	0
晶粒分离机	1	199,337.00	2
晶片贴膜机	1	102,636.00	2
分类机	2	413,826.00	10
膜厚测试仪	1	120,009.00	5
精密烤箱	2	24,642.00	5

(2) 与器件封装、测试相关的关键生产设备

设备名称	数量 (台)	设备原值 (元)	尚可使用年限 (年)
粗铝线焊接机	1	1,860,000.00	8
金线焊接机	4	2,151,892.00	10
芯片焊接机	2	3,054,128.00	10
5S 塑封模	1	274,000.00	8
2S 塑封模	1	165,564.00	8
压扁成型系统	2	1,094,000.00	8
塑封模具	1	250,000.00	3
模具	1	140,000.00	3
中央空调	1	2,520,000.00	8
成型机	2	218,000.00	3
成型机	2	145,960.00	5
成型机	1	176,500.00	10
自动成型机	1	3,616,449.00	10
双连整形机	1	240,000.00	3
V 型切割机	1	110,000.00	3
UV 脱膜机	1	120,000.00	3
半自动贴膜机	1	148,000.00	3
激光印字机	1	139,000.00	3
激光印字机	1	433,107.00	5
激光打标机	1	106,000.00	5

印字机	23	6,003,000.00	2
焊接炉	9	1,862,437.50	2
焊接炉	2	373,367.00	3
焊接炉	5	2,139,143.60	4
焊接炉	1	248,367.00	5
焊接炉	2	443,620.00	10
模压机	3	605,829.80	7
分类机	14	2,021,433.68	2
空气压缩机	1	376,703.60	3
氨分解+混配气装置	1	190,500.00	5
一贯机	18	5,392,162.00	3
一贯机	2	761,548.40	4
一贯机	10	2,768,439.50	5
一贯机	3	2,205,098.00	7
一贯机	3	5,127,292.00	10
SMC 一贯机	1	802,821.00	10
X 射线测厚仪	1	7,240,000.00	8
滚镀锡生产设备	1	229,800.00	10
冷水机组\整流器	1	198,000.00	6
油压机	1	105,000.00	10
测深显微镜	1	132,424.00	10
LASER MARKING SYSTEMS	2	137,972.00	10
切割机	3	1,735,581.00	10
研磨机	1	146,210.00	10
手动测试仪	1	143,811.00	5
清刷机	1	146,334.00	5
吹砂机	2	110,000.00	10

(3) 可靠性试验设备和环境保护设备

设备名称	产地	生产年份	数量 (套)	重置成本 (万元)	还能安全运行 时间(年)
视频显示系统	中国	2004	1	18.95	3
综合测试仪	中国	2004	1	3.31	3
高温反偏试验系统	中国	2004	2	17	3
高低温冲击试验箱	日本	2004	1	23.17	3
HTRB 实验系统	中国	2004	1	3.24	3
桥堆高温反偏试验系统	中国	2004	1	25	3
测试装置	韩国	2004	2	37.04	3
多功能测试机	中国	2004	1	35.18	3
扫描电子显微镜	日本	2000	1	85	3
X-ray(射线)分析仪	日本	2002	1	66.22	13
高温反向偏压(HTRB)老化	中国	2003	1	25	13
高温反向偏压老化系统	中国	2005	2	30	5
15T/H 软化水系统	中国	2003	1	44	6
老化实验系统	中国	2001	1	16.2	11
废水处理系统	中国	2003	1	65.4	6
稳压二极管寿命试验系统	中国	2005	1	6	5
正向直流间隙寿命实验仪	中国	2005	1	5.5	5

电流负载测试仪	韩国	2005	1	1.2	5
软水器	中国	2005	1	3	5
噪声治理隔声屏障	中国	2005	1	5	5

2、协议使用 CCI 公司设备的情况

根据本公司与 CCI 公司之间的 OEM 合同，本公司协议使用了 CCI 公司的部分生产设备专门用于与 CCI 公司 OEM 合同相关产品的生产。CCI 通过转移设备可以避免设备闲置，提高设备利用效率，同时有效降低采购成本（购进产品成本中不包括设备的折旧费用）；我公司可以减少设备投资成本、降低投资风险，并稳定与 CCI 的业务合作关系。目前，上述设备的所有权仍归属 CCI，并处于海关监管状态。

公司自有品牌的生产对 CCI 生产设备无任何依赖。

公司协议使用 CCI 公司的设备具体情况如下：

协议使用设备名称	数量（台、套）	总价（美元）
芯片切割机	4	14,710.00
芯片分类机	15	290,689.95
芯片装填机	1	4,700.00
隧道式焊接炉	2	11,670.00
隧道式长条炉	4	93,120.00
引线装填机	9	51,619.99
注塑成型机	13	84,290.00
去胶机	3	37,620.00
引线引直机	3	960.00
引直机	3	1,710.00
弯脚机	5	273,690.00
成品弯脚机	1	16,400.00
烘烤机	10	1,480.00
烘烤箱	1	8,090.00
印字机	5	142,559.98
二极管卷装测试机	1	10,660.00
测试印字卷装机	7	784,470.00
二极管 QA 测试机	1	16,060.00
二极管自动分类机	2	13,550.00
袋装机	1	2,230.00
成品袋装机	1	3,250.00
长脉波漏电测试仪	2	154,640.00
DC 漏电测试仪	2	15,740.00
二极管漏电测试机	1	1,000.00
桥堆测试仪	1	9,480.00
高可靠性测试仪	2	69,980.00
合计	100	2,114,369.92

公司 2003~2005 年度发生的与 CCI 提供的生产设备相关的维护费分别为 717,860.52 元、744,675.35 元和 520,393.60 元。上述维修费用主要用于采购 CCI 公司提供的专用于相关设备维修的备品备件及本公司自行采购的用于设备维修的备品备件，未包括相关的人工费、管理费等其他费用。

3、租用大股东设备的情况

苏州通博电子器材有限公司的前身是苏州市无线电元件十二厂，主要从事电子元器件的制造。该公司业务自 1998 年开始逐渐萎缩，至 1999 年 12 月改制为苏州通博时，生产已基本停顿。为避免与发行人同业竞争，苏州通博现已停止了相关生产业务。

考虑到苏州通博的部分辅助生产设备尚未完全报废，并且该部分设备不属于关键生产设备、剩余可使用年限较小且价值净值较低，所以本公司租用了该部分设备，而未采取购买方式获得使用权。本公司的生产经营不依赖该部分设备，该部分设备报废后公司将重新购置替代设备，正常生产不会受到影响。

具体租用情况如下：

单位：元

设备名称	购入年份	设备原值	设备净值	使用部门	剩余年限
桥堆测试仪	1998.12	120,000	63,000	DO-5 生产线	5
加工中心	1997.10	160,000	66,266	金工车间	3.83
旋臂钻床	1997.10	15,000	6,212	金工车间	3.83
车床	1997.10	15,000	6,212	金工车间	3.83
平面磨床	1997.10	16,000	6,626	金工车间	3.83
平面磨床	1997.10	12,000	4,970	金工车间	3.83
铣床	1997.10	20,000	8,283	金工车间	3.83
铣床	1997.10	10,000	4,141	金工车间	3.83
电火花	1997.10	8,000	3,313	金工车间	3.83
其他	1997.12	36,160	15,548	DO-5 生产线	4
车辆	2002.10	730,600	568,650	管理部门	3.83
合计		1,142,760	753,221		

4、生产经营所使用的房屋建筑物

本公司拥有两处经营性房产，产权情况如下表：

房产证号	建筑面积（平方米）	位置
苏房权证相城字第 00003051 号	1,822.40	通安镇电镀厂
苏房权证相城字第 00003058 号	16,339.13	通安镇通锡路 31 号
合计	18,161.53	

具体使用情况如下：

用途	主体厂房名称	建筑日	使用面积(M ²)	折旧年限	已使用年限
晶圆制造	7号楼3层	2001年11月	1,807	20年	3年
	2号楼裙楼	2001年04月	450.2	20年	4年
封装、测试	7号楼1-2层	2001年11月	3,614	20年	3年
	2号楼	1992年04月	5,000	20年	13年

二、主要无形资产情况

公司账面无形资产大部分为土地使用权，其余无形资产为财务软件及 ERP 软件。本公司拥有的专利、非专利技术及商标都未予资本化，账面价值为零。

1、土地使用权

公司目前已取得土地使用权证书的工业用地共 3 处，面积共计 115,815.13 平方米，截至 2006 年 6 月 30 日土地使用权净值为 1,533.52 万元。具体情况如下：

	证书号	面积(M ²)	使用期限	坐落地
1	苏新国用(2006)第 002993 号	28098.1	2044 年 4 月 18 日	苏州高新区通锡路 31 号
2	相国用(2002)字第 00314 号	4813.33	2051 年 7 月 29 日	通安镇树山村
3	苏新国用(2005)第 010740 号	82903.7	2055 年 9 月 8 日	苏州高新区石唐路东、华金路北、同心路南

上述土地使用权中，原值人民币 3,012,853.00 元的使用权为 1998 年原江苏固得电子有限公司经法定程序清算终止时偿债转入(参见第五章相关内容)，其余为以出让方式取得。


2、软件

公司目前拥有的软件无形资产包括：金蝶 K3 财务软件，2003 年购入，原值 4.7 万元，摊销年限 3 年；ERP 软件，2006 年购入，原值 100.69 万元，摊销期限 5 年；

截至 2006 年 6 月 30 日软件无形资产的净值为 91.01 万元；

3、商标：

本公司目前拥有 2 个注册商标。

(1) 注册商标：

商标注册证第 1263842 号；核定使用商品：二极管；注册有效期限自 1999 年 4 月 14 日至 2009 年 4 月 13 日。2003 年 6 月 7 日，该商标注册人由固得有限变更为发行人。



(2) 注册商标：



商标注册证第 1261385 号；核定使用商品：半导体器件，二极管；注册有效期限自 1999 年 4 月 7 日至 2009 年 4 月 6 日。2003 年 6 月 7 日，该商标注册人由固得有限变更为发行人。该商标并于 2002 年 8 月 6 日获世界知识产权组织（WIPO）的注册（编号：785091），于 2003 年 2 月 28 日获日本商标登录证（国际登录第 785091 号）。

4、专利

本公司目前拥有 3 项发明专利、1 项实用新型专利，另有 3 项发明专利已获得中华人民共和国国家知识产权局的受理处于审批阶段。

已获得的专利如下：

	名称	专利类型	专利号	发证时间	期限
1	片式微型桥堆	实用新型	ZL02219702.8	2003 年 4 月 16 日	10 年
2	高承受力二极管	发明	ZL03113249.9	2004 年 12 月 22 日	20 年
3	二极管制造方法	发明	ZL03132212.3	2006 年 2 月 15 日	20 年
4	具有低内阻的半导体器件有源区表面粗化处理方法	发明	ZL03152955.0	2006 年 2 月 15 日	20 年

正在申请的专利如下：

	名称	专利类型	申请号	受理时间
1	半导体器件及其制造方法	发明	031127568	2003 年 8 月 15 日
2	肖特基势垒二极管的制造方法	发明	031528201	2003 年 12 月 05 日
3	一种适合于聚酰亚胺透明胶的二极管钝化区结构	实用新型	200620072638.7	2006 年 4 月 23 日

5、专有技术：

技术名称	作用和特点
一次光刻	与通常的三次光刻工艺相比，大大降低了芯片制造的成本。
新型引线框架	可将摇片的生产效率提高 20 倍。
GPP 芯片制造	使用玻璃钝化技术制造芯片

第五节 本公司的生产技术

一、主要产品生产技术所处的阶段

本公司所掌握的主要生产技术，包括上述专利和专有技术，除少数处于小批量生产阶段外，大部分均已用于大批量商业生产。

本公司主要产品的生产技术所处阶段如下表所示：

	主要产品	工艺技术程度	设备状况	生产所处阶段
1	3英寸/4英寸晶圆	较为先进	较为先进	大批量生产
2	塑封/玻封/桥堆封装	中等	中等	大批量生产
3	片式二极管封装	较为先进	较为先进	大批量生产
4	LLP封装	领先	领先	大批量生产
5	TVS封装	中等	中等	大批量生产
6	TVS芯片	较为先进	较为先进	小批量生产
7	汽车整流二极管封装	较为先进	较为先进	小批量生产
8	抛负载二极管芯片	较为先进	较为先进	试生产

二、研发投入及正在开发的项目情况

公司近三年来研发经费投入及占主营业务收入的比例如下表：

	2005年	2004年	2003年
研发投入（万元）	1,564	2,322	1,980
占主营业务收入比例	5.6%	6.2%	6.0%

公司计划在本次募集资金到位后逐步提高研发费用占主营业务收入的比例以进一步增强研发力量。

目前本公司正在开发的主要项目包括：

1、瞬变电压抑制二极管（TVS）产品后续研发

TVS产品主要用于吸收瞬变能量、保护电子线路，在PC及消费电子、通讯设备及汽车工业产品上有广泛应用。公司在掌握现有TVS封装及芯片生产技术的基础上，正逐步扩展产品功率范围、增加单向及双向保护产品、增加产品封装类型，完善TVS系列产品。

2、汽车整流器及抛负载二极管后续研发

汽车整流器用抛负载二极管对大温差范围内性能稳定性及封装形态的要求较高，本公司已初步掌握汽车整流二极管及抛负载二极管封装及芯片生产技术，目前正在进行后续研发。

3、LLP 封装技术后续研发

公司将通过后续研发拓展 LLP 产品线，主要研发方向是二极管阵列封装及 IC 封装。

4、扩充桥堆产品线

公司桥堆产品主要集中于若干型号，目前正在形成完整化的产品线，工作电流范围将涵盖从 0.5A~25A 的区间。

三、技术不断创新的机制、技术储备及技术创新的安排

公司通过以下几个方面的措施保证了企业技术进步的潜力：

1、注重交流合作和产品开发，广泛吸纳同行业先进科技成果和高水平技术人才，加强产、学、研合作和国内外技术交流，充分利用各种科技资源提高公司的研究开发能力；

2、实施技术创新激励制度，鼓励员工积极探索，力求将研发技术人员的收益与公司所取得的经济效益直接挂钩。公司将技术人员全部纳入完整的技术阶梯管理体系，使技术人员在公司内部能够通过自我学习不断晋级。同时，公司还提供内部专业业务培训、专家教授定期讲座及出国学习等多种活动提高研发技术人员的专业素质；

3、加强技术储备，公司将储备的新品分成三级梯队管理：第一级是技术已成熟可立即投入商业生产的；第二级是技术已成熟但市场未成熟，需等待适当时机投入商业生产的；第三级是技术还未成熟，需继续研发的。根据不同分级，分别采取不同的管理措施。公司现有技术储备包括：

（1）耐高压肖特基二极管

该项目是本次募集资金使用项目的延伸。本次募集资金使用项目中的肖特基二极管反向工作电压范围在 20 伏~60 伏，通常用于消费电子产品；在本次募集

资金投向项目成功实施的基础上，公司正进一步开发工作电压在 100 伏以上的肖特基二极管，面向大功率整流器等工业应用领域。

（2）玻璃钝化超快速整流二极管

该项目是本次募集资金使用项目的延伸。本次募集资金使用项目中的玻璃钝化整流二极管（GPP）的反向恢复时间为 150 纳秒，而玻璃钝化超快速整流二极管的反向恢复时间仅为 30 纳秒，应用场合更宽。

（3）工业整流二极管

该产品通常在 50 安培以上的大电流下工作，作用是保障电镀系统等工业设备的供电系统的安全，目前只有少数国际知名公司掌握该产品的相关技术。

（4）二极管模块和功率二极管

目前公司正积极开发二极管模块生产技术及 TO263、TO252 等封装体积更小的片式功率二极管生产技术。

第六节 本公司的质量控制

一、质量控制标准

在产品的技术标准方面，本公司除了采用国际电工委员会（IEC, International Electronic Commission）所制定的国际规格以外，还以美国联合电子器件工程委员会（JEDEC, Joint Electron Devices Engineering Council）的标准、日本电子机械工业会（EIAJ, Electronic Industries Association of Japan）的标准、美国军用标准 MIL-STD-750D 以及国家标准 GB12560—1990《半导体器件-分立器件分规范》为基础，结合自身的实际情况制定出了《Q/320500.GSXH.001-2001 环境额定硅整流二极管》等 25 项企业质量标准。

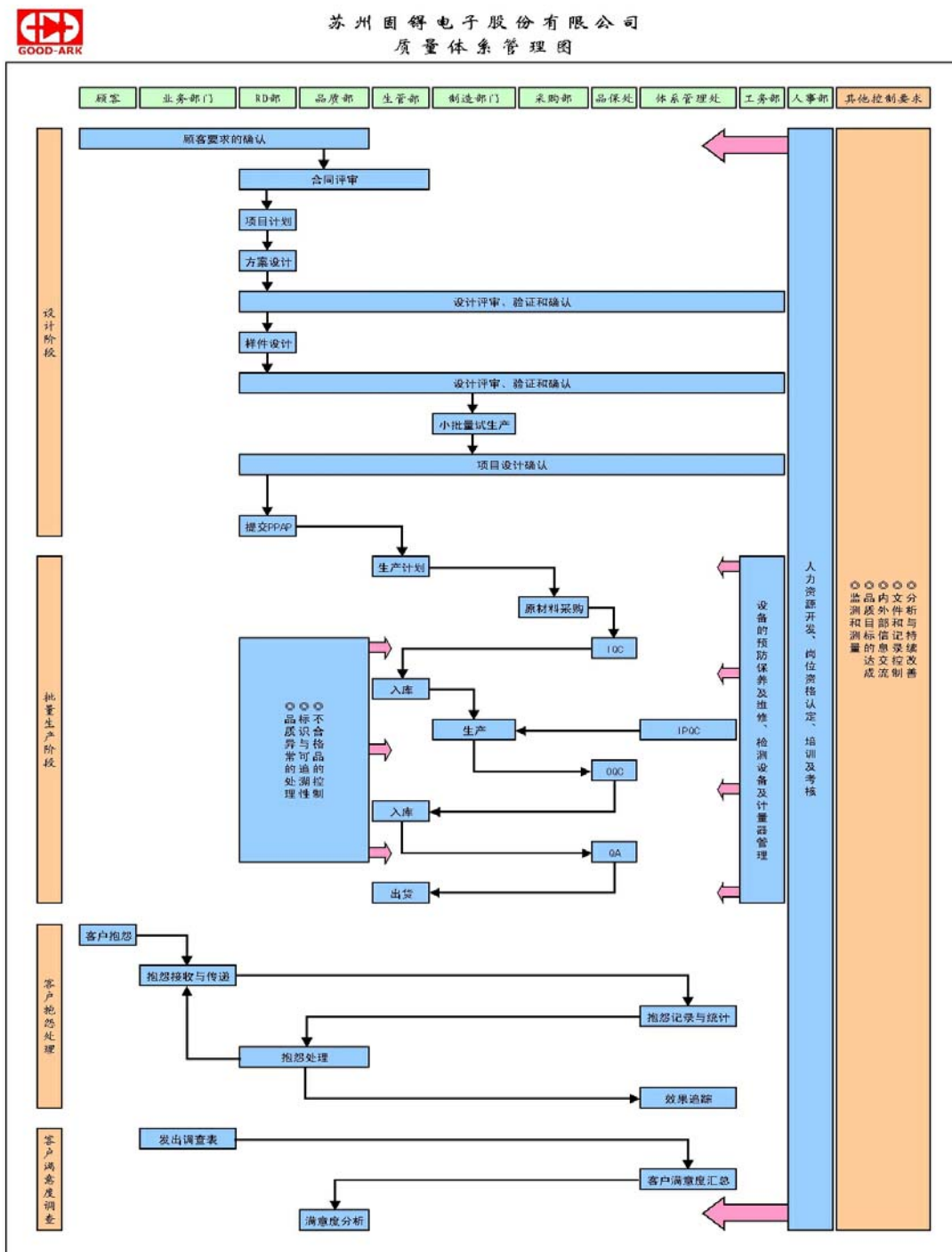
二、质量控制措施

公司引进了一大批具有世界先进水平的生产线和相关设备，从硬件上保证了产品质量。公司引进高纯水设备，电阻率达到 $18\text{M}\Omega \cdot \text{CM}$ ，保证了芯片的生产

质量；建立了电镀自动生产线，大大提高了电镀质量，并把铅锡合金用到微型桥堆等产品上；引进汽车整流器烧结隧道炉，控制烧结温度曲线，减少产品缺陷，提高产品的功率与容量；拥有全套测试设备，可进行 12 种可靠性测试，从日本引进电子扫描显微镜，有效提高了产品失效分析水平。

在软件上，公司适应市场需求，遵循 TS16949/QS9000/ISO9001 的标准建立了质量控制体系，编制了从质量手册到各类作业指导书等一整套质量体系文件，在产品的开发、生产和销售过程中，以“优质、高效、规范”为质量方针，坚持“让客户全面满意”的思想。为确保质量体系的有效运行，公司品质部全面负责质量体系的日常维护、文件的修订并组织内部审核对各部门的落实情况进行追踪，同时还对员工进行体系知识培训。公司也为质量体系的持续改进提供了必要的人力和财力资源支持，在质量体系的日常运行中，本公司经常采用各类 SPC 统计技术对产品的品质进行控制，通过品质会议、QCC、品管图、脑力风暴、8D 活动等方式，加强对进料检验、过程检验、出货检验等关键点进行控制与改善，增进质量体系的运行绩效。本公司重视客户对产品质量的反映，制定了《客户抱怨处理作业指导书》和《产品召回政策》，对客户抱怨的处理流程进行了标准化规范。

本公司的质量控制流程如下图所示：



三、质量控制成果

先进有效的质量控制体系是产品质量的可靠保证，目前，从客户反馈的产品不良率保持在 2PPM（百万分之二）以下，部分产品已做到了 0.1PPM（千万分之一）以下。

第七节 本公司所获的各项认证及荣誉

1995年	获得 ISO9002 质量管理体系认证，是国内第一家通过 BVQI 认证审核的二极管生产企业；
2000年	获得环境管理体系 ISO14001 认证
2001年	获得 ISO9001（2000版）及 QS9000 美国汽车质量管理体系认证
2003年	获得 OHSAS18001 安全健康体系认证，并导入了 ISO/TS16949（2002版）国际汽车工业质量管理体系最新标准
2004年	“片式微型桥堆 MS（2,4,6）S，U05（B,G,J）4B48”获国家科技部、商务部、质监总局、环保总局颁发的国家重点新产品证书
	“片式微型桥堆”获苏州市优秀专利奖证书
	获得 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 环境管理体系认证 获得 GB/T 28001-2001 职业健康安全管理体系认证
2005年	获得江苏省科学技术厅颁发的技术密集知识密集型企业认定证书
	“塑封片式 LLP 稳压二极管 1×5 阵列”获江苏省科学技术厅高新技术产品认定证书
	“片式（SMD）塑封整流二极管”获江苏省科学技术厅高新技术产品认定证书
	被苏州国家高新技术产业开发区管委会评选为 2005 年度苏州高新区优秀高新技术企业
2006年	“片式微型桥堆”被评为 2005 年度苏州高新区优秀专利项目
	获得 SONY 绿色伙伴证书（Certificate of Green Partner, SOEM8797）
	获得船井电机（香港）（FUNAI ELECTRIC（H.K.）LTD）高质量产品合作伙伴奖

第七章 同业竞争和关联交易

第一节 同业竞争

一、同业竞争情况说明

本公司控股股东为苏州通博，实际控制人为吴念博，控股股东及实际控制人的具体情况参见第五章第四节相关内容。

苏州通博除控股本公司外，无其他对外股权投资。

吴念博对苏州市固得纯净水有限公司出资 41.6 万元，占注册资本比例的 80%，为该公司法定代表人。苏州市固得纯净水有限公司成立于 1996 年 9 月 28 日，注册资本 52 万元，主营为生产、销售纯净水，销售饮水器材、饮水桶。该公司与发行人无业务往来。除上述出资外，吴念博及其近亲属没有对其他公司或企业的投资行为。

综上所述，本公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业均未从事与本公司相同或相似的业务，与本公司不存在同业竞争。

二、避免同业竞争的承诺

本公司控股股东及实际控制人吴念博均已向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺不以任何形式从事与本公司相同或相似的业务。

第二节 关联方、关联关系及关联交易

一、关联方及关联关系

1、目前与本公司存在关联关系的关联方

关联方名称	关联关系
控股股东	
苏州通博电子器材有限公司	持有本公司 57.36% 的股份
持有本公司 5% 以上股份的股东	
香港润福贸易有限公司	持有本公司 33.84% 的股份
自然人关联方	
吴念博	本公司实际控制人
全体董事、监事、高级管理人员	本公司的董事、监事、高级管理人员
其他关联方	
香港宝德	本公司董事黄浩荣持有其 50% 的股份，实际控制该公司；该公司目前持有本公司 4.8% 的股份。
香港固得	本公司董事黄浩荣持有其 90% 的股份，实际控制该公司。
苏州固得纯净水有限公司	本公司实际控制人吴念博持有其 80% 的股份，实际控制该公司。

2、报告期内与公司曾经存在关联关系，但目前已不存在关联关系的关联方

关联方名称	关联关系
无锡镁高电子有限公司	截至 2004 年 6 月，本公司实际控制人吴念博担任该公司董事长
台湾固得	截至 2003 年 9 月，该公司实际控制人陈鉴章担任本公司董事
固铨科技(芜湖)有限公司	
台湾六铨科技股份有限公司	

二、经常性的关联交易

(一) 与目前仍存在关联关系的关联方的交易

1、与香港固得的关联交易

香港固得是公司在香港地区的经销商，本公司通过其销售的产品包括各种规格的整流二极管、快恢复二极管、肖特基二极管及桥堆、微型桥堆和齐纳管等。

香港固得是本公司的 5 大销售客户之一（参见第六章相关内容），报告期内公司对香港固得的销售额及占主营业务收入的比例如下表所示：

	交易金额（元）	占主营业务收入的比例
2003年	30,551,990.58	9.29%
2004年	26,614,715.74	7.11%
2005年	17,954,430.51	4.75%
2006年1-6月	6,430,776.78	3.15%

本公司与香港固得关联交易属于正常的购销行为，交易价格与本公司对其他客户相同产品的交易价格不存在不合理差异。

2、与香港宝德的关联交易

香港宝德是公司在香港地区的经销商，本公司通过其销售的产品包括各种规格的整流二极管、快恢复二极管及肖特基二极管等。

报告期内公司对香港宝德的销售额及占主营业务收入的比例如下表所示：

	交易金额（元）	占主营业务收入的比例
2003年	4,774,705.21	1.45%
2004年	6,185,099.65	1.65%
2005年	8,540,016.00	2.26%
2006年1-6月	6,499,734.78	3.19%

本公司与香港宝德的关联交易属于正常的购销行为，交易价格与本公司对其他单位相同产品的交易价格不存在不合理差异。

3、报告期内公司对香港固得及香港宝德的应收账款余额及占当期交易额的比例如下表所示：

单位：元

	香港固得		香港宝德	
	应收账款余额	占当期交易额的比例	应收账款余额	占当期交易额的比例
2003.12.31	9,016,200.55	29.51%	1,666,460.93	34.90%
2004.12.31	7,456,110.81	28.01%	1,989,986.87	32.17%
2005.12.31	3,623,800.64	20.18%	3,015,096.61	35.31%
2006.6.30	5,198,424.24	80.84%	4,274,894.05	65.77%

本公司与香港固得及香港宝德的关联关系及由此产生的销售业务是因行业特点和长期的业务关系而形成。基于本公司与关联方已存在的经济关系和本公司生产经营的经济性原则及稳定性原则考虑，本公司与上述关联方的关联交易还将保持一定的持续性，但随着公司治理结构的不断完善，该等关联交易的公允性必将维持并得到进一步保障。

（二）与目前已不存在关联关系的关联方的交易

1、与无锡镁高的关联交易

2003 至 2004 年度，本公司向无锡镁高采购原材料——铜引线，采购价格与其他供应商同类产品的定价在同一水平。

报告期内公司与无锡镁高的采购金额如下：

	采购数量（千件）	交易总金额（元）	占主营业务成本的比例
2003	2,468,425	6,902,061.51	2.72%
2004	732,367	2,590,054.83	0.24%

上述采购金额占主营业务成本比例比较低。2003 年，无锡镁高曾是本公司的第 5 大原材料供应商（参见第六章相关内容），但 2004 年公司对其采购金额大幅下降。本公司董事长吴念博已于 2004 年 6 月辞去在该公司的一切职务，该公司与本公司不再具有关联关系。

2、与固铨科技的关联交易

2003 年度，本公司向固铨科技销售了晶粒及少量二极管产品，合计销售金额 1,469,716.81 元，占主营业务收入的比例为 0.45%。

上述采购及销售金额占公司收入和成本比例比较低，对公司的生产经营无重大影响。

2003 年 9 月，该公司实际控制人陈鉴章不再担任本公司董事职务，该公司与本公司不再具有关联关系。

3、与台湾六铨的关联交易

2003 年度，本公司向台湾六铨采购原材料，主要为玻璃粉、光阻液、筛网、胶带等生产辅助材料，采购总金额 249,765.27 元，占主营业务成本的 0.10%。

2003 年度，本公司向台湾六铨销售晶粒 12,063.67 千片，销售金额 344,421.04 元，占主营业务收入的比例为 0.10%。

上述采购及销售金额占公司收入和成本比例比较低，对公司的生产经营无重大影响。

2003 年 9 月，该公司实际控制人陈鉴章不再担任本公司董事职务，该公司与本公司不再具有关联关系。

三、偶发性的关联交易

1、向控股股东——苏州通博租赁房屋和辅助生产设备

公司 2002 年 2 月 26 日与苏州通博签订的《房屋租赁合同》，向苏州通博租用房屋开设苏州办事处，年租金 191,040 元，租期从 2002 年 1 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日，年租金人民币 191,040.00 元；2006 年 1 月 2 日，公司与苏州通博、苏州教育学院、苏州立达学校签订《房屋租赁合同》，约定自 2006 年 1 月 1 日起，公司直接向苏州教育学院、苏州立达学校租用房屋，与苏州通博签订的前述租赁合同至 2005 年 12 月 31 日终止。目前公司与苏州通博已不存在因租赁房屋导致的关联交易。

公司与苏州通博于 2001 年 12 月 28 日签定固定资产《租赁协议》，向苏州通博租赁部分辅助生产设备，租期自 2002 年 1 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日，年租金费用人民币 300,000.00 元，包括设备租金 6 万元和车辆租金 24 万元，于每个会计年度结束后的 7 个工作日内支付。

上述关联交易价格的确定方式与非关联方定价无重大差异，租赁费年度合计金额为 49.104 万元，分别占 2003—2005 年度管理费用的 1.42%、1.42%和 2.11%，对公司报告期内经营成果无重大影响。

3、向关联方人士支付报酬

2004 年，经公司一届六次董事会决议，决定对董事长兼总经理吴念博及副总经理曾美华分别给予人民币 1,853,196.20 元和 374,000.00 元的 2003 年度特殊奖励；

2005 年，经公司一届八次董事会决议，决定对董事长兼总经理吴念博及副总经理曾美华分别给予人民币 1,137,242.36 元和 399,000.00 元的 2004 年度特殊奖励；

2006 年，经公司二届二次董事会决议，决定分别对董事长兼总经理吴念博及副总经理曾美华给予人民币 1,161,952.00 元和 389,500.00 元的 2005 年度特殊奖励。

4、关联方为公司贷款提供担保

公司与苏州通博及中国光大银行苏州分行于 2003 年 7 月 3 日签订《最高额保证合同》，苏州通博为中国光大银行苏州分行与公司签订的最高授信额度为人民币 60,000,000 元的《综合授信协议》提供连带责任保证，保证期间为自依据《综合授信协议》签订的具体业务合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。

公司与苏州通博及中国光大银行苏州分行于 2005 年 11 月 15 日签订《最高额保证合同》，苏州通博为中国光大银行苏州分行与公司签订的期限为 2005 年 11 月 21 日至 2006 年 11 月 21 日的、最高授信额度为人民币 60,000,000 元的《综合授信协议》提供连带责任保证，保证期间为自依据《综合授信协议》签订的具体业务合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。

公司与苏州通博及华夏银行苏州支行于 2005 年 1 月 18 日签订《最高额保证合同》，苏州通博为华夏银行苏州支行提供给公司的期限为 2005 年 2 月 15 日至 2006 年 2 月 15 日的、最高授信额度为人民币 33,000,000 元的综合授信额度提供连带责任保证，保证期间为相关债务履行期限届满之日起二年。

四、关联交易决策权力与程序的相关制度

（一）公司章程相关规定

2005 年度股东大会通过的《苏州固得电子股份有限公司章程（修正草案）》对关联交易的相关规定如下：

第三十八条 控股股东对公司及其他股东负有诚信义务，保证不侵害公司利益。在进行涉及到公司与控股股东关联交易等重大决策时，控股股东保证实行表决回避制度。

第四十七条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确，具体。公司应将协议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定予以披露。

第四十八条 公司应采取有效措施防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公司的经营，损害公司利益。关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司应对关联交

易的定价依据予以充分披露。

第四十九条 公司审议关联交易事项时，应当严格遵守公司章程规定的程序。

第五十条 董事会审议关联交易事项时，除非有关联关系的董事按照公司章程的要求向董事会作了披露，并且董事会不将其计入法定人数，该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项，否则，公司有权撤销该合同、交易或者安排。

第五十一条 公司提供担保

公司不得为控股股东及其附属企业、公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的 50%。

对外担保应当取得董事会全体成员 2/3 以上签署同意，或者经股东大会批准；不得直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供债务担保。

公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。

第五十二条 公司应采取有效措施防止股东及其关联方以各种形式占用或者转移公司的资金、资产及其他资源。

第五十三条 董事会对于关联交易事项，除应当按照有关法律、法规和规范性文件及时充分披露外，还应当在年度股东大会上就执行情况作出报告。

第一百零五条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。”

（二）关联交易的决策制度

为切实保护公司中小股东的权益，本公司董事会根据《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定，制订了《苏州固得电子股份有限公司关联交易决策制度》，该制度对关联交易的决策程序进行了规定：

1、决策权限划分

第十条 公司董事会有权决定涉及的金额达到下列情形之一的关联交易：

（1）公司与关联法人签署的一次性协议，所涉及的金额占公司最近一期经审计财务报告中显示的净资产的百分之五以上、百分之十以下；

(2) 公司与同一个关联法人在十二个月内签署的不同协议，按上一条所述标准计算所得的相对数字占百分之五以上、百分之十以下；

(3) 公司向有关联的自然人一次性支付的现金或资产达十万元以上、一百万元以下；

(4) 公司向同一个有关联的自然人连续十二个月内支付的现金或资产累计达一百万元以上、一千万元以下。

第十一条 涉及的金额达到下列情形之一的关联交易由公司股东大会批准：

(1) 公司与关联法人签署的一次性协议，所涉及的金额占公司最近一期经审计财务报告中显示的净资产的百分之十以上；

(2) 公司与同一个关联法人在十二个月内签署的不同协议，按上一条所述标准计算所得的相对数字占百分之十以上；

(3) 公司向有关联的自然人一次性支付的现金或资产达一百万元以上；

(4) 公司向同一个有关联的自然人连续十二个月内支付的现金或资产累计达一千万元以上。

2、回避制度

第十二条 公司总经理、董事长及其他高级管理人员不得批准与自身存在利害关系的关联交易。若公司总经理发现该项交易与自身存在关联关系时，应及时向董事长汇报，由董事长审核后予以批准；若公司董事长发现该项交易与自身存在利害关系时应及时召集董事会予以审议批准。

第十八条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有权部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议公告中作出详细说明。

第十九条 关联股东的回避和表决程序为：

(1) 关联股东或其他股东提出回避申请；

(2) 若相关股东认为其不属于关联股东，则由董事会全体董事过半数决议认定该股东是否属关联股东，并决定其是否回避，该决定为终局决定。如异议者仍不服，可在股东大会后向相关管理部门投诉或以其他方式申请处理；

(3) 关联股东在股东大会表决时，应当自动回避并放弃表决权。主持会议

的董事长应当要求关联股东回避；如董事长需要回避的，副董事长或其他董事应当要求董事长及其他关联股东回避。无须回避的任何股东均有权要求关联股东回避。

(4) 股东大会对有关关联交易事项表决时，在扣除关联股东所代表的有表决权的股份数后，由出席股东大会的非关联股东按公司章程第六十二条规定表决。

第二十条 公司董事会就关联交易表决时，有利害关系的当事人属下列情形的，也不得参与表决：

(1) 与董事个人利益有关的关联交易；

(2) 董事个人在关联企业任职或对关联企业有控股权的，该等企业与公司的关联交易；

(3) 与关联方有任何利害关系的董事；

(4) 按国家有关法律、法规和公司章程规定应当回避的。

第二十一条 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。

第二十二条 除非有关联关系的董事按照第二十一条的要求向董事会作了披露，并且董事会在不将其计入法定人数，该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤销该合同、交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。

第二十三条 有关联关系的董事的回避和表决程序为：

(1) 关联关系董事或其他董事提出回避申请；

(2) 由董事会全体董事过半数通过决议决定该董事是否关联关系董事，并决定其是否回避；

(3) 关联关系董事不得参与审议和列席会议讨论有关关联交易事项；

(4) 董事会对关联交易事项进行表决时，在扣除关联关系董事所代表的表决权票数后，由出席董事会的非关联关系董事按公司章程第一百零四条规定表决。

3、独立董事的监督

第十四条 重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5% 的关联交易）应由公司独立董事共同认可后，方可提交董事会讨论。

第十五条 独立董事就关联交易事宜作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据，所发生的费用由公司承担。

第十六条 独立董事应就公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 1% 的借款或其他资金往来以及公司是否采取有效措施回收欠款向董事会发表独立意见。

4、关联交易的信息披露

第二十五条 公司在成为上市公司前，公司的重大关联交易应在公司的年度报告、中期报告中及股东大会、董事会上予以充分披露。公司成为上市公司后，应按公司章程、交易所上市规则、本制度规定予以披露。

第二十六条 公司与其关联人达成的关联交易总额在 300 万元至 3000 万元之间或占公司最近经审计净资产值的 1% 至 5% 之间的，公司应在交易完成后按第三十条的规定立即披露，并在下次定期报告中披露有关交易的详细资料。

第二十七条 公司拟与关联人达成的关联交易总额高于 3000 万元或公司最近经审计净资产值的 5% 以上的，公司董事会必须在做出决议后二个工作日内予以公告。公告的内容须符合第三十条的规定。该关联交易在获得公司股东大会批准后方可实施，任何与该关联交易有利益关系的关联人在股东大会上应当放弃对该议案的投票权。公司应当在关联交易的公告中特别载明：“此项交易需经股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权”。

第二十八条 对于第二十七条所述的关联交易，公司董事会应当对该交易是否对公司有利发表意见，同时公司应当聘请独立财务顾问就该关联交易对全体股东是否公平、合理发表意见，并说明理由、主要假设及考虑因素。公司应当在下次定期报告中披露有关交易的详细资料。

第二十九条 公司披露关联交易，应当如实向公司股东或在公司成为上市公司后向证券交易所提交有关文件。

第三十条 公司就关联交易发布的临时报告应当包括但不限于以下内容：

- （1）交易日期、交易地点；

- (2) 有关各方的关联关系；
- (3) 有关交易及其目的的简要说明；
- (4) 交易的标的、价格及定价政策；
- (5) 关联人在交易中所占权益的性质及比重；
- (6) 关联交易涉及收购或者出售某一公司权益的，应当说明该公司的实际持有人的详细情况，包括实际持有人的名称及其业务状况；
- (7) 本次关联交易对公司是否有利；
- (8) 公司上市后还应符合证券交易所和中国证监会要求的其他内容。

第三十一条 公司与关联人就同一标的在十二个月内连续达成的关联交易累计金额达到本规则第二十七条所述标准的，公司须按第三十条的规定披露。

第三十二条 公司与关联人之间签署的关联交易协议，包括产品供销协议、服务协议、土地租赁协议等在招股意向书、公告书或前一个定期报告中已经披露过，协议主要内容（如价格、数量及付款方式等）在下一个定期报告之前未发生显著变化的，公司可豁免执行上述条款，但是应当在定期报告及其相应的财务报告附注中就该定期报告期限内协议的执行情况做出说明。

第三十三条 公司与关联人达成以下的关联交易，可免于披露：

- (1) 关联人按照公司的招股意向书、配股说明书或增发新股说明书以现金方式缴纳应当认购的股份；
- (2) 关联人依据股东大会决议领取股息或者红利；
- (3) 关联人购买公司发行的企业债券；
- (4) 公司与其控股子公司发生的关联交易。

五、减少和消除关联交易的措施

本公司在生产经营中与关联企业形成了一定的关联交易，目前存在的经常性关联交易是与香港固得和香港宝德的销售往来。通过香港固得和香港宝德的经销渠道销售产品，公司节省了设立分支机构所需的人力、物力投资，避免了因不熟悉当地文化和市场环境所可能引致的风险。

为切实保障股东利益，公司尽量避免和减少关联交易，公司将在扩大经营规

模的同时根据国内外市场对公司产品的需求情况，适时考虑自建销售渠道的模式、或收购相关关联企业设立香港办事处等方式，进一步扩大营销渠道和网络，逐步减少和消除与关联企业之间的关联交易。

六、公司独立董事关于关联交易事项的意见

公司独立董事对报告期内的关联交易审查后认为，公司报告期内的关联交易均履行了公司章程及公司相关制度规定的程序，并遵循了市场化原则，具备公允性。

第八章 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员

一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介

1、董事会成员

2005年8月24日，公司2005年第一次临时股东大会选举产生了第二届董事会，任期为2005年8月至2008年7月。董事会成员如下：

董事长：吴念博先生，简历参见第五章第四节相关内容。

董事：唐再南女士，中国籍，1957年出生，大专学历，注册会计师。曾在苏州花线厂、苏州漆器雕刻厂、苏州瑰宝箱包有限公司工作，历任公司财务副科长、副部长等职。1993年后进入苏州固得电子股份有限公司工作，历任公司财务经理、部长，财务总监等职务。

董事：杨小平先生，中国籍，1961年出生，大专学历。曾在苏州缝纫机厂、苏州电镀厂工作，1993年进入苏州固得电子有限公司工作，历任电镀分厂厂长，公司厂长等职务。

董事：黄浩荣先生，中国香港籍，1947年出生于中国香港。曾在香港恒昌电子五金公司工作，1983年至今任香港宝德电子公司董事，兼任香港固得电子公司董事。

董事：孙红敏女士，中国籍，1967年出生，高级职称。曾任上海市延安中学教师，现任上海汇银投资有限公司董事长，兼任上海汇银（集团）有限公司总裁办经理。

董事：乐琪女士，中国籍，1972年出生。上海大学会计系本科毕业，经济师。1995年至今在上海汽车制动器有限公司担任财务经理。

独立董事：张为佐先生，中国籍，1935年出生，毕业于北京大学物理系半导体专业（我国第一届半导体毕业生），教授级高级工程师。1958年起历任一机部电器科学研究所半导体研究室技术员、工程师，西安电力电子技术研究所工程师、副总工程师，美国国际整流器公司研究课题负责人(MCT等)及北京代表处

首席代表。现任国际整流器公司(IR)总部中国经理兼高级技术顾问，西安爱尔半导体制造有限公司副董事长，西安爱帕克电力电子有限公司董事(IR-PERI)，上海国际整流器贸易有限公司董事；兼任中国电源学会常务理事，中国电源学会元器件专委会主任委员，西安理工大学兼职教授，《电源技术应用》等多种技术杂志编委及顾问。著有“张为佐 20 年来功率半导体及电力电子论文专集”，《新型电力半导体器件》，主编《国外电力电子技术》，《电力电子技术丛书》，国内外发表有关论文约 100 余篇，申请美国专利 USP 618350, March, 1996。

独立董事：张雨歌先生，中国籍，1963 年出生，经济师，注册资产评估师、注册会计师。1981 年起先后在苏州市财政局、苏州市国有资产评估中心、苏州市财政局国资科等处任职，1992 年至 1999 年在苏州资产评估事务所担任所长，2000 年至今在江苏仁和资产评估有限公司担任董事长，并担任政协江苏省省委委员，苏州市政协常委，省注协常务理事等职务。

独立董事：沈新艺女士，中国籍，1965 年出生，1988 年 8 月毕业于苏州大学法学院法律专业，法学副教授，曾先后担任苏州广播电视大学团委书记、社会科学系主任、系支部书记、校教务处长等职。1990 年起被苏州市财政局聘为“全国注册会计师”资格考试经济法课程的主讲教师，和全国会计师职称考试经济法课程的主讲教师。

上述董事中，吴念博先生、唐再南女士、杨小平先生由苏州通博电子器材有限公司提名，乐琪女士由香港润福贸易有限公司提名，黄浩荣先生由香港宝德电子公司提名，孙红敏女士由上海汇银（集团）有限公司提名，独立董事张为佐先生、张雨歌先生、沈新艺女士由苏州通博电子器材有限公司提名。

2、监事会成员

经 2005 年 7 月 28 日召开的首届第三次职工代表大会及 2005 年 8 月 24 日召开的 2005 年第一次临时股东大会选举，产生了公司第二届监事会，任期为 2005 年 8 月至 2008 年 7 月。监事会成员如下：

监事会召集人：滕有西先生，参见本节“核心技术人员相关内容”。

监事：蒋晓航先生，中国籍，1957 年出生，大专学历。1997 年进入本公司财务处工作，任公司财务部副经理。

监事：吕明先生，中国香港籍，1927 年出生于中国香港，大学学历。历任

香港万隆洋行经理、香港明申公司经理。

监事：卞庄先生，中国籍，1956 年出生，大专学历，经济师。历任苏州塑料五厂副厂长，苏州春花吸尘器厂厂长，苏州市轻工局副局长，1995 年至今任苏州爱普电器有限公司董事长兼总经理。

监事：王维蒂女士，1978 年出生于中国台湾，大学学历。现任台湾崇光女子中学教师。

上述监事中，吕明先生由苏州通博电子器材有限公司提名，王维蒂女士由香港润福贸易有限公司提名，卞庄先生由苏州爱普电器有限公司提名，滕有西先生及蒋晓航先生为职工代表监事。

3、高级管理人员

总经理：吴念博先生，参见本节“董事会成员”相关内容。

副总经理：曾美华女士，中国台湾籍，1951 年出生于中国台湾，台湾大学商学硕士。1976-2002 年就职于台湾通用器材公司，历任制程工程处工程师及经理、制造处处长及副总、财务处财务长，于 2002 年 11 月进入苏州固得电子股份有限公司，担任副总经理。现任任期为 2005 年 8 月至 2008 年 7 月。

财务总监：唐再南女士，参见本节“董事会成员”相关内容。现任任期为 2005 年 8 月至 2008 年 7 月。

董事会秘书：高玉标先生，中国籍，1971 年出生，经济学硕士，经济师，持有律师资格证书和证券从业资格证书。曾在江苏石油化工学院担任教师，在申银万国证券股份有限公司投资银行部工作。2003 年进入本公司工作，历任证券部代表，董事会秘书职务。现任任期为 2005 年 8 月至 2008 年 7 月。

4、核心技术人员及顾问

曾美华女士，参见本节“高级管理人员”相关内容；

李谟汉先生，本公司晶圆部部长，中国台湾籍，1953 年 3 月出生。1976 年 11 月至 2001 年 8 月在台湾通用电子器材股份有限公司任硅晶棒切割技术员、晶圆部高级生产管理、晶圆部主任生产管理；2002 年 1 月至 2002 年 12 月在美国 AET 公司任外延片生产管理；2002 年 12 月至 2003 年 9 月任台湾半导体股份有限公司宜兰 SKY 厂高级工程师；

马晋生先生，本公司晶圆部副部长，中国籍，1942年9月出生，毕业于北京无线电专科学校半导体器件制造专业。1963年9月至1969年10月任上海元件五厂、研究所技术员；1970年3月至1991年10月任上海无线电二九厂工程师、车间主任；1992年11月至2001年12月任上海矽昌电子有限公司工程部经理、厂长；2002年1月至2004年2月任上海同福矽昌有限公司总工程师；

滕有西先生，中国籍，1968年出生，中共党员，硕士研究生毕业，工程师。1997年就职于本公司从事塑封整流二极管、玻封二极管、桥堆和二极管芯片的研发及相关技术和品质管理工作，先后参加了高压快恢复二极管、片式微型桥堆和超快速玻璃钝化整流二极管芯片的研究开发工作。

成铁军先生，中国籍，1959年出生，大专，工程师。1981年起任苏州计算机开发应用研究所副主任，1997年至今在苏州固得电子股份有限公司，任课长、项目经理、副部长，从事设备维修、计量与管理，新产品的开发，生产管理工作。曾被评为江苏省优秀技术开发设计人员，苏州电子工业局新品开发能手，获得苏州市科学技术进步二等奖和国家实用新型专利。

技术顾问：陈佐禹先生，中国籍，1936年出生，高级工程师。毕业于复旦大学物理系半导体物理专业，1962年就职于核工业部第九研究院从事核武器的研制工作。1982年6月至1996年10月，就职于苏州半导体总厂，从事III-V族化合物的发光、光敏材料器件的研制开发。1996年10月至今，受聘于本公司从事塑封整流二极管、玻封二极管的相关技术工作。

1974—1979年负责中子造氙率测量的宏观参数重大基础研究项目，该项目成果达当时国际水平，获国防科委重大科技成果三等奖；1984年获核武器研制有功人员荣誉证书和奖章；1986年成功开发GaAsp视觉敏感光敏二极管；1991年成功开发24元集成发光显示器；1983~1994年先后就GaAlAs液相外延，Gap欧姆接触等获苏州市科技成果二等奖。1962~1982年先后在《物理学报》、《原子能科学技术》、《核聚变》等杂志上发表多篇论文；1986~1996年在全国第一届至第五届发光器件学术会上均有论文发表。

技术顾问：陈建明先生，中国籍，1940年出生，高级工程师，中共党员。毕业于复旦大学物理系，1963年任职于中国科学院半导体研究所，参与我国第一颗人造卫星用变容二极管研制。1969年就职于苏州半导体总厂，任总工程师，

参与研制的 TTL 集成电路成功使用在 09-718 工程核潜艇计算机中，受到国家科委表彰。1994 年至今，受聘于本公司从事整流二极管及桥堆的相关技术工作。曾任中国光电子行业协会光电器件专业协会副秘书长，苏州市电子学会副理事长。

1975 年在国内首次研制成功集成注入逻辑计数、译码、驱动大规模集成电路；1978 年主管产品 JK、TTL 集成触发器在全国 16 家厂家质量评比中获第一名；1979 研制成功“低功耗肖特基 TTL 集成电路”，采用了离子注入及肖特基工艺；1984 年解决了光电子和集成电路组合显示器件缺笔问题，产品在国内保持领先地位。参编《中国集成电路大全》、《TTL 集成电路》；主编《国内外半导体光电器件实用手册》；撰写论文 30 多篇。

二、直接或间接持有公司股份的情况

1、本公司的股份目前均为法人股，本公司董事、监事、高管人员与核心技术人员在发行前都不存在直接持有本公司股份的情况；

2、本公司的董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的近亲属中不存在直接持有本公司股份的情况；

3、本公司董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员间接持有公司股份的情况如下：

姓名	直接出资或持股的企业	出资比例
吴念博	苏州通博电子器材有限公司	73.47%
唐再南	苏州通博电子器材有限公司	1.945%
杨小平	苏州通博电子器材有限公司	1.621%
黄浩荣	香港宝德电子有限公司	50%
滕有西	苏州通博电子器材有限公司	1.296%
蒋晓航	苏州通博电子器材有限公司	0.810%
卞 庄	香港爱普电器有限公司	90%

三、其他对外投资

截至本招股说明书签署日，董事长吴念博对苏州市固得纯净水有限公司出资 41.6 万元，占其注册资本的 80%；董事黄浩荣持有固得（香港）电子有限公司

90%股权。

除此之外，本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在其他对外投资情况。

四、薪酬情况

本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员最近一年的薪酬情况如下：

姓名	2005年薪酬(万元)	姓名	2005年薪酬(万元)
吴念博	181	黄浩荣	不在公司领取薪水
曾美华	73	乐琪	不在公司领取薪水
李谟汉	42	孙红敏	不在公司领取薪水
杨小平	22	吕明	不在公司领取薪水
马晋生	18	卞庄	不在公司领取薪水
唐再南	18	王维蒂	不在公司领取薪水
高玉标	17.5	张为佐	不领取独立董事津贴
滕有西	17.5	张雨歌	4(独立董事津贴)
蒋晓航	7	沈新艺	4(独立董事津贴)
成铁军	7		

五、兼职情况

本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员兼职情况如下：

姓名	兼职单位	兼任职务	兼职单位与本公司的关联关系
吴念博	苏州通博电子器材有限公司	董事	控股股东
	苏州市固得纯净水有限公司	董事长	同一实际控制人
黄浩荣	香港宝德电子有限公司	董事	外资股东
	固得(香港)电子有限公司	董事	销售客户
唐再南	苏州通博电子器材有限公司	董事	控股股东
杨小平	苏州通博电子器材有限公司	董事	控股股东
孙红敏	上海汇银(集团)有限公司	总裁办主任	发起人股东
乐琪	上海汽车制动器有限公司	财务经理	无
张为佐	国际整流器公司(IR)总部	中国经理	无
张雨歌	江苏仁和资产评估有限公司	董事长	无
沈新艺	苏州广播电视大学	教务处长	无
滕有西	苏州通博电子器材有限公司	董事	控股股东
卞庄	苏州爱普电器有限公司	董事长、总经理	发起人股东
蒋晓航	苏州通博电子器材有限公司	监事	控股股东
王维蒂	台湾崇光女子中学	教师	无

本公司全体董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均声明，除以上兼职外没有未披露的兼职情况。

六、其他应披露的信息

1、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员之间不存在配偶关系、三代以内直系和旁系亲属关系。

2、公司核心技术人员均与公司签订了技术保密协议，截至本招股说明书签署日，未发生违反上述技术保密协议的事项。

3、公司董事、监事、高级管理人员均符合法律法规规定的任职资格。

七、近三年董事、监事、高级管理人员的变化情况

2003年5月7日，公司2002年年度股东大会选举吴念博、杨小平、唐再南、滕有西、陈鉴章、陈王碧缘、黄浩荣、卞庄、孙红敏为公司董事，选举吕明、李志军、蒋晓航为公司监事，同意朱良保辞去监事职务。

2003年9月26日，公司第一届董事会第四次会议聘任吴念博为公司总经理，曾美华为公司副总经理，刘羽隆为公司副总经理兼总工程师，唐再南为公司财务总监，高玉标为公司董事会秘书，唐再南不再兼任公司董事会秘书。

2003年10月28日，公司2003年度第一次临时股东大会选举吴念博、杨小平、唐再南、乐琪、黄浩荣、孙红敏为公司董事，选举张雨歌为公司独立董事，同意滕有西、陈鉴章、陈王碧缘、卞庄辞去公司董事职务，选举滕有西、卞庄、蒋晓航、吕明、王维蒂为公司监事，同意李志军辞去监事职务。

2004年1月8日，公司2004年度第一次临时股东大会补选张为佐、沈新艺为公司独立董事。

2005年8月24日，公司2005年第一次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会，董事会及监事会成员均未发生变化；第二届董事会第一次会议聘任吴念博为公司总经理，曾美华为公司副总经理，唐再南为公司财务总监，高玉标为公司董事会秘书，刘羽隆不再担任公司副总经理兼总工程师。

第九章 公司治理结构

本公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》、其他有关法规及《公司章程》的要求运作，股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书制度逐步建立、健全，形成了比较科学、规范的公司治理结构。

目前，本公司修改后的《公司章程（草案）》已经 2005 年年度股东大会表决通过。本公司的《公司章程》符合有关法律、法规以及中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》的有关规定，《公司章程》中关于股东义务、股东大会、董事义务、董事会会议、监事会会议和总经理职责的规定，符合相关规定的要求，《公司章程》依法建立了发行人的法人治理结构和制度，并制定了累计投票制的具体实施方法。

一、股东大会、董事会、监事会

自股份公司成立以来，公司已召开了七次股东大会（包括年度股东大会和临时股东大会），对公司章程的订立和修改、增资扩股、重大投资决策、董监事会工作报告、发行授权、募集资金投向、股利分配、董监事会人员的选举等作出决议，依法履行了其作为公司权利机构的职责，对公司其他机构形成了较好的监督管理授权关系。

自股份公司成立以来，本公司确保了历次股东大会、董事会和监事会的召集、召开、议事、表决符合法定程序，依法履行了通知、关联股东回避等义务。

二、独立董事

本公司经 2003 年度第一次临时股东大会批准建立独立董事制度，并经 2004 年度第一次临时股东大会批准增加了独立董事名额。本公司独立董事拥有《公司

法》、其他相关法律法规及《公司章程》赋予董事和独立董事的全部职权。

目前公司董事会拥有独立董事三名，其中一名为具有会计专业高级职称人士。独立董事制度有效提高了公司运作、决策的透明度和规范化，强化了约束和监督机制。

三、董事会秘书

公司董事会设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。

本公司董事会秘书承担法律、法规以及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，也享有相应的工作职权，对公司治理有着重要作用，促进了公司的运作规范。

四、关于各专门委员会的设置

本公司《章程（草案）》第一百九十二条规定，公司董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

本届董事会目前尚未设置上述专门委员会，但根据公司的发展规划，董事会已开始准备设立各专门委员会的提案，并计划提交下次股东大会表决。

五、近三年违法违规情况

本公司自成立至今，公司及董事、监事和高级管理人员严格按照公司章程及相关法律法规的规定开展经营，不存在违法违规行为，也不存在被相关主管机关处罚的情况。

六、近三年资金占用和对外担保的情况

公司执行了严格的资金管理制度，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形。

公司章程中已明确对外担保的审批权限和审议程序，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形。

七、内部控制制度的评价

1、公司管理层对内部控制制度的自我评价

本公司根据《公司法》、其他有关法律法规及《公司章程》，建立了规范的法人治理结构，并根据现代企业制度要求建立公司组织结构，明确规定了股东大会、董事会、监事会、经理层的职责权限，在公司内部建立了授权机制，明确了授权的范围、程序以及责任分配方法，建立了内部审计制度和有效的人事政策，形成了有效的内部控制环境。

本公司制定了严格的《财务与审计管理制度》，包括公司内部财务管理、企业内部财务管理的基础工作、资金筹集管理、货币资金及往来户结算的管理、存货的管理、固定资产的管理、在建工程的管理、无形资产和其他资产、递延资产的管理、对外投资管理、成本费用管理、销售收入、企业利润及其分配的管理、财务报告及财务评价等，建立了有效的财务内部控制制度。

本公司还制定较为完善了其他规章制度，主要包括《决策与监督内控制度》、《销售及应收帐款管理制度》、《采购内控制度》和《人事管理制度》等程序文件，涵盖了公司人事、物资、生产计划、供销、设备能源、劳动、安全卫生、环境保护、文书档案、劳保福利、精神文明建设、奖励惩罚等方面。

上述制度的建立和有效的执行，确保了公司有序、有效地运行，保证了生产经营活动稳定开展，为本公司未来的发展奠定了基础。本公司管理层认为公司的内部控制制度是完整、合理、有效的。

2、注册会计师对公司内部控制制度的评价

德勤华永会计师事务所对公司内部控制制度进行了审核并出具了《内部控制

审核报告》，认为本公司在所有重大方面有效地保持了按照财政部颁发的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》及相关具体规范标准建立的与会计报表相关的内部控制。

第十章 财务会计信息

以下引用的财务数据，非经特别说明，均引自本公司经德勤华永会计师事务所有限公司审计的财务报告。本章的财务会计数据及有关说明反映了本公司2003至2006年6月30日经审计会计报表及附注的主要内容，本公司提醒投资者关注本招股说明书所附财务报告和审计报告全文，以获取全部的财务资料。

第一节 审计意见

本公司聘请德勤华永会计师事务所有限公司对2003年12月31日、2004年12月31日、2005年12月31日及2006年6月30日的资产负债表和2003年度、2004年度、2005年度及2006年1月1日至6月30日的利润表及现金流量表进行了审计。德勤华永会计师事务所出具了德师报(审)(06)第P1166号标准无保留意见的审计报告。

德勤华永会计师事务所认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了本公司2003年12月31日、2004年12月31日、2005年12月31日及2006年6月30日的财务状况及2003年度、2004年度、2005年度及2006年1月1日至6月30日经营成果和现金流量。

第二节 简要财务报表

本节披露的简要会计报表反映了公司的基本财务状况、经营成果和现金流量情况。

一、简要资产负债表（单位：元）

资 产	2006-6-30	2005-12-31	2004-12-31	2003-12-31
流动资产：				
货币资金	29,948,484.15	33,651,784.64	13,119,296.59	40,082,251.47
应收票据	706,776.00	-	63,326.00	-
短期投资	-	-	-	9,246,600.00
应收账款	69,191,504.71	76,454,519.44	73,565,561.55	64,549,581.95
其他应收款	8,124,577.99	3,992,785.75	699,743.79	13,616,747.30
预付账款	1,973,312.15	462,180.82	196,173.74	1,751,915.16
存货	80,896,910.41	65,933,612.73	69,792,988.40	50,866,987.63
待摊费用	460,000.00	460,000.00	460,000.00	-
流动资产合计	191,301,565.41	180,954,883.38	157,897,090.07	180,114,083.51
固定资产：				
固定资产原价	148,298,983.00	139,979,081.73	115,307,442.25	82,691,368.65
减：累计折旧	62,995,917.76	55,218,764.47	41,186,490.94	30,248,680.28
固定资产净值	85,303,065.24	84,760,317.26	74,120,951.31	52,442,688.37
减：固定资产减值准备	1,333,373.88	1,333,373.88	1,333,373.88	1,333,373.88
固定资产净额	83,969,691.36	83,426,943.38	72,787,577.43	51,109,314.49
在建工程	12,584,078.69	12,876,281.09	18,398,908.77	20,530,036.40
固定资产合计	96,553,770.05	96,303,224.47	91,186,486.20	71,639,350.89
无形资产及其他资产：				
无形资产	16,245,291.79	15,507,523.45	11,217,663.57	11,482,391.13
无形资产及其他资产合计	16,245,291.79	15,507,523.45	11,217,663.57	11,482,391.13
资产总计	304,100,627.25	292,765,631.30	260,301,239.84	263,235,825.53
负债及股东权益	2006-6-30	2005-12-31	2004-12-31	2003-12-31
流动负债：				
短期借款	-	6,527,272.34	7,345,300.97	14,094,528.33
应付票据	6,797,681.64	5,775,801.46	-	-
应付账款	61,092,782.90	59,236,109.21	57,958,985.23	73,374,095.58
预收账款	1,189,348.52	803,242.04	124,049.15	2,251,357.08
应付工资	882,546.91	2,418,923.08	3,059,833.20	3,566,212.00
应付福利费	1,053,603.19	1,753,603.19	2,753,603.19	3,391,680.08
应付股利	11,360,760.99	-	-	540,481.67
应交税金	(925,536.34)	153,891.59	(2,696,846.19)	271,443.60
其他应交款	665.60	665.60	-	-
其他应付款	15,007,818.65	16,989,128.03	14,699,898.28	14,414,458.43
预提费用	547,822.11	-	-	-
流动负债合计	97,007,494.17	93,658,636.54	83,244,823.83	111,904,256.77
长期负债：				
长期应付款	740,571.23	740,571.23	740,571.23	740,571.23
长期负债合计	740,571.23	740,571.23	740,571.23	740,571.23
负债合计	97,748,065.40	94,399,207.77	83,985,395.06	112,644,828.00
股东权益：				
股本	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
盈余公积	21,991,744.39	21,991,744.39	17,337,389.25	12,728,662.17
其中：法定公益金	-	7,330,581.46	5,779,129.75	4,242,887.39
未分配利润	84,360,817.46	65,000,000.00	50,000,000.00	32,862,335.36
资产负债表日后决议分配的现金股利	-	11,374,679.14	8,978,455.53	5,000,000.00
股东权益合计	206,352,561.85	198,366,423.53	176,315,844.78	150,590,997.53
负债及股东权益总计	304,100,627.25	292,765,631.30	260,301,239.84	263,235,825.53

二、简要利润及利润分配表（单位：元）

项目	2006年1-6月	2005年度	2004年度	2003年度
主营业务收入	204,058,686.84	377,707,638.43	374,502,073.89	328,830,995.02
减：主营业务成本	163,926,426.46	307,633,605.73	304,537,175.39	253,357,198.55
主营业务税金及附加	-	-	5,238.36	-
主营业务利润	40,132,260.38	70,074,032.70	69,959,660.14	75,473,796.47
加：其他业务利润	465.58	1,080.67	-	940.17
减：营业费用	2,017,147.32	3,472,385.55	2,860,188.31	2,578,414.26
管理费用	18,142,104.48	31,972,975.63	34,627,076.10	23,318,092.65
财务费用	632,502.88	2,497,326.10	757,934.13	393,675.89
营业利润	19,340,971.28	32,132,426.09	31,714,461.60	49,184,553.84
加：投资收益	114,135.18	176,300.00	99,039.02	(663,819.08)
补贴收入	2,176,000.00	559,300.00	1,998,375.00	1,005,665.05
营业外收入	3,500.00	1,470,297.66	1,000.00	966.28
减：营业外支出	16,824.60	101,626.67	125,072.69	191,319.93
利润总额	21,617,781.86	34,236,697.08	33,687,802.93	49,336,046.16
减：所得税	2,256,964.40	3,207,662.80	2,962,955.68	4,792,122.20
净利润	19,360,817.46	31,029,034.28	30,724,847.25	44,543,923.96
加：年初未分配利润	65,000,000.00	50,000,000.00	32,862,335.36	30,000,000.00
可供分配的利润	84,360,817.46	81,029,034.28	63,587,182.61	74,543,923.96
减：提取法定盈余公积	-	3,102,903.43	3,072,484.72	4,454,392.40
提取法定公益金	-	1,551,451.71	1,536,242.36	2,227,196.20
可供股东分配的利润	84,360,817.46	76,374,679.14	58,978,455.53	67,862,335.36
减：资产负债表日后决议分配的现金股利	-	11,374,679.14	8,978,455.53	5,000,000.00
转作股本的普通股股利	-	-	-	30,000,000.00
未分配利润	84,360,817.46	65,000,000.00	50,000,000.00	32,862,335.36

三、简要现金流量表（单位：元）

项目	2006年1-6月	2005年度	2004年度	2003年度
经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	213,375,713.67	379,968,822.33	364,893,758.76	329,316,482.30
收到的税费返还	7,084,458.17	19,587,070.98	20,804,355.45	17,965,569.62
收到的其他与经营活动有关的现金	2,343,448.49	728,464.72	2,039,836.62	1,727,313.83
现金流入小计	222,803,620.33	400,284,358.03	387,737,950.83	349,009,365.75
购买商品、接受劳务支付的现金	180,620,498.52	295,463,292.97	329,565,647.74	252,378,396.48
支付给职工以及为职工支付的现金	18,004,685.82	32,255,394.19	33,159,998.48	23,218,289.84
支付的各项税费	2,336,735.84	4,529,784.53	6,773,582.10	6,673,062.73
支付的其他与经营活动有关的现金	9,570,076.85	13,723,972.54	11,242,310.82	8,182,847.09
现金流出小计	210,531,997.03	345,972,444.23	380,741,539.14	290,452,596.14

经营活动产生的现金流量净额	12,271,623.30	54,311,913.80	6,996,411.69	58,556,769.61
投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	-	-	9,345,639.02	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	2,318,400.00	7,000,000.00	-	3,500.00
现金流入小计	2,318,400.00	7,000,000.00	9,345,639.02	3,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	9,034,598.87	30,879,179.20	31,984,093.97	26,876,606.60
投资所支付的现金	4,000,000.00	800,000.00	-	9,910,419.08
现金流出小计	13,034,598.87	31,679,179.20	31,984,093.97	36,787,025.68
投资活动产生的现金流量净额	(10,716,198.87)	(24,679,179.20)	(22,638,454.95)	(36,783,525.68)
筹资活动产生的现金流量：				
借款所收到的现金	-	63,551,225.67	58,072,777.17	14,094,528.33
现金流入小计	-	63,551,225.67	58,072,777.17	14,094,528.33
偿还债务所支付的现金	6,527,272.34	64,369,254.30	64,822,004.53	-
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	104,989.35	9,446,987.93	4,571,684.26	5,711,633.57
现金流出小计	6,632,261.69	73,816,242.23	69,393,688.79	5,711,633.57
筹资活动产生的现金流量净额	(6,632,261.69)	(10,265,016.56)	(11,320,911.62)	8,382,894.76
汇率变动对现金的影响	-	-	-	157,965.73
现金及现金等价物净增加额	(5,076,837.26)	19,367,718.04	(26,962,954.88)	30,314,104.42

第三节 财务报表编制基础、主要会计政策和会计估计

一、编制基础

本公司执行由中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、《企业会计制度》及其补充规定。

二、主要会计政策和会计估计

报告期内，对公司财务状况、经营成果有重大影响的会计政策和会计估计包括：

1、收入确认和计量

销售商品收入：在公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

利息收入：按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定。

补贴收入：补贴收入于实际收到时确认为收入。

2、存货

存货按取得时的实际成本计价，实际成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和使用状态所发生的支出。存货主要分为原材料、在产品、自制半成品和产成品等。

存货发出时，按照实际成本进行核算，并采用加权平均法确定其实际成本。

低值易耗品在领用时一次摊销。

公司的存货盘存制度为永续盘存制。

期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。可变现净值是指在正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。

3、固定资产及折旧

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法提取折旧。各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

类别	估计残值率	折旧年限	年折旧率
房屋建筑物	10%	20年	4.5%
机器设备	10%	10年	9%
电子设备、器具及家具	10%	5年	18%
运输设备	10%	5年	18%

与固定资产有关的后续支出，在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计时，计入固定资产账面价值，其增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。

固定资产减值准备

期末，公司按固定资产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当固定资产

可收回金额低于账面价值时，则按其差额计提固定资产减值准备。

4、无形资产

无形资产按取得时的实际成本计量。投资者投入的无形资产，其实际成本按投资各方确认的价值确定；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，其实际成本按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等费用确定，依法申请取得前发生的研究与开发费用均直接计入当期损益；购入的无形资产，其实际成本按实际支付的价款确定。

执行《企业会计制度》前购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权作为无形资产核算，并按下述的摊销方式平均摊销计入损益。执行《企业会计制度》后购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权在尚未开发或建造自用项目前，作为无形资产核算，并按下述的摊销方式平均摊销；当利用土地建造自用项目时，将土地使用权的账面价值全部转入在建工程成本。

无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，则摊销期限不超过受益年限和有效年限两者之中较短者。如合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限为 10 年。

期末，公司按无形资产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当无形资产可收回金额低于账面价值时，则按其差额提取无形资产减值准备。

5、外币业务折算

发生外币(指记账本位币以外的货币)业务时，外币金额按业务发生当月初的市场汇价中间价(以下简称“市场汇价”)折算为人民币入账。外币账户的年末外币金额按年末市场汇价折算为人民币金额。外币汇兑损益计入当期的财务费用。

6、坏账核算

(1) 坏账确认的标准

因债务人破产，依照法律程序清偿后，确定无法收回的应收款项；

因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确定无法收回的应收款项；

因债务人逾期未履行偿债义务，并且有确凿证据表明无法收回或收回的可能性不大的应收款项。

(2) 坏账损失的核算方法

采用备抵法，按年末应收款项余额之可收回性计提。公司根据以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量情况以及其他相关信息，先对可收回性与其他款项存在明显差别的应收款项采用个别认定法计提坏账准备，然后再对剩余应收款项按账龄分析法计提一般坏账准备。一般坏账准备的计提比例如下：

账龄	计提比例%
1 年以内	5
1—2 年	20
2 年以上	100

7、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定。

实际工程成本包括在建期间发生的各项工程支出、以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。在建工程不计提折旧。

对长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性的在建工程；或其他有证据表明已发生了减值的在建工程，按可收回金额低于账面价值的差额，计提减值准备。

8、所得税

所得税按应付税款法核算。计算所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度会计所得额作相应调整后得出。

二、会计政策变更和会计差错

1、2003 年度公司对如下会计政策进行了变更：

根据财政部关于印发《企业会计准则—资产负债表日后事项》的通知（财会[2003]12 号），对于资产负债表日后至财务报告批准报出日之间董事会制定的利润分配方案中分配给投资者的利润，由原作为调整事项确认为应付股利，改为在资产负债表股东权益中单独列示。

此项会计政策变更采用追溯调整法调整 2001 年和 2002 年资产负债表，对报告期内资产负债表无影响。

2、不影响损益的非重大会计差错

2005 年度前，公司将因产品出口业务所形成的应收出口退税计入了“其他应收款”核算，并计提了坏帐准备，属于不影响损益的非重大会计差错。现将相关情况说明如下：

(1) 依据 2001 年和 2002 年当时的退税实务环境，公司实际收到应收出口退税的时间较晚，存在大量应属于公司的资金被暂时占有，短期无法收回的情形，2001 年末和 2002 年末应收出口退税余额分别达 11,299,694.90 元和 14,185,078.19 元；

(2) 根据公司申请出口退税的实务经验，无法保证 100% 全额收到出口退税，有时会因个别单据问题无法收到出口退税；

(3) 依据当时的退税实务环境，税务主管部门欠出口型企业的应退出口退税金额巨大，部分欠税时间较长，公司实际收到出口退税存在潜在的不确定性；

(4) 根据稳健性的原则，公司将应收出口退税款转入其他应收款，并按 5% 的比例计提了坏帐准备，金额分别为 2001 年度 564,984.75 元，2002 年度 144,269.16 元。

(5) 从 2003 年 12 月份起，国家出口退税整体环境和出口退税政策发生了变化，预计“应收出口退税”账面余额将全部收回，故公司在编制 2003 年会计报表时对“应收出口增值税退税”余额不再计提坏帐准备金，并将 2001 年及 2002 年对“应收出口增值税退税”计提的坏帐准备转回。

(6) 2004 年，公司收到了以前年度和当年度税务部门欠付的所有应收出口退税，截止 2004 年底，公司的应收出口退税余额为零。

假设报告期内公司将应收出口退税计入“应收补贴款”核算，则“应收补贴款”科目的备考信息如下：

		年初余额	(+) 应退金额	(-) 已退金额	年末余额
2001	应收补贴款	0	11,299,694.90	-	11,299,694.90
	其中：1、增值税先征后退	2001	10,258,753.56		10,258,753.56
	2、增值税出口退税	2001	1,040,941.34		1,040,941.34
	应收补贴款坏帐准备		0		564,984.75
2002	应收补贴款	11,299,694.90	3,515,134.53	629,751.24	14,185,078.19
	其中：1、增值税先征后退	2001	10,258,753.56	367740.86	9,996,743.18
	2、增值税出口退税	2001	1,040,941.34	2,688,224.77	3,729,166.11
		2002		459,168.90	459,168.90

	应收补贴款坏帐准备		564,984.75			709,253.91
2003	应收补贴款		14,185,078.19	17,040,883.45	17,965,569.62	13,260,392.02
	其中：1、增值税先征后退	2001	9,996,743.18		9,996,743.18	
	2、增值税出口退税	2001	3,729,166.11		3,729,166.11	
		2002	459,168.90	8,577,202.58	4,239,660.33	4,796,711.15
		2003		8,463,680.87		8,463,680.87
	应收补贴款坏帐准备		709,253.91			0
2004	应收补贴款		13,260,392.02	7,137,217.27	20,397,609.29	0
	其中：增值税出口退税	2002	4,796,711.15		4,796,711.15	
		2003	8,463,680.87	989,912.87	9,453,593.74	
		2004		6,147,304.40	6,147,304.40	
		应收补贴款坏帐准备		-		

自 2005 年起，公司将应收出口退税由“其他应收款”转至“应收补贴款”核算。报告期内公司将应收出口退税计入“其他应收款”核算属于不影响损益的非重大会计差错，且 2005 年初“应收补贴款”余额为零，故不调整相关项目。

第四节 最近一期末主要资产

一、主要固定资产

截至 2006 年 6 月 30 日，发行人拥有所有权的固定资产原值 14,829.90 万元，包括专用生产设备、房屋及建筑物、通用设备、运输设备等，其中主要生产线 14 条，厂房建筑面积 30,400 平方米，主要生产线、关键设备可满足继续生产的需要。

单位：万元

类别	原值	累计折旧	减值准备	净值
房屋建筑物	1,663.79	395.44	33.00	1,235.35
机器设备	6,220.24	2,293.23	85.34	3,841.67
电子设备、器具及家具	6,560.71	3,378.88	15.00	3,166.83
运输设备	385.16	232.04	-	153.12
合计	14,829.90	6,299.59	133.34	8,396.97

二、对外投资

截至 2006 年 6 月 30 日，本公司无对外投资。

三、无形资产

截止 2006 年 6 月 30 日，本公司账面的无形资产为 16,245,291.79 元，包括土地使用权和软件。土地使用权中，原值人民币 3,012,853.00 元的使用权为 1998 年原江苏固得电子有限公司经法定程序清算终止时偿债转入（参见第五章相关内容），其余为以“出让”方式取得；软件均为以“购入”方式取得。无形资产的明细具体情况参见第六章第四节相关内容。

公司无形资产规模及摊销情况如下表所示：

单位：元

	土地使用权	软 件	合 计
原值			
2006 年 1 月 1 日余额	16,292,839.02	47,000.00	16,339,839.02
本期增加	-	1,006,900.00	1,006,900.00
本期减少额	-	-	-
2006 年 6 月 30 日余额	16,292,839.02	1,053,900.00	17,346,739.02
累计摊销			
2006 年 1 月 1 日余额	797,065.72	35,249.85	832,315.57
本期计提额	160,608.36	108,523.30	269,131.66
本期减少额	-	-	-
2006 年 6 月 30 日余额	957,674.08	143,773.15	1,101,447.23
净值			
2006 年 1 月 1 日余额	15,495,773.30	11,750.15	15,507,523.45
2006 年 6 月 30 日余额	15,335,164.94	910,126.85	16,245,291.79
剩余摊销年限	40—49 年	1—5 年	

第五节 最近一期末主要债项

截止 2006 年 6 月 30 日，本公司的负债总额为 97,748,065.40 元。其中，流动负债 97,007,494.17 元，占负债总额比例为 99.24%；长期负债 740,571.23 元，占负债总额的比例为 0.76%。具体情况如下：

一、银行借款

截止 2006 年 6 月 30 日，公司无短期借款、无长期借款，无一年内到期的长期负债。

二、对内部人员和关联方的负债

1、截至 2006 年 6 月 30 日应付工资 882,546.91 元，系预提本年度职工年终奖金。

2、截至 2006 年 6 月 30 日应付福利费 1,053,603.19 元，系职工奖励福利金。

三、承诺事项

截止至 2006 年 6 月 30 日，公司的承诺事项包括：

1、资本承诺

已签约但尚未于会计报表中确认的购建长期资产及对外投资承诺 1741.1 万元。

2、租赁承诺

公司对外签订的不可撤消的经营租赁合同合计 71.4 万元。

第六节 股东权益

单位：元

股东权益（净资产）	2006-6-30	2005-12-31	2004-12-31	2003-12-31
股本	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	-	-	-	-
盈余公积	21,991,744.39	21,991,744.39	17,337,389.25	12,728,662.17
未分配利润	84,360,817.46	65,000,000.00	50,000,000.00	32,862,335.36
资产负债表日后决议分配的现金股利	-	11,374,679.14	8,978,455.53	5,000,000.00
股东权益合计	206,352,561.85	198,366,423.53	176,315,844.78	150,590,997.53

第七节 现金流量基本情况

单位：元

项 目	2006年1-6月	2005年度	2004年度	2003年度
经营活动产生的现金流量净额	12,271,623.30	54,311,913.80	6,996,411.69	58,556,769.61
投资活动产生的现金流量净额	(10,716,198.87)	(24,679,179.20)	(22,638,454.95)	(36,783,525.68)
筹资活动产生的现金流量净额	(6,632,261.69)	(10,265,016.56)	(11,320,911.62)	8,382,894.76
汇率变动对现金的影响	-	-	-	157,965.73
现金及现金等价物净增加额	(5,076,837.26)	19,367,718.04	(26,962,954.88)	30,314,104.42

第八节 期后事项、或有事项及其他重大事项

一、期后事项及或有事项

截止至本招股说明书签署日，本公司不存在重大期后事项和重大或有事项。

二、其他重大事项

根据公司 2001 年 10 月 30 日与 CCI 签订的《“私有标签”协议书》，由 CCI 将其所拥有的专用生产设备交予公司用于专门加工 CCI 的产品，该设备所有权归属于 CCI，在合约有效期内的维护风险和相关费用(包括设备货值办理保险)均由公司承担。设备的使用期限是五年，合约到期后，双方可按届时商定的价格买断设备，或视合作情况，由双方续延合同，公司继续使用上述设备。

根据公司 2004 年 7 月 30 日与 CCI 和 Vishay 通用半导体有限公司(简称“VGSLLC”)的《补充协议》，自 2004 年 9 月 1 日起，由 VGSLLC 正式接管 CCI 公司在亚洲的一切经营活动，所有 CCI 的权利义务由 VGSLLC 承继。

截止 2006 年 6 月 30 日，上述专用生产设备报关价值共计 2,114,369.92 美元，公司已记录在备查账中未予入账反映。

第九节 财务指标

一、主要财务指标

主要财务指标	2006-6-30	2005-12-31	2004-12-31	2003-12-31
流动比率	1.97	1.93	1.90	1.61

速动比率	1.13	1.23	1.06	1.15
资产负债率	32.14%	32.24%	32.26%	42.79%
应收帐款周转率	2.80	5.04	5.42	5.08
存货周转率	2.23	4.53	5.05	5.72
息税折旧摊销前利润	29,769,056.16	49,073,059.46	45,141,050.48	57,219,123.24
利息保障倍数	206.90	95.05	194.66	2,474.10
每股经营活动产生的现金流量	0.12	0.54	0.07	0.59
每股净现金流量	-0.05	0.19	-0.26	0.30
无形资产占净资产的比例	0.44%	0.02%	0.02%	0.03%

主要财务指标计算公式：

- 1、流动比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
- 2、速动比率 = 速动资产 ÷ 流动负债
- 3、资产负债率 = 负债总额 ÷ 资产总额
- 4、应收帐款周转率 = 主营业务收入 ÷ 应收帐款平均余额
- 5、存货周转率 = 主营业务成本 ÷ 存货平均余额
- 6、息税折旧摊销前利润 = 利润总额 + 利息支出 - 利息收入 + 折旧 + 摊销
- 7、利息保证倍数 = (利润总额 + 利息支出 - 利息收入) / (利息支出 - 利息收入)
- 8、每股经营活动产生的现金流量 = 经营活动产生的现金流量净额 / 总股本
- 9、每股净现金流量 = 现金及现金等价物净增加（减少）额 / 总股本
- 10、无形资产（土地使用权除外）占净资产的比例 = 无形资产（土地使用权除外） / 净资产

二、发行前每股收益和净资产收益率

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则（第9号）》、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号》要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

1、净资产收益率

报告期 利润	2006 上半年		2005		2004		2003	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主 营 业	19.45%	19.29%	35.33%	37.55%	39.68%	42.80%	50.12%	58.01%

务利润								
营业利润	9.37%	9.30%	16.20%	17.22%	17.99%	19.40%	32.66%	37.81%
净利润	9.38%	9.31%	15.64%	16.63%	17.43%	18.80%	29.58%	34.24%
扣除非经常损益后的净利润	8.37%	8.30%	14.54%	15.45%	16.24%	17.52%	28.31%	32.78%

2、每股收益

报告期利润	2006 上半年		2005		2004		2003	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	0.401	0.401	0.701	0.701	0.700	0.700	0.755	0.755
营业利润	0.193	0.193	0.321	0.321	0.317	0.317	0.492	0.492
净利润	0.194	0.194	0.310	0.310	0.307	0.307	0.445	0.445
扣除非经常损益后的净利润	0.173	0.173	0.288	0.288	0.286	0.286	0.426	0.426

发行前每股收益和净资产收益率的计算公式：

1、全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下：

$$\text{全面摊薄净资产收益率} = \text{报告期利润} \div \text{期末净资产}$$

$$\text{全面摊薄每股收益} = \text{报告期利润} \div \text{期末股本总额}$$

2、加权平均净资产收益（ROE）的计算公式如下：

$$\text{ROE} = P / (E_0 + NP/2 + E_i \times M_i/M_0 - E_j \times M_j/M_0)$$

其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E₀ 为期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

3、加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下：

$$\text{EPS} = P / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i/M_0 - S_j \times M_j/M_0)$$

其中：P 为报告期利润；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购或缩股等减少股份数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

第十节 公司设立时的资产评估情况

公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司时由江苏仁合资产评估有限公司对资产和负债进行了评估，并出具了〔苏仁评报字（2002）第 30 号〕资产评估报告书。公司未根据资产评估结果进行账务调整。

一、主要评估方法

- 1、流动资产评估方法：流动资产主要包括货币资金、应收账款、预付账款和存货等，其中产成品的评估以售价扣减相应的销售费用、税金及附加和合理利润后确定评估值。
- 2、固定资产评估方法：固定资产评估采用重置成本法。
- 3、无形资产评估方法：无形资产评估基准地价修正法。

二、资产评估结果

单位：万元

项 目	账面值	调整后账面值	评估价值	增值额	增值率(%)
流动资产	8,695.59	8,696.48	9,254.78	558.3	6.42
长期投资	-	-	-	-	-
固定资产	4,305.24	4,305.24	5,333.4	1,028.16	23.88
其中：在建工程	305.81	305.81	305.81	-	
建筑物	984.2	984.2	1,788.05	803.85	81.68
设 备	3,090.57	3,090.57	3,239.54	148.97	4.82
无形资产	385.87	385.87	444.91	59.04	15.30
其中：土地使用权	385.87	385.87	444.91	59.04	15.30
其他资产	33.22	33.22	76.02	42.8	128.84
资产总计	13,419.92	13,420.81	15,109.11	1,688.30	12.58
流动负债	6,345.86	6,346.75	6,346.75	-	-
长期负债	74.06	74.06	74.06	-	-
负债总计	6,419.92	6,420.81	6,420.81	-	-
净资产	7,000.00	7,000.00	8,688.30	1,688.30	24.12

第十一节 验资情况

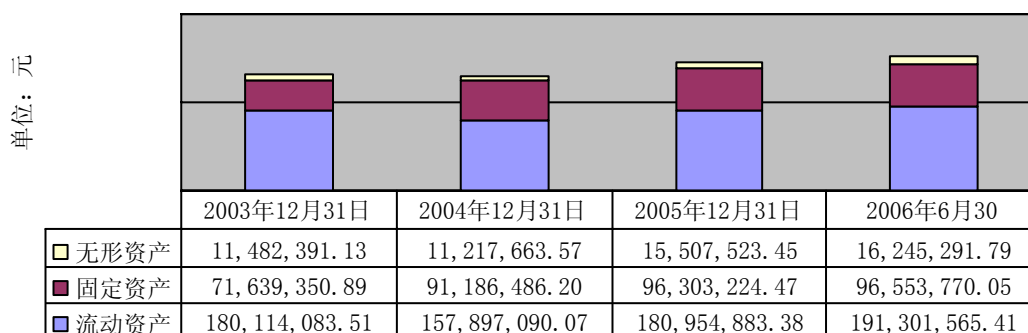
参见第五章“发行人基本情况”相关内容。

第十一章 管理层讨论与分析

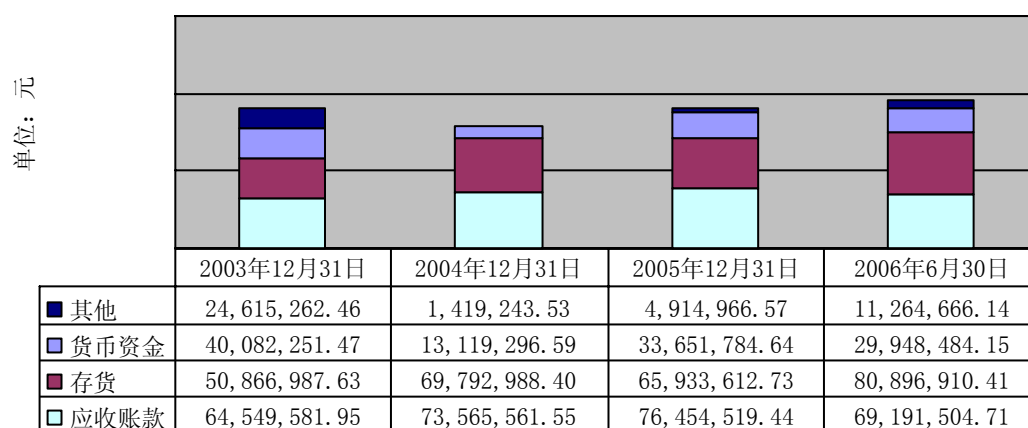
一、财务状况

1、公司的资产结构及资产周转能力

2003 至 2005 年末及 2006 年 6 月 30 日，公司总资产分别为 263,235,825.53 元、260,301,239.84 元、292,765,631.30 元和 304,100,627.25 元，资产结构稳定，资产流动性良好。



公司流动资产的构成中存货及应收账款所占比例较高，结构基本保持稳定。



注：上图中“其他”包括其他应收款、应收票据、短期投资、预付账款及待摊费用等。

存货主要为产成品、原材料和在产品，其中原材料所占比例最高，主要原因

是近年来部分原材料价格上涨较快，公司为减轻不利影响，加强了采购管理和原材料储备；公司保持了较高的存货周转率，但上述原因也导致周转率有所下降，2003至2005年及2006年上半年周转率分别为5.72、5.05、4.53和2.23。

公司主营业务收入的大部分来自于稳定的OEM客户及国外经销商，与主要业务伙伴的合作时间长并形成了可信赖的合作关系，所以应收账款占主营业务收入的比例较高，但应收账款保持了较快的周转速度（2003年至2005年及2006年上半年应收账款周转率分别为5.08、5.42、5.04和2.80），且平均账龄较短（2003至2005年末及2006年6月30日一年以内应收账款的比例分别为97.5%、98.05%、98.1%和91.3%）。在销售款结算方面，既有相关协议规定的硬性约束，又通过长期合作建立了自律的软性约束，因此公司的销售回款保持在一个良好的水平。

公司最近一期期末未持有大额交易性金融资产及可供出售的金融资产，也不存在借与他人款项及委托理财等财务性投资的情形。

2、主要资产的减值准备提取情况

公司报告期内存货的账面成本与可变现价格比较接近，近三年存货跌价准备未发生显著变化，2003至2005年末及2006年6月30日存货跌价准备分别为1,530,500.19元、1,318,304.58元、1,107,601.48元和1,261,675.97元。

公司执行了谨慎稳健的坏帐准备计提政策，计提方法为：先对可收回性与其他款项存在明显差别的应收款项采用个别认定法计提坏账准备，对于其他应收帐款，帐龄一年以内的应收账款坏帐准备计提比例为5%，一到二年帐龄为20%，两年以上为100%。近三年坏账准备未发生显著变化，2003至2005年末及2006年6月30日坏账准备分别为5,049,430.39元、5,651,537.36元、5,782,851.21元和6,730,143.07元。公司主要销售客户群体高度稳定，同时公司在计提坏帐准备方面的执行了谨慎稳健政策，保证了公司稳定的现金流入量，巩固了与主要客户群的良好关系，也充分显示了公司较强的应收账款管理能力。

公司近三年各项固定资产运行良好，生产经营设备经过不断的更新改造得到了大幅改善，预计可收回金额不低于帐面资产，因此近三年公司没有计提新的固定资产减值准备。

管理层认为，公司主要资产的减值准备计提充分、合理，公司未来不会因为资产突发大额减值而导致财务风险。

3、负债结构和偿债能力

本公司负债结构稳定，2003至2005年末及2006年6月30日的资产负债率分别为42.79%、32.26%、32.24%和32.14%，流动比率与速动比率均保持在稳定合理的水平，2003至2005年末及2006年6月30日的流动比率及速动比率分别为1.61、1.90、1.93、1.97和1.15、1.06、1.23、1.13。公司息税折旧摊销前利润近三年均保持在4000万以上的水平，利息保障倍数均大大超过理论安全边界。

公司没有长期借款，2003至2005年末短期借款折合人民币的余额分别为14,094,528.33元、7,345,300.97元和6,527,272.34元。2006年6月30日末公司短期借款余额为0。公司现金流充沛，销售收现能力良好，2003至2005年度及2006年上半年每股经营活动产生的现金流量分别为0.59元、0.07元、0.54元和0.12元。

此外，公司与中国光大银行苏州分行签订了最高授信额度6000万元的《综合授信协议》，与华夏银行苏州分行签订了最高授信额度3300万元的《综合授信协议》。

公司不存在巨额表外负债，2006年6月30日已签约未于会计报表确认的资本支出承诺为1741.1万元，2006年6月30日不可撤销经营租赁最低租赁付款额为71.4万元。

综上所述，公司负债结构合理，现金流充足、信用良好，短期偿债风险较低，偿债能力有充分保障。

二、盈利能力

（一）主营业务收入及净利润变动的趋势及原因

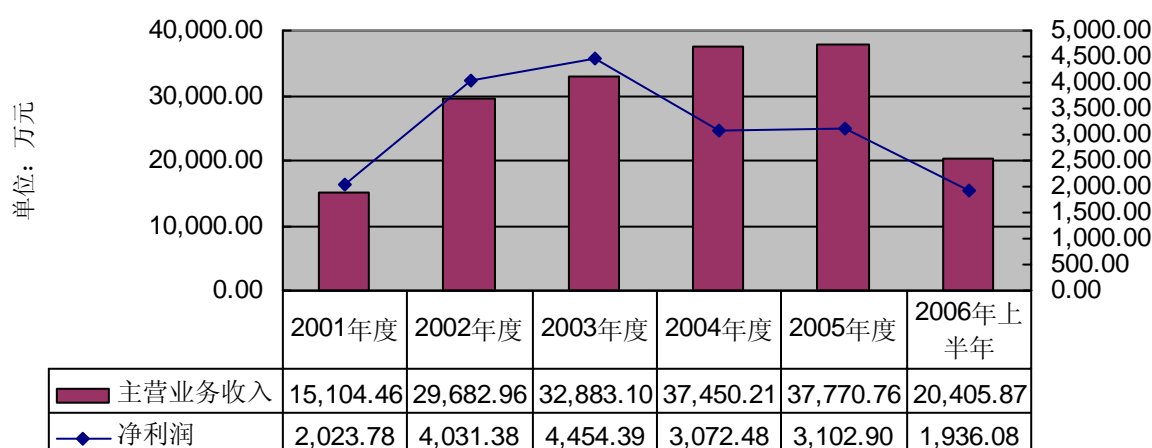
2006年1—6月主营业务收入为204,058,686.84元，保持了良好的增长势头，主要原因在于公司在扩大外销的同时，内销收入也有较大程度的增长。2005年主营业务收入增速降低，主要是由于公司对产品结构进行了一定的调整，压缩了部分毛利率较低产品的产量，加之人民币升值等原因的影响，使公司出口增速受到了一定影响。

2006年上半年实现利润总额21,617,781.86元，主要原因在于销售收入实现

较好增长的同时，公司的毛利率有了一定程度的提高，公司上半年毛利率为19.67%。

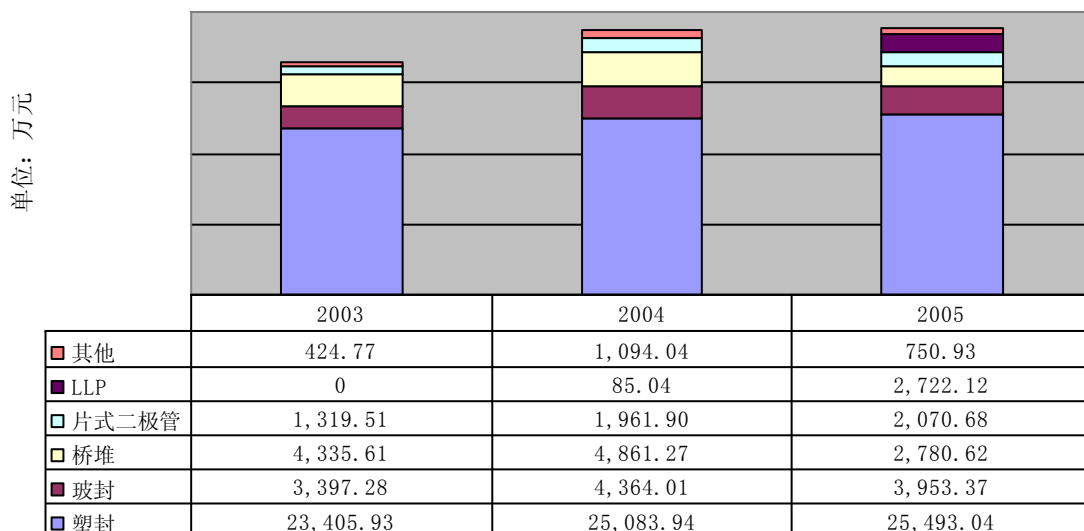
2005年的利润总额比2004年同期增加了1.63%，原因是在销售收入保持略有增长的情况下，公司在市场拓展上加大了投入，营业费用因而有一定程度的上升；与此同时公司狠抓了日常的内部控制，管理费用有较大程度的下降；由于汇率波动的原因，公司当年产生了177.3万元的汇兑损失。

2004年的利润总额比2003年同期下降了31.72%，净利润也出现了较大幅度的下滑，主要原因是（1）2004年1至10月出口退税率从17%调整为13%；（2）铜、单晶硅等原材料价格快速上涨造成采购成本上升幅度较大；（3）为了配合募集资金的投入，公司增加了研发费投入。目前公司享受的出口退税率已经恢复至17%，但原材料价格上涨的趋势并未得到缓解，公司正通过改进生产工艺、提高芯片自给率、加强采购管理、产品线向高端转移等手段保证盈利能力的稳定，2005年度净利润比2004年度略有上升。



（二）主营业务收入的构成

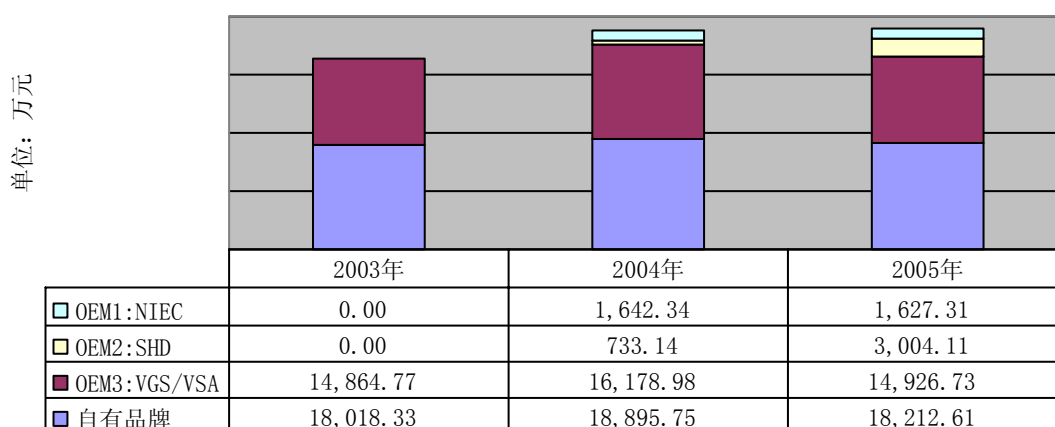
1、收入构成分析——产品



注：上图中“其他”包括对外销售晶圆、TO-220及DO-5等产品。

上述产品中，LLP产品销售收入的增长幅度最快，有望成为未来几年公司利润的增长点；2005年桥堆产品销售收入下降幅度较大，原因是部分下游客户为应对成本上升的压力，降低了桥堆产品的采购量，转为采购塑封轴向二极管进行替代，为此公司将在进一步完善桥堆产品线的同时积极寻求压缩桥堆生产成本的空间。

2、收入构成分析——业务类型



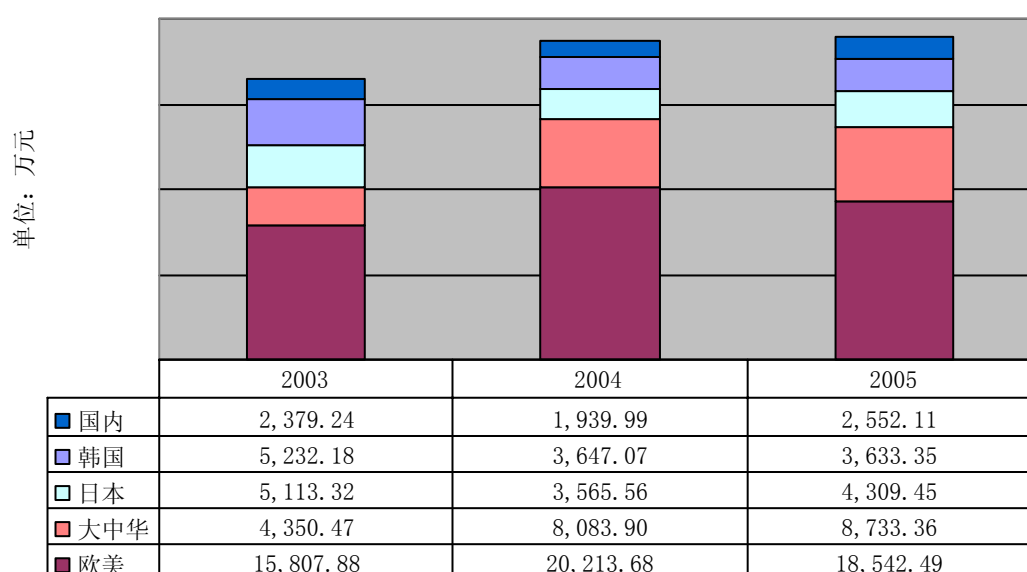
上图表明，公司自有品牌与OEM业务收入的结构稳定，OEM客户开始逐步分散，其中，对日本新电元SHD销售的上升幅度很快，依赖关键客户的风险

有所降低。销售收入的结构正逐步优化。

3、收入构成分析——销售区域

出口销售分成四大地区：韩国区、日本区、欧美区、大中华区（含台湾、香港、东南亚），其中 OEM 产品销售集中于欧美及日本区，自有品牌销售对象主要集中在韩国、日本及大中华区。

公司近三年来销售业务的区域构成如下表所示：



公司出口销售收入占主营业务收入的 90% 以上，从客户所属区域结构来看，欧美地区是 OEM 客户的主要来源地区，公司将大力稳定和拓展欧美高端市场；由于大中华地区电子加工业的旺盛需求，该地区一直是公司出口销售的传统重点地区；日本及韩国地区由于其在消费电子行业的重要地位，也是公司的重点销售地区。

公司历史上国内销售所占比重较低，但随着国际电子设备制造业向国内的产业转移及汽车电子行业的发展，国内需求增长潜力巨大。公司未来在维持海外市场优势地位的同时，将加大对国内市场的拓展力度。目前公司已经着手相关准备工作。

（三）主营业务利润的构成及毛利率变动趋势

1、综合毛利率变动趋势

半导体分立器件行业属于充分竞争行业，成熟产品的销售价格和毛利率总是

处于不断下降的过程中，这是受供求关系和行业特点共同决定的必然趋势。在这一趋势下，加之 2003 年以来原材料价格快速上涨的影响，公司 2004 年综合毛利率较 2003 年有一定幅度的下降，2005 年则通过成本控制和产品结构调整等手段有效遏制了这一趋势。

公司综合毛利率变动趋势

项目	2006 年 1—6 月	2005 年	2004 年	2003 年
综合毛利率	19.67%	18.55%	18.68%	22.95%

2、分产品毛利贡献及毛利率变动趋势

主动优化产品结构，不断引进毛利率稳定的中高端产品，是公司维持毛利率稳定的重要手段。

由于半导体二极管产品分类比较庞杂，为便于分产品毛利率的横向比较，选取报告期内对主营业务利润贡献最大的前5条生产线，从中可以看出产品升级及毛利率的变化趋势。

报告期内对主营业务利润贡献最高的前5条生产线

		生产线名称	主营业务利润（万元）	贡献份额	毛利率
2005	1	轴型	2,171.13	30.98%	20.29%
	2	LLP（VSA）	1,237.48	17.66%	45.46%
	3	玻封	888.15	12.67%	22.47%
	4	日本线（日本 OEM）	679.06	9.69%	14.51%
	5	轴型（VGS）	660.37	9.42%	7.24%
		合计		5,636.20	80.43%
2004	1	轴型	2,560.06	36.59%	25.71%
	2	轴型（VGS）	1,282.18	18.33%	10.69%
	3	MB（VGS）	1,202.08	17.18%	28.71%
	4	玻封	881.40	12.60%	20.20%
	5	SMA	573.53	8.20%	29.23%
		合计		6,499.24	92.89%
2003	1	轴型	3,663.01	48.53%	29.78%
	2	轴型（VGS）	1,538.73	20.39%	13.86%
	3	MB（VGS）	1,099.79	14.57%	29.27%
	4	玻封	497.28	6.59%	14.64%
	5	SMA	493.20	6.53%	37.38%
		合计		7,292.00	96.62%

通过对上表的分析可以看出：

（1）对主营业务利润贡献最高的前5条生产线合计的贡献率逐步下降，说明了公司依赖关键产品和关键客户的风险正逐步得到分散，客户分散化和产品结构

调整的管理目标达到了积极效果。

(2) 轴向型封装产品毛利率逐步下降，对主营利润的贡献也逐步下降，但目前仍是对利润贡献最高的产品，公司对普通轴向型的定位是维持现有规模；

(3) 玻封线的毛利率较高，对公司主营业务利润的贡献稳定，主要是由于miniMELF产品及1W轴向玻封二极管所占比重的逐步提高；

(4) 对VGS销售的OEM轴向型产品毛利率下降最快，其对公司主营业务利润的贡献度下降也较快；

(5) LLP是目前毛利率最高、对主营业务利润贡献的增长速度最快的产品，LLP在2005年量产当年对公司主营业务利润的贡献率即排名第二，是公司未来几年维持快速增长的主要产品之一；

(6) 对日本客户的OEM业务增长速度较快，公司将继续开发对日本和其他区域的OEM市场，并使OEM业务结构更为优化。

管理层认为，尽管原材料价格上涨及平均售价下降的双重影响给公司造成了较大的外部压力，但公司通过成本控制和产品升级等手段成功遏制了毛利率进一步下滑的不利趋势。

3、对主要 OEM 客户的销售毛利率变化趋势

报告期内对主要OEM客户的销售毛利率

		2003	2004	2005
VGS/VSA	轴向型	13.86%	10.69%	7.24%
	MB	29.27%	28.71%	19.37%
	XMAS	—	8.02%	11.97%
	LLP 线	—	—	45.46%
	综合毛利率	17.75%	14.94%	16.22%
日本 OEM 客户	日本线	0	19.34%	14.51%

除 LLP 和 MB 产品外，公司其他 OEM 产品的销售毛利率均低于当期的综合毛利率，且同一 OEM 产品在报告期内的毛利率也呈逐步下降趋势，主要原因是：

(1) OEM 业务占公司销售收入比重较高，是公司盈利的重要来源。从市场因素考虑，通过与国际大公司的 OEM 合作，能提升作为 OEM 供应商的业务水

平及市场知名度，所以公司希望能通过较低的利润率水平换取稳定的合作关系；

(2) OEM 客户与公司签定的 OEM 销售协议均为长期协议或自动展期协议（参见本招股书第十五章相关合同），订单较稳定，降低了我公司自行寻找销售客户的风险和开发客户的相关费用。本着“量多利薄”的原则，公司对 OEM 客户销售的预期利润率要低于其他客户；

(3) 对于 OEM 业务中的部分高端产品，往往由 OEM 客户提供晶粒等主要原材料，降低了公司自行采购的风险及采购成本，因此对相应客户的销售毛利率要求低于其他客户。

尽管单一产品毛利率不断下降的趋势难以扭转，但随着公司产品结构的优化调整，对OEM客户的综合毛利率可以维持相对稳定。2004至2005年，由于与VSA签订了XMAS产品和LLP产品的OEM协议，尤其是由于LLP产品的生产，对VGS及VSA合计的综合毛利率出现了回升。这一趋势充分说明了产品结构调整的重要性，也给了管理层继续贯彻这一策略的信心。

(四) 非经常性损益情况

非经常性损益对本公司净利润影响较小，报告期内扣除非经常性损益前后的净利润如下：

单位：元

	2006年1-6月	2005年度	2004年度	2003年度
净利润	19,360,817.46	31,029,034.28	30,724,847.25	44,543,923.96
扣除非经常性损益后的净利润	17,277,574.89	28,833,284.36	28,637,621.10	42,639,397.25

非经常性损益明细情况如下：

1、营业外支出

单位：元

项 目	2006年1-6月	2005年度	2004年度	2003年度
固定资产处置损失	-	12,364.54	122,390.68	170,839.05
存货报废损失	-	59,103.90		
其 他	16,824.60	30,158.23	2,682.01	20,480.88
合 计	16,824.60	101,626.67	125,072.69	191,319.93

2、补贴收入

单位：元

项 目	2006年1-6月	2005年度	2004年度	2003年度
招商引资奖励	-	-	1,500,000.00	-
出口贴息	-	-	4,975.00	9,265.05
环境整治补贴收入	487,200.00	559,300.00	493,400.00	996,400.00
优秀专利奖	110,000.00			
技术改造奖励	1,000,000.00			
民营经济发展专项资金	500,000.00			
吸纳失地人员综合补贴	78,800.00			
合 计	2,176,000.00	559,300.00	1,998,375.00	1,005,665.05

3、营业外收入

单位：元

项 目	2006年1-6月	2005年度	2004年度	2003年度
赔偿款	3,500.00	53,727.00	1,000.00	966.28
违约赔偿款	-	-	-	-
出售土地使用权净收益	-	1,416,570.66	-	-
合 计	3,500.00	1,470,297.66	1,000.00	966.28

公司 2005 年度营业外收入的大幅增长来自于出售土地使用权收益。

该土地位于苏州高新区通安镇，系 2002 年 7 月买入，使用证编号为“相国用(2002)字第 00312 号”，使用面积 66,560.00 平方米。2005 年 11 月，上述土地因苏州高新区规划调整，被开发区新建道路分割，对公司开发建设造成不利影响。经与政府协商，公司以 9.36 万元/亩的价格将该土地出售，并以同一价格购入位于通安镇、使用面积为 82,903.70 平方米的土地一块，使用证编号为“苏新国用(2005)第 010740 号”。

上述被出售的土地使用权原值 7,998,730.00 元，摊余后价值 7,452,149.98 元，出售土地收入 9,318,400 元，扣除税金 449,679.36 元，出售土地使用权所获得的净收益为人民币 1,416,570.66 元。

4、投资收益

单位：元

项 目	2006年1-6月	2005年	2004年	2003年
期货投资收益	114,135.18	176,300.00	-	-
短期投资收益（减损失）	-	-	99,039.02	(663,819.08)
处置长期股权投资收益	-	-	-	-

合 计	114,135.18	176,300.00	99,039.02	(663,819.08)
-----	------------	------------	-----------	--------------

5、以前年度已经计提各项减值准备的转回

项 目	2006年1-6月	2005年	2004年	2003年
坏账准备的转回	-	65,714.05	-	738,862.32
存货跌价准备的转回	34,233.05	243,338.82	311,218.95	431,884.13
合 计	34,233.05	309,052.87	311,218.95	1,170,746.45

6、非经常性损益的所得税影响数

项 目	2006年1-6月	2005年	2004年	2003年
合 计	227,801.06	217,573.94	197,334.13	81,531.14

三、现金流量

项 目	2006年1-6月	2005年	2004年	2003年
经营活动产生的现金流量净额	12,271,623.30	54,311,913.80	6,996,411.69	58,556,769.61
投资活动产生的现金流量净额	(10,716,198.87)	(24,679,179.20)	(22,638,454.95)	(36,783,525.68)
筹资活动产生的现金流量净额	(6,632,261.69)	(10,265,016.56)	(11,320,911.62)	8,382,894.76
汇率变动对现金的影响	-	-	-	157,965.73
现金及现金等价物净增加额	(5,076,837.26)	19,367,718.04	(26,962,954.88)	30,314,104.42

公司最近三个会计年度合计的经营活动现金流量净额为119,865,095.10元，平均为39,955,031.70元/年。最近三个会计年度平均每股经营活动现金流量为0.40元。最近三个会计年度经营活动产生的现金流量净额与净利润的比率为1.75、0.23、1.31。上述指标均反映公司资金周转状况比较理想。

公司投资活动产生的现金流量最近三个会计年度均为负数，主要因为公司为扩大生产能力建造生产线以及投入在建工程项目。

公司筹资活动产生的现金流量近二年为负数，主要因为公司偿还了部分短期借款及进行了现金分红。

四、资本性支出

1、报告期资本性支出情况

公司2003至2005年度及2006年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资

产所支付的现金分别为26,876,606.60元、31,984,093.97元、30,879,179.20元和9,034,598.87元。相对于公司的资产规模，资本支出相对较小。

公司报告期内的主要资本性支出包括：

(1) LLP生产线的建造，已结转固定资产14,412,451.08元，2006年6月30日在建工程余额为0元；

(2) GPP晶粒生产线的建造，已结转固定资产14,615,384.86元，2006年6月30日在建工程余额为0元；GPP晶粒生产线是本次募集资金投向GPP项目的一部分，由于募集资金未能按计划到位，为避免投资延误对业务发展的影响，公司以自有资金按规划先期投入；

(3) 韩国桥堆设备的建造，已结转固定资产2,358,108.71元，2006年6月30日在建工程余额为1,478,765.61元；

(4) T0-220生产线的建造，已结转固定资产2,136,632.78元，2006年6月30日在建工程余额为1,744,693.66元；

(5) 法国玻封线设备建造，2006年6月30日在建工程余额为4,072,401.94元。

2、未来可预见的重大资本性支出计划及资金需要量

在未来两到三年，公司重大资本性支出主要为本次发行股票募集资金拟投资的两个项目。在募集资金到位后，公司将按拟定的投资计划进行投资，具体情况详见本招股说明书之“本次募集资金运用”的一节。

五、持续盈利能力及前景分析

由于与OEM客户长期稳定的协议合作关系，公司近年来OEM业务基本上处于比较稳定的态势，而自有品牌业务保持了比较良好的发展势头，这符合公司发展战略的基本定位。在行业整体向好的趋势下，由于公司在代加工业务上具有明显的竞争优势，未来只要能维持现有OEM合作伙伴的稳定并加大合作规模，即可以保持在代加工业务方面的领先地位；

在自有品牌业务的竞争方面，则力求通过进一步优化成本和提高产品技术含量来应对未来的竞争风险。

募集资金投资项目完成后，公司将进一步扩大生产规模，特别是公司自有品牌业务规模，优化产品结构，保证公司主营业务收入的持续、稳定增长。

公司未来将进一步发展具有高附加值的高端产品，进一步扩大现有毛利率水平较高的产品产销规模，以及通过本次公开发行募集资金投向高技术含量的生产线来开拓新的高端产品。

综上所述：行业的整体稳定增长为公司发展提供了良好的发展环境，由于长期合作协议的保障，公司的OEM业务仍将保持目前比较稳定的水平，而公司自有品牌业务在LLP生产线大规模投产及募投项目建成的背景下，将会得到较快的增长。而公司未来重点发展高端产品项目也将给公司带来新的利润增长点。基于以上分析，我们认为公司未来的经营将会保持良好的发展势头，持续盈利能力能够得到有效的保障。

六、期货交易

2005年7月22日，公司与创元期货经纪有限公司签订了《期货经纪合同》参与上海期货交易所的期铜交易，目的主要是平抑铜引线采购价格大幅上涨的风险。公司自参与期货交易以来各时点的保证金规模、持仓量及浮动盈亏情况如下：2005年12月31日已投入保证金余额800,000.00元，持仓量4手（1手=5吨），浮动亏损3,150.00元；2006年6月30日已投入保证金余额4,800,000.00元，持仓量25手，浮动亏损835,650.00元；2006年8月30日已投入保证金余额1,800,000.00元，持仓量10手，浮动亏损46,400.00元。

公司管理层认为，由于衍生产品交易存在特殊风险（参见“风险因素”相关内容），对参与期铜交易应持较为谨慎的态度。鉴于近阶段国内期铜市场的投机气氛较浓，而铜材现货价格上涨趋势有所缓解，公司将逐步压缩期铜交易规模，直至暂时退出期铜交易业务；随着公司生产经营规模的进一步扩大，当实际生产采购需要时，公司将在完善内部衍生产品交易相关制度的基础上，严格按照新《会计准则》等相关制度的要求，规范、谨慎地开展套期保值业务，以对冲原材料价格上涨风险。

第十二章 业务发展目标

公司目前主要从事除光电二极管外的各类二极管、桥堆及芯片等产品的设计、生产和销售，经过十多年时间的运作，公司已经初步完成技术、人才、资金方面的积累，开始进入以芯片为核心的中高端设计领域。

公司整体经营目标是：专注于半导体二极管业务，建立符合未来发展目标和产业发展要求的经营体系，加快技术改造，加大技术引进力度，加强管理，提高公司技术竞争力，使产品的技术含量与世界先进水平同步，主营产品产量、质量和产业规模稳居国内前列。未来5年内，本公司将争取成为提供二极管芯片、整流二极管及整流桥堆设计、制造与销售全方位服务的国际知名企业，年销售额突破一亿美元，跨入世界二极管产业第二集团行列。

一、发展战略

本公司将坚持聚焦战略，将目前的主营产品——二极管继续做大做强，努力发展为世界一流的二极管公司。本公司倡导以客户为导向的经营策略，致力于将本公司建设成门类齐全、品种多样的“二极管超市”，为客户提供“**One Stop Shopping**”（一站式）的服务。对客户来说，只需找到本公司，就能找到所需的二极管产品，从而节省客户的搜索成本，降低了供需双方的商务谈判和运输成本，从而达到为双方节约交易费用、创造价值的双赢结果。

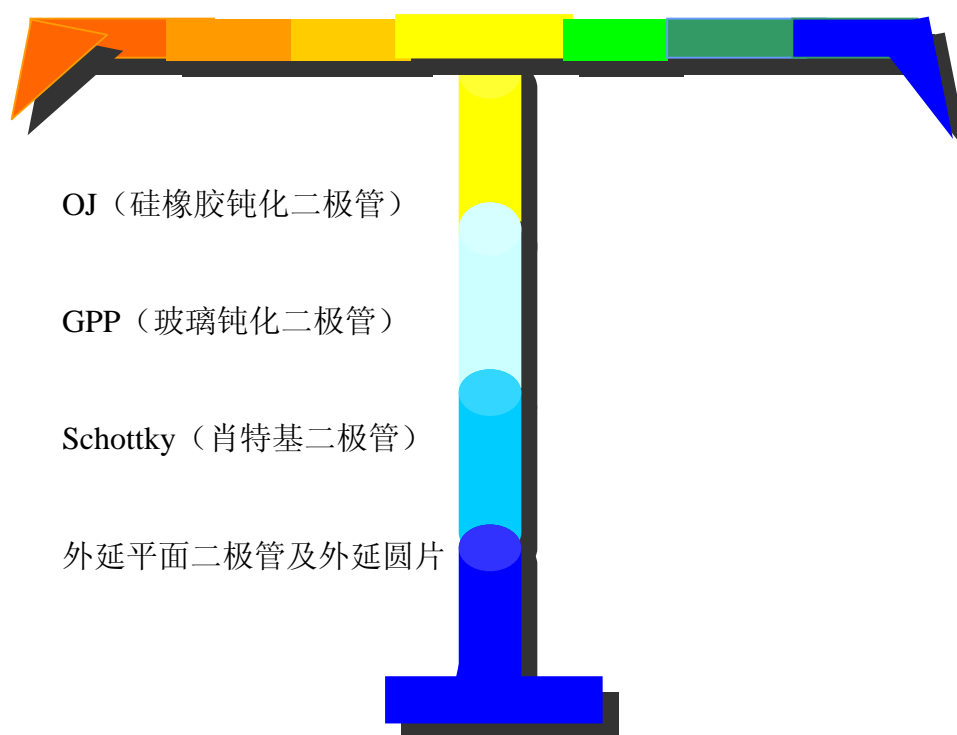
在“**One Stop Shopping**”目标的指导下，公司确定了主营业务的“**T**”型发展战略（如图12-1所示）。

“**T**”型发展战略的纵轴代表二极管的核心——芯片制造，横轴代表二极管的外壳——封装形式。芯片制造技术决定了二极管的工业特性和质量水平，是二极管制造工艺的核心和支柱；多种多样的封装技术则使二极管可以应用于不同场合，是二极管制造工艺的保证和延伸。从工艺流程上看，芯片制造处于上游，封

装测试处于下游。本公司的“T”型战略意味着：在纵向上，不断开发新型芯片技术，例如，TVS、TRIAC 以及本次募集资金投向的 SKY、GPP 等，并在募投产品基础上继续增加产品线的宽度，扩展原有参数范围；在横向上，不断拓展新型封装形式，例如单列塑封、片式、模块、金属帽等，以适应各种应用场合的需要。“T”型战略的目标是，无论何种芯片、何种封装形式的二极管，只要客户提出需要，就能由本公司制造。

“T”型战略规划图

方/圆桥堆 金属帽 片式（SMD）轴对称型 单列 模块 双列器件 二极管：单列 轴对称型 片式 SMD 金属帽 模块



“T”型战略下的产品类别如下表所示：

封装类型	产品类别
片式二极管	SMA; SMB; SMC; SMF; MB 微型桥堆(S型); TO-263, TO-252; 玻封 MELF, MINI MELF; SOD123; LLP; SOD523
轴对称型二极管	塑封轴型; 玻封轴型; 弯型产品; DO-5 金属玻璃封装大功率二极管; 汽车整流器 AR***; 高压硅堆; 圣诞灯双向稳压二极管
单列器件	TO-220, TO-3P, ITO-220 桥堆 GBJ, KBJ, GBL
金属帽器件	TO-18, TO-39,
二极管模块	SOT227(sanrix 模组) (100A 的桥堆)等
双列器件	MB 微型桥堆(M型)
方/圆桥堆	桥堆 KBPC 35A/ WOG; KBPC10~50A/WOG

二、发行当年及未来两年的发展计划

1、产品开发计划

基于“T”型发展战略，公司近几年内的产品开发计划是从纵向和横向两方面增加生产线和产量规模。横向上，开发新型封装形式，如 DPAK、汽车整流器、功率二极管和功率整流模块等，大力拓展 SMD（片式封装）生产线，从现有的 SMA 发展到 SMB、SMC、SMF 等更多品种；纵向上，延伸开发 TVS、开关二极管、Zener 等新型、高附加值的芯片二极管，完成募集资金投向的 GPP 新工艺技术改造项目和肖特基技术改造项目。除募集投资项目以外，本公司计划进一步扩大 LLP 的生产能力，并在未来两年实现 TO-3P、TO-18、TO-39、SMB、SMC 和 DPAK 的批量生产。

2、制造服务开发计划

基于多年来在制造技术及质量管理方面的提升，加上成本管理的优势，公司的制造服务已获得许多国外先进企业的肯定，并产生了显著的绩效。未来几年内，本公司将继续加强与世界二极管行业跨国巨头公司的合作，在技术及信息两方面提升服务水平。

技术服务方面，通过加强内部技术开发和外部交流合作，提高产品设计服务能力。

信息服务方面，通过推进 ERP 管理，增强公司对制造服务开发的力度，提高为客户专用提供即时信息的能力，扩大信息量，提高服务反应速度和信息分析整理能力，促进各种信息的有效运用。

总之，制造服务开发计划的目标是让客户随时掌握产品的生产及质量状况，如同在自己的工厂进行生产，以“优质、高效、规范”的服务提高本公司在业内的认可度和知名度。

3、人力资源开发计划

公司注重人才的引进、培养和挖掘，通过内部培养和外部引进两种渠道，组建并完善管理、技术阶梯。公司现拥有员工 882 人，计划三年内使员工拥有大中专以上文化水平的比例提高到 70% 以上，技术研发人员比例提高到 20% 以上。

同时，公司将积极建立与国内外高校、研发机构的联系与合作，对员工进行各方面的培训，委派业务骨干到日、美大型企业培训学习，多种渠道提高员工素质，改善人员组织结构。

按照“提高效率、优化结构和保证发展”相结合的原则，公司计划今后每年引进一定数量的高级管理、技术人才及大中专毕业生，分层次、有重点地实施员工培训计划和继续教育计划，提高员工整体素质；努力提高中高级管理人员的现代经营管理能力、创新能力、决策能力；通过培训锻炼，造就一批具有市场观念、适应国际化经营的营销人才；加强工程技术人员知识更新和技术培训，提高科技人员产品开发和技术创新能力；通过不间断的岗位培训，提高一般员工的业务操作技能；优化人力资源配置，完善人才竞争和激励机制，以适应公司不断发展壮大的需要。

4、市场开发与营销网络建设计划

未来几年，公司将在原有基础上，扩大在大中华区、日本、韩国、东南亚及东欧的销售网络和分销体系，同时对国内市场重点开发整机厂业务，扩大对汽车、通讯、数码产品等应用领域的市场开发力度，优化调整经销商销售与直接销售比例、国内国外销售比例、自有品牌与 OEM 销售比例等。

公司将灵活运用各种促销手段，实行灵活的销售激励机制，利用 ERP 实现销售信息处理电脑化，用现代化的营销方式开拓市场，提高售前、售中、售后服务质量，建立互动的客户关系，提高客户满意度。

5、再融资计划

本公司除利用本次股票募集资金外，会根据需要通过申请短期贷款、技改专项贷款等手段筹措资金，以补充拟投资项目的资金缺口。近几年内，在本次募集资金投向项目未达标达产之前不会提出再融资计划。在该等项目实施见效后，公司将合理利用资本市场融通资金的功能，根据实际财务结构适时采用发行债券、股票融资、合资合作等手段筹措公司发展所需资金，以推动公司长远发展。

6、收购兼并及对外扩充计划

按照公司业务发展战略，围绕公司核心业务，根据目标业务的技术成熟度和

开发周期，适时、稳妥地采用低成本扩张的方式，收购或兼并国内外同行业或相关行业具有一定实力的专业厂家，围绕主业，立足于产品、技术的互补性，扩充产品系列，提高技术层次，扩大市场份额，增加出口创汇。

7、管理模式和组织机构调整计划

公司将进行企业组织结构扁平化改造，从目前的成本中心管理模式转变为内部利润中心管理模式，从目前的集权较多的体制结构转变为授权较多的体制结构，形成功能型矩阵式组织管理框架。其中，突出研究开发部门的重要性，将其建设成企业学习型组织。

本公司将以现有生产线为基础，形成业务模块，运用 SOP (standard operation procedure) 管理技术和 ERP 管理软件，进行利润中心管理。

目前，公司的组织机构已根据信息通畅、人员精干、控制有力、管理有效的原则进行了较大幅度的调整，达到公司目前的运行要求。随着公司的发展和募集资金项目的实施，将根据实际需要对公司的组织结构在保持相对稳定的基础上进行必要和适时的调整，继续深化企业内部劳动、人事、分配制度改革，建立竞争上岗、优胜劣汰的用工机制，能上能下、能进能出、充满活力的用人机制，岗变薪变、业绩量化考核的分配机制。

8、国际化经营计划

公司目前已建立了以经销商、分销商为主的全球化营销网络，今后将增强对国际市场即时信息的收集处理能力和对外经济合作手段，重点加强韩国、日本、东南亚及东欧市场的营销开发工作。公司将通过设立海外代理机构、海外分支机构及海外研发机构，积极探索跨国经营新领域，提高公司在国际市场的应变能力与竞争力，逐步迈向国际化品牌经营之路，进一步扩大固得品牌的国际影响。

三、拟定上述计划所依据的假设条件

上述业务发展计划，是基于公司对全球半导体行业和二极管产业发展趋势的判断，综合 WSTS、CCID 等行业咨询机构的相关分析资料，对未来几年公司业务发展做出的合理预期、计划与安排。

本公司在拟订以上计划时，充分考虑了现实的条件和未来社会发展变化的因素，并依据了以下假设条件：

1、本公司本次发行获得核准，股票发行和募集资金按本公司招股说明书的计划时间到位，拟投资的项目按计划时间形成经营能力；

2、国家政治、法律、宏观经济，社会环境和自然环境处于正常发展状态，没有对公司发展可能产生重大影响的不可抗力的现象发生；

3、公司所在行业市场处于正常波动发展状态，未出现重大的市场突变情形；

4、国家的出口政策、汇率政策无重大变化；

5、公司组织体系完善，管理层相对稳定。

由于半导体分立器件行业竞争较为充分，技术发展和行业变化速度较快，公司上述业务发展目标可能随行业的波动而存在一定的不确定性。公司将根据国民经济和行业发展变化及公司实际经营状况，对业务发展目标进行及时修正、调整和完善。

四、实施上述计划可能面临的主要困难

公司上市后，在较大规模资金运用和业务快速扩张的背景下，在战略规划、组织设计、机制建立、资源配置、管理体制、运营机制等方面都将面临更大的挑战。面临的主要困难如下：

1、规模问题

发展计划的实施将导致公司的经营业务和生产规模大幅度增加，公司原有的经营机制、管理理念和员工素质等都将接受更严峻的考验，需要在原有的基础上建立和完善适应上市公司资本运作及新项目生产经营的管理体制。

2、人才问题

人才问题主要体现在人才的数量和结构方面。虽然公司已经在前期针对今后的发展，进行了骨干人才的引进和培养工作，但人才的数量和水平还不能满足今后公司发展的需求。同时，国内专业领域内的复合型人才还属稀缺资源，总体水平和国外相比还有较大差距。

3、运营机制问题

公司应在上市后根据规模及外部经营环境的变化适时调整自身的运营机制，虽然公司已经在这方面做了大量的工作，但要迅速地完成这项系统的工作，公司还面临着人才储备不够、经验需进一步积累等方面的问题，同时由于国内在股权激励机制、公司治理结构等相关法律法规方面尚未完善，也为公司实现运营机制的顺利转变带来了一定的困难。

五、业务发展规划与现有业务的关系

本公司未来的业务发展规划，是按照“T”型战略，在围绕现有主业做大做强的基础上，考虑产品系列延伸和技术层次提升的要求，从横向、纵向两方面对现有的主要产品和业务的延伸。一方面，继续巩固和扩大现有产品的市场份额，保持现有业务利润的稳定增长；另一方面，开发更多更新的封装工艺和芯片制造技术，加大中高端产品的研发、设计与销售，调整产品品种和结构，形成高附加值产品的优势地位。

因此，上述业务发展规划是在公司现有业务的基础上按照公司发展战略要求所进行的扩大和再发展，现有业务是公司未来几年发展规划的基础，发展规划与现有业务密切相关并具有很强的连贯性。公司的现有业务与未来的发展规划都以为客户提供“**One Stop Shopping**”式贴身服务为导向，都是在打造“人无我有，人有我优，人优我廉”的“二极管超市”这一经营理念指引下制定和实施的，最终都服务于公司的整体经营目标。

第十三章 募集资金运用

一、募股资金运用概况

本次公开发行数量为 3,800 万股，募集资金全部用于玻璃钝化超级整流二极管（GPP）(含汽车整流二极管)生产线技术改造项目和肖特基二极管（SKY）生产线技术改造项目。两个项目共需筹集资金 4951 万美元，按项目批准时的汇率折合人民币约 41,097.04 万元。

集资金计划用途及投资项目立项审批情况如下：

	项目名称	资金需求		批准文号
		万美元	万元	
1	玻璃钝化超级整流二极管生产线技术改造	2663	22,102.57	江苏省经济贸易委员会苏经贸投资（2003）1184 号文
2	肖特基二极管生产线技术改造	2288	18,994.47	江苏省经济贸易委员会苏经贸投资（2003）1185 号文

预计 GPP 项目投资建设期内每年投资金额

单位：万元

投资类型	投资金额	项目建设期		投产阶段	达产阶段
		第 1 年	第 2 年		
固定资产	15,900.97	9,275.57	6,625.40		
流动资产	6,201.60		620.16	3,100.80	2,480.64
总投资金额	22,102.57	9,275.57	7,245.56	3,100.80	2,480.64

预计 SKY 项目投资建设期内每年投资金额

单位：万元

投资类型	投资金额	项目建设期		投产阶段	达产阶段
		第 1 年	第 2 年		
固定资产	13,971.72	2,794.34	11,177.38		
流动资产	5,022.75		502.28	2,511.38	2,009.10
总投资金额	18,994.47	2,794.34	11,679.65	2,511.38	2,009.10

募集资金与投资项目资金需求间的资金缺口我公司将通过自筹或银行贷款予以解决。2005 年 11 月 15 日，公司与中国光大银行苏州分行签订了最高授信

额度为人民币 6,000 万元的《综合授信协议》，期限为 2005 年 11 月 21 日至 2006 年 11 月 21 日；2006 年 8 月 8 日，公司与中国银行苏州分行签订了最高授信额度为人民币 10,000 万元的《授信额度协议》，期限为自协议生效日至 2007 年 8 月 7 日。

二、本次募集资金投资项目的意义

本次募集资金投资项目是在充分利用现有技术基础和生产设备的前提下，组建一条玻璃钝化超级整流二极管(GPP)(含汽车整流二极管)生产线，形成年产 10.093 亿只玻璃钝化超级整流二极管的生产能力，以及组建一条肖特基二极管生产线，形成肖特基二极管 5.808 亿只的年生产规模。

1、本次募集资金项目的技术先进性

玻璃钝化超级整流二极管的特点是高温反向偏置（HTRB）的可靠工作温度较高，普通的 OJ（硅橡胶钝化）二极管在 1000V 电压下的反向偏置温度为 100℃，而玻璃钝化超级整流二极管可以达到 125~150℃。整流二极管采用玻璃钝化技术后将大大提高反向电压稳定性，具有更广泛的应用领域，如汽车整流等大电流工作环境。

肖特基二极管与普通 PN 结二极管相比具有正向压降低、电荷储存效应小的优点，在作为整流二极管使用时整流损耗更小，散热要求更低，反向恢复时间可忽略不计，开关损耗接近于零，在快速开关模式下能将电压瞬变及振荡减至最低。由于肖特基二极管上述独有的优势，其应用领域不断拓展，成为二极管产品中需求增长最快的产品。

2、市场容量及市场前景

根据 CCID 的预测，2006—2010 年国内二极管市场规模将保持持续快速增长。

	2006 年	2007 年	2008 年	2009 年	2010 年
二极管（亿元）	88.66	103.03	118.79	134.47	149.53
增长率（%）	14.7	16.2	15.3	13.2	11.2

玻璃钝化超级整流二极管产品的主要用途之一是汽车整流器市场。随着国内汽车市场规模的迅速发展，汽车电子设备对二极管产品的需求急剧增加，由于国内产能严重不足，目前国内汽车整流二极管产品主要依靠进口。公司在几年前就开始和世界汽车整流器的顶级厂商合作，并成功获得了 TS16949（国际汽车工业质量体系技术规范）认证，迈出了进入汽车半导体市场的关键一步。未来公司将利用替代进口策略积极开拓国内汽车半导体市场。

肖特基二极管以其独有的优势广泛用于输出整流级、开关电源、其它功率系统、电池反向保护、续流电路及高频或过冲/下冲箝位元电路，主要应用在手机、PPC、HPC、PDA、音响、彩电、AC/DC、DC/DC、微波通信、雷达等诸多产品领域。计算机、通信、消费电子以及汽车电子领域对肖特基二极管的需求持续上升使其成为近年来市场规模增长最快的二极管产品，其市场前景十分看好。

3、技术保障

本公司已从事二极管生产十多年，通过引进或自主开发形成了完整的二极管生产能力及较为完善的质量控制技术。本公司现有的专利技术和自主开发能力均为本项目提供了技术保障。

4、OEM 客户对本公司拟用自产芯片替代进口芯片的意见及合约衔接情况

公司本次发行募集资金拟用于自行生产二极管芯片替代从 OEM 客户采购的芯片。该计划已经得到主要 OEM 客户的同意，并且在项目实施上得到了业务帮助。

本次募集资金使用项目达产后，本公司自行生产的二极管芯片在技术、质量指标上将完全达到进口产品的标准，而在成本上则明显优于进口产品，全部替代进口晶粒后，将使本公司二极管产品的生产成本平均降低 25% 左右；在此基础上，本公司也具备了适当降低 OEM 产品销售价格的能力，从而直接降低了 OEM 客户的成本，给予其在终端市场上的主动权。自产芯片替代进口芯片符合 OEM 合作双方的利益。

基于上述原因，CCI 已于 2004 年 8 月 9 日就二极管芯片项目达产后替代从 CCI 公司采购的芯片事宜给本公司发来了相关意向书，同意如本公司生产的芯片在成本和质量等方面能满足 CCI 的要求，将采购本公司生产的芯片用于双方协议

项下的合作。

三、募集资金投资项目简介

1、玻璃钝化超级整流二极管(含汽车整流二极管)生产线技术改造项目

本项目经江苏省经济贸易委员会苏经贸投资(2003)1184号文“关于苏州固得电子股份有限公司玻璃钝化超级整流二极管生产线技术改造项目建议书的批复”批准立项。

(1) 投资概算

项目总投资为 2,662.96 万美元，按项目获批时的汇率折合人民币 22,102.57 万元；投资概算如下表所示：

单位：万元

序号	投资项目	投资金额
1	固定资产投资	15,900.97
	其中：建筑工程	2,283.90
	设备购置	10,899.98
	安装工程	2,717.09
2	铺底流动资金	6,201.60
3	项目投资合计	22,102.57

(2) 产量、技术和设备

本项目拟建年生产能力为 10.093 亿只/年的玻璃钝化二极管批量生产线，该生产线的技术特征为 4 英寸圆片，2~5 μm 线宽。根据市场需求和本公司的生产能力，本项目生产大纲确定为年产表面安装二极管 6.473 亿只，汽车整流二极管 0.6 亿只，桥堆 3.02 亿只。

玻璃钝化超级整流二极管生产线技术改造项目

单位：万美元

产品类型	芯片生产数量	封装成二极管数量	年销售收入	年利润
二极管	100,930 万只	100,930 万只	3,747.37	711.29

本项目技术来源于本公司多年来自行研究的玻璃钝化超级二极管生产技术和相关取得的各项专利技术。

本项目产品的生产类型属于大批量生产，其生产工艺主要包括半导体分立器件二极管芯片的生产和器件后工序的封装、测试等。本项目产品工艺有别于国内

同行生产企业通用工艺，首先是台面二极管工艺引用了平面工艺的光刻工序，可将玻璃钝化的玻璃粉与光刻胶混合，使原匀胶、涂复玻璃粉两步工序合为一步，并且玻璃粉分布均匀，厚薄一致。另外借用平面工艺中刻蚀工艺开沟形成台面结构，另一特点是 B、P 扩散一次完成，大大降低了生产成本。

根据产品、工艺种类的要求，同时为保证新建的玻璃钝化二极管生产线有一个较高的技术水平，除利用部分原有的工艺设备外，在尽可能购置国内设备的基础上购置必须的国外设备。即购置国外设备 128 台(套)，利用原有设备 28 台(套)。再根据本公司的生产特点，利用公司的技术和人才优势，结合自身的生产实际情况组建玻璃钝化二极管生产需要的自动化生产线。

2、肖特基二极管生产线技术改造项目

本项目经江苏省经济贸易委员会苏经贸投资（2003）1185 号文“关于苏州固得电子股份有限公司肖特基二极管生产线技术改造项目建设书的批复”批准立项。

（1）投资概算

本项目总投资 2,288.49 万美元，按项目获批时的汇率折合人民币 18,994.47 万元；投资概算如下表所示： 单位：万元

序号	投资项目	投资金额
1	固定资产投资	13,971.72
	其中：建筑工程	2,184.64
	设备购置	9,378.50
	安装工程	2,408.58
2	铺底流动资金	5,022.75
3	项目投资合计	18,994.47

（2）产量、技术和设备

本项目拟建年生产能力为 5.808 亿只/年的肖特基二极管批量生产线。根据市场需求和本公司的生产能力，本项目生产大纲确定为年产肖特基单列功率二极管 1.518 亿只；肖特基片式二极管 4.29 亿只。

单位：万美元

产品类型	芯片生产数量	封装成二极管数量	年销售收入	年利润
二极管	58,080 万只	58,080 万只	3,423.84	630.42

该产品生产中采用多种新技术、新工艺和新设备。如：铂等双金属溅射技术、

硅片减薄技术、CVD(化学汽相淀积)技术、采用离子注入代替扩散等技术，并采用外燃式氢氧合成氧化炉代替一般的氧化炉。现在产品的成品率可达 98%左右，产品的技术参数达到世界先进水平。

根据产品、工艺种类的要求，同时为保证新建的肖特基二极管生产线有一个较高的技术水平，除利用部分原有的工艺设备外，重点为购置国外设备，需新增设备仪器 100 台（套）。根据本公司的生产特点，利用公司的技术和人才优势，结合自身的生产实际情况组建肖特基二极管生产线。

3、募投项目主要原材料、辅助材料及燃料等的供应

玻璃钝化二极管生产所需的原材料主要有硅晶片、光刻版、光刻胶、扩散源、化学试剂等。肖特基二极管生产和封装的主要生产原材料有：硅晶片、光掩膜、工艺特殊气体、化学试剂和封装材料等。

上述项目需要高质量 4 英寸外延硅片，项目初期进口解决，在保证质量的前提下，以后将逐渐选用本地原材料；光掩膜版目前国内产品能够满足项目要求；树脂等封装材料部分从国外采购，逐渐选用国内采购产品；引线及其他材料均通过国内采购。

募集资金投资项目的实施所涉及的能源主要有电、氮气和水等。电力方面，公司和苏州国家高新技术开发区供电局签署了供电协议，能保证公司正常生产经营所需的电力，公司正向供电部门申请通过专线供电的方式，较彻底地解决电力供应紧张时可能出现的拉闸限电现象；大宗气体包括 N_2 、 O_2 、 H_2 及压缩空气等，本项目所需的氮气和压缩空气由专业厂家在厂区设置的氮气站供给，氮气目前由上海比欧西公司（BOC）负责供应，从未出现过供货延迟或紧张情况，氧气、氢气则由瓶装气通过汇流排进入生产厂房气体入口室，分配计量后至使用点；公司地处长江三角洲的太湖之滨，水资源供应充足。公司将严格按照项目要求建设新的纯水房、变电站、氮氧站、真空站、压缩空气站。

4、人员和管理

公司为了配合未来投资项目的实施，已制定了详细的人才引进和储备计划。公司近两年从台湾和日本招聘的专业人才，目前已充实到公司的管理和研发部门。他们不仅能够增强公司进行投资项目的研发实力，而且他们还曾任国际知名

的二极管生产企业的高级管理人员，具有丰富的生产管理经验。

募投项目共需劳动定员 1,500 人，其中管理人员 60 人，设计、工艺、维修骨干技术人员 160 人，生产操作人员 1,200 人，其它人员 80 人。大部分生产人员通过招聘方式解决，对于部分高级管理人才、产品开发人才和技术人员由固得公司内部调剂解决一部分，其它部分采取招聘方式解决。

人员培训是产品质量保证和企业全面进步的重要手段。本项目无论是技术人员、管理人员、还是生产工人等，都需经严格培训考核后方能上岗。

根据企业发展需要，还将派一部分骨干人员去国外接受培训，计 60 人次×15 天，地点为欧、美。外国专家来华 3 人×7 个月，培训费用已列入项目建设投资内。

5、销售

募集资金使用项目生产的晶粒主要供公司自用，少量对外销售。

募集资金使用项目是公司实现“T 型战略”的重要步骤，募投项目达产后，本公司芯片自给率将显著提高，从而大幅降低生产成本，提高产品档次，推动公司进一步拓展国内外市场的竞争力。

未来投资项目实施后，我公司对产品的销售将按既定的措施开发市场，综合考虑国内外市场价格以及竞争因素制定的产品销售单价，并采取更为积极主动的营销策略。

6、环保问题及措施

募投项目工艺流程由芯片生产和封装工艺组成。在硅片加工过程中产生酸性废气、少量的有机废气以及热废气和工艺尾气。以上废气分别用局部排风送至一般废气（废热）排放系统、酸碱废气排放系统、有机废气排放系统等三个系统进行处理。工艺尾气经过工艺设备附带的处理装置处理，再经废气洗涤装置处理达到排放标准后排放。

生产直接原材料主要有光刻版、光刻胶；HF、H₂SO₄、HCl、H₃PO₄、HNO₃ 等清洗腐蚀剂；H₂O₂、NH₄OH、显影液(TMAH)等氧化剂/碱。虽然排放物对环境有一定影响，但均需经过处理达标后再排放，不会造成环境污染。

7、项目选址

玻璃钝化超级整流二极管和肖特基二极管生产线技术改造项目合建，根据两个项目生产特点、封装形式、生产设备等方面考虑项目建设方案，拟采用按产品工艺为对象的生产组织形式下划定各线相应加工设备。工程建设方案上则合用芯片生产车间与封装车间，包括4英寸2 μ m玻璃钝化二极管芯片生产线和二极管封装生产线以及肖特基二极管芯片生产线和其它二极管封装生产线，与其配套的室外工程、动力设施以及其它辅助建筑。

本项目选址位于苏州国家高新技术产业开发区通安工业园，征用土地面积82,903.7m²，两个项目新建建筑面积共计13,822m²，其中综合厂房建筑面积12,528m²，GPP项目计划使用厂房面积6,911m²，SKY项目计划使用厂房面积5,617m²。设计范围包括红线内的各工号建筑物、构筑物、围墙、道路、绿化设计等。

厂区整体按功能分区大致可分为厂前区、生产区、生产辅助区和生活区四部分。根据半导体分立器件生产的工艺特点，并考虑环保以及消防和厂内管网敷设等方面的要求，1号建筑综合厂房布置在东区的中部，北面布置配套的气站和化学品库等辅助建筑物。东南角为生活区，布置有食堂与职工宿舍。厂区主干道为8m，次道路为6m，各建筑物之间的间距均符合消防防火规范要求。建筑四周均有加宽环行道路相连。室外构筑物如800m³消防储水池、污水处理池等布置在厂区的绿化带的地下。

四、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响

募集资金投资项目实施后，公司的盈利能力和市场竞争力将会有进一步提高，对公司主营业务收入、净资产收益率、每股收益等都将产生较为显著的有利影响。

1、替代对外采购，降低生产成本

目前公司的二极管芯片自给率较低，不利于进一步降低生产成本。本次募投项目实施后，芯片自给率将逐步提高，其中GPP项目产品可替代本公司从VGS采购的芯片，从而显著降低生产成本，并使双方的合作关系更为稳固；SKY项目所产芯片可用于公司现有TO-220、TO-3P、DPAK、D2PAK等封装线，也大大节约了生产成本。

本次募集资金项目投产后，成本节约情况测算如下：

项 目	平均自产成本	平均外购价格	年产量	成本节约
玻璃钝化(GPP)	2.8 美元/千只	3.5 美元/千只	100.93 万千只	70.65 万美元
肖特基 (SKY)	4.2 美元/千只	6.0 美元/千只	58.08 万千只	104.54 万美元
合计	—	—	—	175.19 万美元

2、扩大产品类型，增加公司盈利

本次募投项目将有助于提升公司的产品开发能力并逐步提高产品档次。公司自产的 GPP 芯片和 SKY 芯片可用于开发微型桥堆扩展系列产品、表面安装二极管产品、大功率汽车整流二极管、肖特基大功率整流桥堆系列产品、二极管阵列等新产品，这些产品拥有强大的市场需求，将使公司的销售潜力得以进一步提升。

另一方面，由于公司自产的二极管芯片在成本和质量上具有双重优势，也可以作为中间产品直接销售，在国内、外市场均存在一定的需求潜力。

五、募集资金投资项目的建设情况

本次公开发行募集资金到位前，公司已开始利用自有资金对玻璃钝化超级整流二极管生产线技术改造项目中的 4 英寸 GPP 晶粒生产线项目进行了投资。截至 2006 年 6 月 30 日，该生产线已经累计投入资金 14,670,701.24 元，结转固定资产 14,615,384.86 元。具体资金投入情况如下：

单位：元

	资金投入	固定资产结转	其他转出额	年末在建工程余额
2003 年	4,628,407.05	—	—	4,628,407.05
2004	9,789,826.29	10,294,952.36	—	4,123,280.98
2005	252,467.90	4,320,432.50	—	55,316.38
2006 年	—	—	55,316.38	0
合计	14,670,701.24	14,615,384.86	—	—

上述 4 英寸 GPP 晶粒生产线已于 2005 年投产，当年实际产量为 5,100 万只。4 英寸 GPP 晶粒生产线的投产虽然尚不能满足公司二极管生产所需芯片的全部需求，但也部分缓解了相当比例芯片需要由 OEM 客户提供及对外采购的局面。根据募集资金投资项目规划，玻璃钝化超级整流二极管生产线技术改造项目全部完成后，GPP 产品的芯片生产和封装能力将达到 100,930 万只/年。

第十四章 股利分配政策

一、公司股利分配的一般政策

本公司股票全部为普通股，股利分配将遵循“同股同利”的原则，按股东持有的股份数额，以现金股利、股票或其他合法的方式进行分配。

在每个会计年度结束后的六个月内，由本公司董事会根据该会计年度的经营业绩和未来的发展规划提出股利分配政策，经股东大会批准后执行。

公司将本着对投资者负责的态度，实现股东价值，回报投资者。公司将在可分配利润方式的选择范围内，充分考虑到投资者的需要，并根据有关法律法规和公司章程，以公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- 1、弥补上一年度的亏损；
- 2、提取法定公积金百分之十；
- 3、提取任意公积金；
- 4、支付股东股利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公积金后是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不得在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。

股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的百分之二十五。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利的派发事项。

二、历年股利分配情况

公司最近三年的股利分配情况如下：

根据 2003 年 5 月 7 日股份公司年度股东会通过的决议, 将 2002 年末未分配利润中 3,000 万元转增资本, 各股东按同比例增资。

根据 2004 年 6 月 22 日召开的 2003 年度股东大会决议, 对 2003 年末未分配利润中采用现金方式按 0.05 元/股分配股利 500 万元。

根据公司于 2005 年 5 月 10 日召开的 2005 年第一次临时股东大会决议, 公司对截止 2004 年 12 月 31 日可供投资者分配利润中的 8,978,455.53 元进行分配。该利润分配方案已于 2005 年 5 月 16 日前实施完毕。

根据公司于 2006 年 6 月 30 日召开的 2005 年年度股东大会决议, 公司对截止 2005 年 12 月 31 日可供投资者分配利润中的 11,374,679.14 元进行分配。本次利润分配已于 2006 年 8 月 30 日前实施完毕。

三、发行后的股利分配政策

公司本次发行后的股利分配一般政策与发行前将保持一致, 根据修改后的《公司法》规定, 公司自 2006 年起将不再提取法定公益金。公司将在本次发行后第一个盈利年度的下一年进行股利分配, 具体分配方案由董事会根据盈利状况拟定, 经股东大会审议通过后实施。

四、本次发行完成前滚存利润分配政策

根据公司于 2006 年 6 月 30 日召开的 2005 年年度股东大会决议, 本次公开发行人民币普通股股票(A 股)完成后的未分配利润余额 65,000,000 元及自 2006 年 1 月 1 日以后产生的利润将由本次公开发行后的新老股东共享。

第十五章 其他重要事项

一、信息披露及投资者服务

根据有关法律法规的要求，本公司制订了严格的信息披露制度和投资者服务计划。

本公司负责信息披露和投资者关系的部门是证券部，主要负责人为董事会秘书高玉标先生，对外咨询电话为 0512—65304462 转 2050。

二、重要合同

由于所处行业的特点，公司对外签署的 OEM 协议及购销协议的内容主要包括产品质量、订单及交货方式、结算方式及相关法律程序，对数量、金额则未予以约定。本章所指的重要合同是指本公司正在履行的 OEM 合同、与关联方签订的最近一个会计年度实际发生金额超过 500 万元的销售合同。

（一）OEM 合约

	合约方	合约内容	签署日期	有效期	备注
1	世纪元器件 (CCI)	私有标签协议	2001 年 10 月 30 日	5 年	
2	威旭通用半导体 (VGS)	补充协议*	2005 年 3 月 26 日		承继与 CCI 的权利义务
3	威旭半导体奥地利 (VSA)	整流产品分包协议	2001 年 4 月 27 日	1 年*	到期顺延
4	威旭半导体奥地利 (VSA)	LLP 产品合作协议	2004 年 2 月 18 日	5 年*	到期顺延
5	威旭半导体奥地利 (VSA)	XMAS 产品分包协议	2004 年 2 月 18 日	1 年*	到期顺延
6	威旭半导体奥地利 (VSA)	DO41 产品分包协议	2004 年 10 月 15 日	1 年*	到期顺延
7	日本映达 (NIEC)	委托生产基本合约	2001 年 2 月 22 日	3 年*	到期顺延
8	日本新电元 (SHD)	开发试作委托合同	2003 年 10 月 11 日	1 年*	到期顺延

报告期内，公司与上述客户在 OEM 合同项下的销售金额参见“第六章 业务与技术”及“第十一章 管理层讨论与分析”相关内容。

上述合约当事人的住所情况如下：

- 1、世纪元器件有限公司 (CCI): 美国纽约, Melville, 公元路 10 号;
- 2、威旭通用半导体公司 (VGS): 美国纽约, 100 Motor Parkway, Suite 135, Hauppauge;
- 3、威旭半导体奥地利公司 (VSA): 奥地利, Voecklabruck, A-4840;
- 4、日本映达电子有限公司 (NIEC): 日本神奈川县秦野市曾屋 1204;
- 5、新电元工业株式会社 (SHD): 日本东京都千代田区大手町二丁目 2 番 1 号。

(二) 与关联方签订的销售合同

序号	合约方	签约日期	有效期
1	固得(香港)电子有限公司	2004年1月1日	5
2	香港宝德电子公司	2004年12月31日	2

报告期内，公司与关联方在上述合同项下的销售金额参见“第七章 同业竞争与关联交易”相关内容。

三、其他重大事项

截至本招股说明书签署之日，本公司不存在对外担保，未涉及重大诉讼或仲裁事项。

截至本招股说明书签署之日，本公司控股股东、本公司实际控制人及本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均未作为一方当事人涉及重大诉讼或仲裁事项。

截至本招股说明书签署之日，本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均未涉及刑事诉讼。

第十六章 发行人及有关中介机构声明

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事：

----- 吴念博	----- 唐再南	----- 杨小平
----- 黄浩荣	----- 孙红敏	----- 乐琪
----- 张为佐	----- 张雨歌	----- 沈新艺

全体监事：

滕有西

蒋晓航

吕明

卞庄

王维蒂

全体高管人员：

曾美华

高玉标

苏州固得电子股份有限公司

2006年 月 日

保荐人（主承销商）声明

本公司已对招股说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目主办人：刘昊拓

（签字）

保荐代表人：林好常 刘勇

（签字）

保荐人法定代表人：徐宜阳

（签字）

爱建证券有限责任公司

2006年 月 日

发行人律师声明

本所及经办律师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师：乔文骏 朱旭东
(签字)

律师事务所负责人：张学兵
(签字)

北京市中伦金通律师事务所

2006年 月 日

德勤华永会计师事务所有限公司
关于苏州固得电子股份有限公司招股意向书（招股说明书）
引用审计报告及其他报告的声明

德勤华永会计师事务所有限公司作为苏州固得电子股份有限公司发行人民币普通股股票的专业审计机构，本所及签字注册会计师已阅读苏州固得电子股份有限公司的招股意向书（招股说明书）及其摘要引用的本所对苏州固得电子股份有限公司 2003 年度、2004 年度、2005 年度及 2006 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间的申报会计报表出具的审计报告，对其 2006 年 6 月 30 日与会计报表编制有关的内部控制出具的内部控制审核报告，对其 2003 年度、2004 年度、2005 年度及 2006 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间非经常性损益明细表出具的专项说明，确认其内容与本所出具的审计报告、内部控制审核报告及关于非经常性损益明细表的专项说明无矛盾之处。本所及签字注册会计师对苏州固得电子股份有限公司在招股意向书（招股说明书）及其摘要中引用的审计报告、内部控制审核报告及关于非经常性损益明细表的专项说明的内容无异议，确认招股意向书（招股说明书）及其摘要不致因完整、准确地引用上述由本所出具的报告及说明而导致在相应部分出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对本所出具的上述报告及说明的真实性、准确性和完整性依据有关法律法规的规定承担相应的法律责任。

本声明仅供苏州固得电子股份有限公司为本次申请向境内社会公众发行人民币普通股股票之目的使用，不得用作任何其他用途。

德勤华永会计师事务所有限公司 法定代表人或授权代表：萧耀熙
中国·上海

签字注册会计师：杨海蛟 茅志鸿

2006 年 8 月 30 日

资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册评估师：王凯 沈光俊

（签字）

资产评估机构负责人：张雨歌

（签字）

江苏仁合资产评估有限公司

2006年 月 日

德勤华永会计师事务所有限公司
关于苏州固得电子股份有限公司验资机构的声明

本所及签字注册会计师已阅读苏州固得电子股份有限公司的招股意向书（招股说明书）及其摘要引用的本所对苏州固得电子股份有限公司变更设立及2003年度未分配利润转增股本时的验资报告，确认其内容与本所出具的验资报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对苏州固得电子股份有限公司在招股意向书（招股说明书）及其摘要中引用的验资报告的内容无异议，确认招股意向书（招股说明书）及其摘要不致因完整、准确地引用上述本所出具的验资报告而导致在相应部分出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本所出具的上述验资报告的真实性和完整性依据有关法律法规的规定承担相应的法律责任。

本声明仅供苏州固得电子股份有限公司为本次申请向境内社会公众发行人民币普通股股票之目的使用，不得用作任何其他用途。

德勤华永会计师事务所有限公司
中国·上海

法定代表人或授权代表：萧耀熙

经办验资人员：周华 杨海蛟

2006年8月30日

第十七章 备查文件

本招股说明书备查文件包括：

- 一、发行保荐书；
- 二、财务报表及审计报告；
- 三、内部控制鉴证报告；
- 四、经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
- 五、法律意见书及律师工作报告；
- 六、公司章程（草案）；
- 七、中国证监会核准本次发行的文件；

以上备查文件将在巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露，投资者同时可在本次发行承销期内至发行人及保荐人（主承销商）办公地点查阅，查询地点及联系人如下：

1、苏州固得电子股份有限公司

地 址：苏州市通安开发区通锡路 31 号

电 话：0512-65304462

联系人：高玉标、刘立冬

2、爱建证券有限责任公司

地 址：上海市复兴东路 673 号

电 话：021-63341333

联系人：林好常、刘勇、刘昊拓、刘平